

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

รายงานการวิจัย

การเตรียมพิล์มบางนาโนของ TiO_xN_y สำหรับประยุกต์ในกระจกทำความสะอาดตัวเอง
Deposition of TiO_xN_y nano-Thin Film for Self Cleaning Glass Applications

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศิษฐ์ ไชยคุณ
ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๖๕๑๓๒

- 7 พ.ศ. 2557

๓๓๕๕๗๖

เรียนริการ

๒๓๐.๘. ๒๕๕๗

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประจำปีงบประมาณ 2555

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

อกินันธนาการ

บทคัดย่อ

ฟิล์มบางนาโนของ TiO_xN_y หรือ ฟิล์มบางไ泰เนียมออกไซด์เจือในไนโตรเจน (N-doped TiO_2) เคลือบบนกระจกสไลด์ และแผ่นซิลิกอน ด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง ผลของเงื่อนไขการเคลือบได้แก่ อัตราไหლแก๊สในไนโตรเจนได้ถูกศึกษา โดยสมบัติของฟิล์มบางที่เคลือบได้ ได้แก่ โครงสร้างผลึก ลักษณะพื้นผิว ความหนาและ ค่าการส่งผ่านแสง ถูกตรวจสอบด้วย X-ray diffraction (XRD), Atomic Force Microscopy (AFM) และสเปคโทรโฟโตเมตอร์ตามลำดับ ค่าคงที่ทางแสงและแถบพลังงานของฟิล์มที่เคลือบได้คำนวณจากสเปคตรัมการส่งผ่านแสง ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างระหว่างวัสดุองรับกับเป้าสารเคลือบ กระแสไฟฟ้า และอัตราไหลแก๊สในไนโตรเจนมีผลต่อโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ ค่าคงที่ทางแสงของฟิล์มบางไ泰เนียมได้ออกไซด์เจือในไนโตรเจนที่ความยาวคลื่นแสงเท่ากับ 550 nm พบร่วมด้วยหักเห และสัมประสิทธิ์การดับสูญ เท่ากับ 2.5 และ 0.001 – 0.002 ตามลำดับ แถบพลังงาน (E_g) ของฟิล์มบางไ泰เนียมได้ออกไซด์เจือในไนโตรเจนพบร่วมค่า 2 ช่วง คือ 3.20 eV (ของฟิล์มไ泰เนียมได้ออกไซด์เฟสอนาคต) และ 2.40 eV – 2.60 eV (ของฟิล์มไ泰เนียมได้ออกไซด์เจือในไนโตรเจน) โดยฟิล์มบางไ泰เนียมได้ออกไซด์เจือในไนโตรเจนที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้สามารถแสดงสมบัติไฮโดรฟิลิกได้เมื่อสัมผัสแสงในช่วงตามเห็น

คำสำคัญ: ฟิล์มบาง, ฟิล์มบางไทเทเนียม, ไดออกไซด์เจือในไตรเจน, รีแอคตีฟ สปัตเตอร์ริง, รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตอรอน สปัตเตอร์ริง, ไฮโดรฟลิก

Abstract

TiO_xN_y nano-thin film or nitrogen doped titanium dioxide (N-doped TiO_2) thin films were deposited on glass slides and silicon wafers by reactive DC magnetron sputtering method. The effect of deposition parameter such as N_2 gas flow rate has been investigated. The properties of the as-deposited thin film such as crystal structure, surface morphology, thickness and transmittance were characterized by X-ray diffraction (XRD), Atomic Force Microscopy (AFM), and spectrophotometer, respectively. Optical constant and energy band gap of the as-deposited films were evaluated from transmission spectra. The results showed that the substrate-target distance, sputtering current and N_2 gas flow rate were affected on the crystal structure and surface morphology of films. The optical constants of the N-doped TiO_2 thin films namely, refractive index and extinction coefficient at wavelength 550 nm were 2.5 and 0.001 – 0.002, respectively. The energy band gap (E_g) of N-doped TiO_2 thin films was found in 2 ranges, 3.20 eV (Anatase phase TiO_2 thin film) and 2.40 eV – 2.60 eV (N-doped TiO_2 thin films). The as-deposited N-doped TiO_2 thin films in this work showed hydrophilic property when exposed to the visible light.

Keywords: thin film, Nitrogen doped titanium dioxide thin films, reactive sputtering, Reactive DC magnetron sputtering, hydrophilic

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัย เรื่อง “การเตรียมฟิล์มบางนาโนของ TiO_xN_y สำหรับประยุกต์ในกระจก ทำความสะอาดตัวเอง” (Deposition of TiO_xN_y nano-Thin Film for Self Cleaning Glass Applications) เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัย จากบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุน จากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการวิจัยนี้สำเร็จลงด้วยดีโดยความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย คณบุรุษวิจัยขอขอบคุณ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ลิ่มสุวรรณ ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับคำปรึกษาที่มีคุณค่าแก่คณบุรุษวิจัย จนเสร็จสิ้นโครงการ ขอขอบคุณ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานตลอดการดำเนินงาน ขอขอบคุณ คุณสมฤทธิ์ หวานระรื่น ฝ่ายวิจัยและบันทึกศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงบุคลากรของงานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานตลอดระยะเวลาดำเนินงานวิจัย ท้ายที่สุดขอขอบคุณภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สนับสนุนด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือใน การดำเนินการวิจัยด้วยดีตลอดมา

นรัնดร์ วิทิตอนันต์
สุรเสิงห์ ไชยคุณ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	i
ABSTRACT	ii
กิตติกรรมประกาศ	iii
สารบัญ	iv
สารบัญตาราง	vi
สารบัญภาพ	vii
 บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	4
1.3 ขอบเขตการศึกษา	4
 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง	5
2.2 การก่อเกิดฟิล์มบาง	7
2.3 ระบบเคลือบแบบ ดีซี สปัตเตอริง	9
2.4 ระบบเคลือบแบบ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง	11
2.5 ระบบเคลือบแบบ อันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง	14
2.6 ไทยเนียมไดออกไซด์	16
2.7 สมบัติไฮโดรฟิลิก	17
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	18

บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง	
3.1 เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง	22
3.2 เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบ รีแอคตีฟ ดีซี สเปตเตอริง	25
3.3 การสร้างสภาพสูญญากาศ	26
3.4 ขั้นตอนการเคลือบฟิล์มบาง	28
3.5 การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง	29
3.6 แนวทางการทดลอง	30
บทที่ 4 ผลและอภิรายผล	
4.1 การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสонаเทส	34
4.2 การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน	46
4.3 สมบัติทางแสงและแบบพลังงานของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน	52
4.4 สมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน	58
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผล	61
5.2 ข้อเสนอแนะ	63
เอกสารอ้างอิง	68
ภาคผนวก	
ผลงานของโครงการวิจัย	69
ประวัตินักวิจัย	91

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3-1 เงื่อนไขการเคลือบเมื่อแปรค่าอัตราไฟลแก๊สออกซิเจน	30
3-2 เงื่อนไขการเคลือบเมื่อแปรค่าความดันรวม	31
3-3 เงื่อนไขการเคลือบเมื่อแปรค่าอัตราไฟลแก๊สในไตรเจน	32
4-1 ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางไฟเทเนียมไดอกไซด์เคลือบที่อัตราไฟลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	36
4-2 ขนาดผลึกของฟิล์มบางไฟเทเนียมไดอกไซด์เคลือบที่อัตราไฟลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	36
4-3 ความหนาและความหมายผิวของฟิล์มบางไฟเทเนียมไดอกไซด์เคลือบที่อัตราไฟลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	39
4-4 ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางไฟเทเนียมไดอกไซด์เฟสอนาคตที่ความดันรวมต่าง ๆ	42
4-5 ขนาดผลึกของฟิล์มบางไฟเทเนียมไดอกไซด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ	42
4-6 ความหนาและความหมายผิวของฟิล์มบางไฟเทเนียมไดอกไซด์เคลือบที่ความดันรวมต่าง ๆ	45
4-7 ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางไฟเทเนียมไดอกไซด์เจือในไตรเจนที่เมื่อใช้อัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	48
4.8 ขนาดผลึกของฟิล์มบางไฟเทเนียมไดอกไซด์เจือในไตรเจนที่อัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	48
4-9 ความหนา และความหมายผิวของฟิล์มบางไฟเทเนียมไดอกไซด์เจือในไตรเจนที่อัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	51
4-10 แบบพลังงานของฟิล์มบางไฟเทเนียมไดอกไซด์เจือและไม่เจือในไตรเจน	56

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 ประเภทของกระบวนการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ	5
2-2 อันตรกิริยาระหว่างไออ่อนกับพื้นผิวสัด	8
2-3 ลักษณะของเครื่องเคลือบสุญญากาศ แบบ ดีซี สปีตเตอริง	10
2-4 ผลของความดันในระบบที่มีต่ออัตราเคลือบ ค่า耶ลล์และกระแสไฟฟ้าในระบบสปีตเตอริง ของนิเกิลที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างข้ออิเล็กโทรดที่วางห่างกัน 4.5 cm	10
2-5 การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก	12
2-6 การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามต่างๆ โดย a , b , c เป็นการเคลื่อนที่ของประจุ ในสนามแม่เหล็กอย่างเดียว ส่วน d และ e เป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุ ในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าร่วมกันในลักษณะต่างๆ	12
2-7 ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กของระบบอันบาลานซ์ แมgnีตرون สปีตเตอริง	15
2-8 เพสของไทยาเนียมไดออกไซด์	16
2-9 สภาพไฮดร็อฟิลิกของกระจกเคลือบฟิล์มไทยาเนียมไดออกไซด์ก่อนและหลังสัมผัสแสง UV	17
3-1 เครื่องเคลือบสุญญากาศระบบบาร์แอคติฟดีซีแมgnีตرونสปีตเตอริงที่ใช้ในงานวิจัย	23
3-2 เครื่อง X-Ray Diffractrometer	23
3-3 เครื่อง Atomic Force Microscope	24
3-4 เครื่อง Spectrophotometer	24
3-5 ชุดวัดมุมสัมผัส	24
3-6 กล้องแสงสำหรับกระตุ้นฟิล์ม	24
3-7 ไดอะแกรมของเครื่องเคลือบในสุญญากาศระบบสปีตเตอริงที่ใช้ในงานวิจัย	25
3-8 ไดอะแกรมระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ของระบบเคลือบสปีตเตอริง	27
4-1 ลักษณะของฟิล์มบางไทยาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบนกระจกสไลด์ ที่อัตราไอลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	34
4.2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทยาเนียมไดออกไซด์ ที่อัตราไอลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	35
4-3 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางไทยาเนียมไดออกไซด์ ที่อัตราไอลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	37
4-4 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไทยาเนียมไดออกไซด์ อัตราไอลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	38

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
4-5 ลักษณะของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์ที่เคลือบบนกระจกสไลด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ	40
4-6 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ	41
4-7 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ	44
4-8 ความหนาและความหยาบผิวของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ	45
4-9 ลักษณะของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจนที่เคลือบบนกระจกสไลด์ที่อัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	46
4-10 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจนที่อัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	47
4-11 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจนที่อัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	50
4-12 ความหนาและความหยาบผิวของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจนที่อัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	51
4-13 การส่งผ่านแสงของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจนที่อัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	52
4-14 ตัวนีหักเหของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจนที่อัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	54
4-15 สัมประสิทธิ์การดับสูญของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจนที่อัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	54
4-16 แถบพลังงานของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์เฟสонаเทส	56
4-17 แถบพลังงานของพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจนที่อัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ	57
4-18 ค่ามุ่สัมผัสกับเวลาการฉายแสงอัลตราไวโอเลตของกระจกที่ไม่เคลือบพิล์ม	58
4-18 ตัวอย่างมุ่สัมผัสของกระจกไม่เคลือบพิล์ม	56
4-19 ค่ามุ่สัมผัสกับเวลาการฉายแสงอัลตราไวโอเลตของกระจกเคลือบพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์เฟสонаเทส	59
4-21 ค่ามุ่สัมผัสกับเวลาการฉายแสงอัลตราไวโอเลตของกระจกเคลือบพิล์มบางไฟเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจน	60

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

การเคลือบผิวสัมผัสในลักษณะของพิล์มบางเป็นการปรับปรุงผิวสัมผาแนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากการทางเคมีและพิสิกส์ แต่การเคลือบด้วยกระบวนการทางเคมีใช้สารละลายเคมีเป็นหลัก ซึ่งหลังการเคลือบมักมีสารละลายเคมีที่เหลือใช้จำนวนมากซึ่งยากต่อการทำจัดอีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย แต่สำหรับการเคลือบพิล์มบางด้วยกระบวนการทางพิสิกส์ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ภาวะสุญญากาศนั้น นอกจะจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังให้พิล์มบางที่มีคุณภาพสูงกว่ากระบวนการทางเคมีอีกด้วย ทำให้มีการนำมาประยุกต์ใช้เคลือบงานด้านต่างๆ มากมาย

ปัจจุบันมีการนำกระจกแผ่นเรียบมาใช้ในด้านต่างๆ มากมาย โดยทั่วไปเมื่อกระจกอยู่ในสภาพปกติ มักมีฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกติดบนผิวน้ำ ซึ่งมักทำความสะอาดได้ยาก และเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการทำความสะอาดแต่ละครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของกระจกแผ่นเรียบที่ติดตามอาคารสูง หรือกระจกรถยนต์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงผิวของกระจกโดยการเคลือบชั้นเคลือบของสารที่มีสมบัติเฉพาะในลักษณะของพิล์มบาง โดยนำไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide, TiO₂) มาเคลือบบนกระจก ส่งผลให้ได้กระจกพิเศษเฉพาะ (functional glass) กล่าวคือเป็นกระจกที่ทำความสะอาดได้ง่าย จนเกือบไม่ต้องทำความสะอาด หรือ ที่เรียกว่า “กระจกทำความสะอาดด้วยตัวเอง (self-cleaning glass)”

การทำความสะอาดด้วยตัวเองของกระจกที่เคลือบด้วยไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์ในลักษณะพิล์มบางนี้ เกิดขึ้นเมื่อกระจกถูกกระตุ้นด้วยแสงอัลตราไวโอเลต แล้วทำให้โมเลกุลของสิ่งสกปรกที่เกาะผิวน้ำกระจกแตกเป็นโมเลกุลเล็กหลุดจากผิวกระจก ขณะเดียวกันก็ปรับสมบัติเชิงผิวของกระจกให้มีสภาพชอบน้ำ หรือไฮdrophilic ซึ่งเมื่อใช้น้ำฉีดไปบนกระจกน้ำจะมีลักษณะเป็นชั้นบางๆ ชำระสิ่งสกปรกให้หลุดออกมาร่วมกับแรงโน้มถ่วงโลก โดยสรุปกระจกทำความสะอาดด้วยตัวเองต้องมีสมบัติสำคัญคือ (1) สมบัติโฟโตแคตัลิติก (photocatalytic) ที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนผิวน้ำกระจก และ (2) สมบัติไฮdrophilic (hydrophilic) เป็นการทำให้น้ำไม่จับตัวเป็นหยดหรือเม็ดบนผิวน้ำกระจกแต่กระจายตัวออกเต็มพื้นที่ของกระจกที่น้ำสัมผัส

กระบวนการสามารถด้วยตัวเองสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น หน้าต่าง บันเกอร์ ประตู เพื่อให้แสดงสมบัติทำการสามารถด้วยตัวเองตลอดเวลา โดยประยุกต์เวลาในการทำการสามารถและน้ำยาทำการสามารถ ทั้งนี้ยังนำมาใช้กับหลังคาและผนังอาคารขนาดใหญ่ เพื่อลดอันตรายต่อผู้ทำการสามารถ อีกด้วย ในประเทศไทยปัจจุบันใช้ทำเนียมไดอกไซด์เคลือบกระจกรอบหลอดไฟในอุโมงค์หรือบนทางด่วน ทำให้หลอดไฟคงประสิทธิภาพและส่องสว่างได้ตลอดเวลา ตลอดจนมีนำสมบัติในการซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล สุขภัณฑ์ และแผ่นกรองของเครื่องปรับอากาศ เพื่อช่วยให้อากาศภายในบ้านบริสุทธิ์ (พرنภา สุจริตวรกุล, 2549)

อย่างไรก็ตามบัติทำการสามารถด้วยตัวเองของกระจกที่เคลือบด้วยฟิล์มบางเทาเนียมไดอกไซด์พบร่วมมีข้อจำกัดในการนำไปใช้งานเนื่องจากต้องใช้แสงอัลตราไวโอเลตกระตุ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว แสงอัลตราไวโอเลตในธรรมชาตินั้นมีความเข้มต่ำ ตั้งนั้นถ้าหากจะทำการสามารถด้วยตัวเองเปิดตั้งภายในอาคาร หรือ บริเวณที่ไม่ได้รับแสงแดดแล้ว กระจกอาจไม่สามารถแสดงสมบัติทำการสามารถด้วยตัวเองได้เต็มที่เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีแสงอัลตราไวโอเลตน้อย จึงมีนักวิจัยหลายกลุ่มที่ศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระจกทำการสามารถด้วยตัวเองสามารถทำงานได้ด้วยแสงในช่วงตามองเห็น

การพัฒนาประสิทธิภาพกระจกชนิดนี้มีหลายแนวทาง เช่น ใช้สารกึ่งตัวนำชนิดอินทร์ เช่น CdS, Cu₂O, Fe₂O₃, WO₃ (Hoffman et al., 1995) และ InTaO₄ (Zou et al, 2001) เนื่องจากดูดกลืนแสงในช่วงตามองเห็นได้ หรือการเจือด้วยไอโอดินของโลหะ เช่น Cr³⁺, Fe³⁺ (Serpone et al., 1994; Takeuchi et al., 2000) ตลอดจนการเจือด้วยอะตอมของโลหะ เช่น N, S และ C ซึ่งทำให้แบบพลังงานของเทาเนียมไดอกไซด์แคลบลง ทั้งนี้พบว่าสารกึ่งตัวนำชนิดอินทร์ที่นำมาใช้นั้นมีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำไม่เพียงพอรวมทั้ง แบบพลังงาน เสถียรภาพทางเคมี และสมบัติไฟโตคตัลไทดิกนั้นยังไม่ดี เช่นเดียวกับการเจือด้วยไอโอดินของโลหะ ในบางกรณีพบว่าฟิล์มไม่แสดงสมบัติไฟโตคตัลไทดิก เมื่อยูนิเต้แสงในช่วงตามองเห็น อีกทั้งแสดงสมบัติไฟโตคตัลไทดิกได้น้อยเมื่อได้รับแสงอัลตราไวโอเลต เนื่องจากมีอัตราการรวมตัวกันของพاهะกับไอโอดินของโลหะ จากรายงานวิจัยของ Asahi et al (2001) ได้เจืออะตอมในโครงสร้างเป็นฟิล์มบางเทาเนียมไดอกไซด์จากการศึกษาพบว่า สเปกตรัมทางแสงเกิดการเลื่อนไปทางด้านแสงสีแดง หรือ ที่เรียกว่าเกิดการ red shift ไปยังความยาวคลื่นเท่ากับ 540 nm

การเตรียมฟิล์มบางเทาเนียมไดอกไซด์นั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น เทคนิค โซล-เจล (Sol-Gel) (Guan, 2005) เทคนิคสปัตเตอริงและการระเหยสารโดยใช้ลำไอโอน (Ion Cluster Beam Deposition) (Barnes, Kumar, Green, Hwang, & Gerson, 2005) ทั้งนี้พบว่าเทคนิคสปัตเตอริงมีข้อดี คือ ควบคุมกระบวนการขณะเคลือบได้ง่าย (Zhoa et al., 2005) ฟิล์มที่ได้มีความทนทานและมีสมบัติการยึดเกาะดี (Wu, Wang, Liu, Chen, & Wu, 2006) รวมถึงยังเปลี่ยนแปลงสมบัติของฟิล์มบางด้วยวิธีการเจือได้ง่าย (Chiu, Chen, Yang, Hsu, & Gan, 2007)

ทั้งนี้การเจืออzoneในไตรเจนส่งผลให้สมบัติและโครงสร้างของฟิล์มบางที่เคลือบได้เปลี่ยนแปลงไป สำหรับการเคลือบฟิล์มบางไฟฟานียมไดออกไซด์ด้วยวิธี รีแอดคตีฟ สป๊ตเตอริงนั้นมีนักวิจัยหลายกลุ่มศึกษา ในประเด็นเงื่อนไขของการเจือกับสมบัติและโครงสร้างของฟิล์มที่ได้ เช่น Chiu et al. (2007) ได้ศึกษา เกี่ยวกับผลของอัตราไฟฟ้าแก๊สในไตรเจนที่มีต่อโครงสร้างระดับจุลภาคและสมบัติไฟฟ้าคงคล่องตัวของ ฟิล์มบางไฟฟานียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วย วิธี ดีซี รีแอดคตีฟ แมgnีตรอน สป๊ตเตอริง อัตราไฟฟ้าแก๊ส ในไตรเจนในช่วง 0 - 20 mV/min และให้ศักย์ไปแอสกับวัสดุรองรับเท่ากับ -50 V พบร่วมกับฟิล์มบางที่เคลือบ ได้มีโครงสร้างผลึกส่วนใหญ่เป็นแบบอนาเทส โดยมีโครงสร้างผลึกแบบบรูไอล์ปนอยู่เล็กน้อย และเมื่ออัตรา ไฟฟ้าแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นทำให้ฟิล์มบางมีความเป็นผลึกลดลง เกรนมีขนาดใหญ่ขึ้น ความหนาแน่นลดลง ความหยาบผิวมีค่าเพิ่มขึ้น โดยที่อัตราไฟฟ้าแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 20 mV/min เกรนมีขนาดเล็กลงและ จัดเรียงตัวกันอยู่หนาแน่น ทั้งนี้การเพิ่มอัตราไฟฟ้าแก๊สในไตรเจนทำให้แถบพลังงานมีค่าลดลงโดยมีค่าอยู่ ระหว่าง 3.15 – 3.35 นอกจากนี้เมื่ออัตราไฟฟ้าแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 5 mV/min ฟิล์มบางแสดงสมบัติไฟฟ้า คงคล่องตัวได้ดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย Prabakar et al. (2008) ที่ศึกษาผลของอัตราไฟฟ้าแก๊ส ในไตรเจนในการเคลือบฟิล์มไฟฟานียมไดออกไซด์ด้วยวิธี ดีซี รีแอดคตีฟ แมgnีตรอน สป๊ตเตอริง พบร่วมกับฟิล์ม บางที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกส่วนใหญ่เป็นเฟสонаเทส โดยมีเฟสรูไอล์ปนอยู่เล็กน้อย เมื่ออัตราไฟฟ้าแก๊ส ในไตรเจนเพิ่มขึ้น ฟิล์มบางมีความเป็นผลึกมากขึ้นและลดลง ค่าแถบพลังงานอยู่ระหว่าง 2.8 – 3.1 eV โดย ที่อัตราไฟฟ้าแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 2 sccm ฟิล์มบางมีค่าแถบพลังงานต่ำที่สุด

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาขั้นตอนการเตรียมฟิล์มไฟฟานียมไดออกไซด์ที่มีสมบัติไฮดรophilic ที่ดีเหมาะสม สำหรับนำมาทำเป็นกระจากระหว่างตัวเอง โดยศึกษาผลของการเจือด้วยอzoneในไตรเจน ที่มีต่อสมบัติไฮดรophilic ของฟิล์มไฟฟานียมไดออกไซด์ ด้วยการควบคุมอัตราไฟฟ้าแก๊สที่ใช้ใน กระบวนการเคลือบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนหลักการพัฒนาทางทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติไฮดรophilic ของ ฟิล์มบางไฟฟานียมไดออกไซด์และเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตกระจากระหว่างตัวเองต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาเทคนิคการเคลือบฟิล์มบางไฟฟานีเมี่ยมโดยออกไซด์แบบเจือในไตรเจนด้วยวีธี ดีซี รีแอคติฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง
2. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไฟฟานีเมี่ยมโดยออกไซด์แบบเจือในไตรเจนที่เคลือบได้
3. เพื่อศึกษาสมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบางไฟฟานีเมี่ยมโดยออกไซด์แบบเจือในไตรเจนที่เคลือบได้

1.3 ขอบเขตการวิจัย

งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงเทคนิคขั้นตอนกระบวนการโดยฟิล์มบางไฟฟานีเมี่ยมโดยออกไซด์ด้วยไนโตรเจนที่เตรียมด้วยวีธีรีแอคติฟ ดีซี สปัตเตอริ่ง ด้วยการใช้ในการศึกษาคือ อัตราไฟลแก๊สในไตรเจนในกระบวนการเคลือบ ในส่วนการวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางที่ได้นั้นจะใช้เทคนิค XRD เพื่อศึกษาเฟสและโครงสร้างผลึกและใช้เทคนิค AFM เพื่อศึกษาลักษณะพื้นผิวและความหนา สำหรับสมบัติทำความสหภาคตัวเองของฟิล์มบางที่เคลือบได้พิจารณาจาก สมบัติไฮโดรฟิลิก ซึ่งพิจารณาจากค่ามุสัมผัสของฟิล์ม ภายหลังสัมผัสแสงอัลตราไวโอเลตและแสงในช่วงตามองเห็น

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง

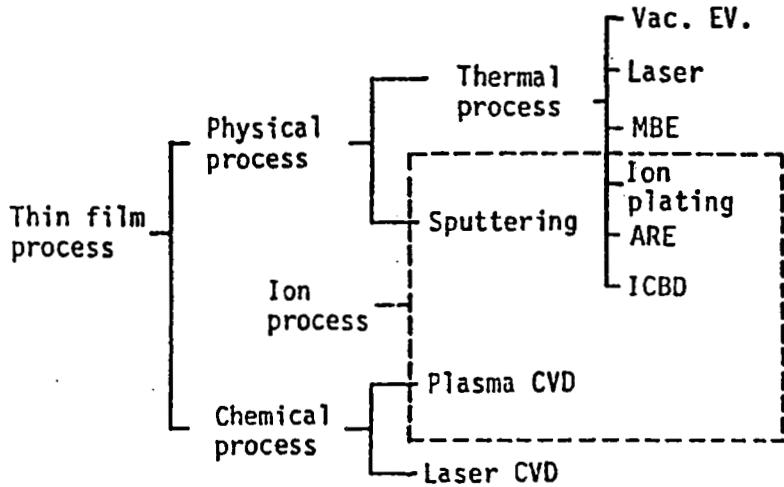
การเคลือบฟิล์มบาง (Thin Film) ในสัญญาศาสตร์แรกทำโดย Bunsen และ Grove ในปี คศ.1852 ทั้งนี้ การเคลือบในสัญญาศาสตร์หรือการเคลือบฟิล์มบาง คือ การเรียงตัว (Fabricated) โดยการตกเคลือบ (Deposition) ของสารเคลือบในลักษณะอะตอมเดี่ยวนวัสดุรองรับ (Substrate) จนเกิดเป็นชั้นของฟิล์มที่บางในระดับนาโนเมตร อาจกล่าวได้ว่า “ฟิล์มบาง (Thin Film)” หมายถึง ชั้นของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่จับรวมกันเป็นชั้นบาง ๆ ปัจจุบันมีการนำฟิล์มบางมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สารกึ่งตัวนำ ฟิล์มตัวนำ และฟิล์มตัวต้านทาน หรืองานด้านหัศนศาสตร์ เช่น เลนส์ กระจกสะท้อนแสง กระจกสะท้อนความร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการเคลือบฟิล์มบางในการเตรียมสารตัวอย่างสำหรับใช้ในการศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุในรูปของฟิล์มบาง ซึ่งสมบัติบางอย่างไม่สามารถวัดได้เมื่อยูในสภาพเป็นก้อน (Bulk) เพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาวัสดุเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม

การเคลือบฟิล์มบางเป็นกระบวนการที่ทำให้สารเคลือบตกลงบนผิววัสดุรองรับที่ต้องการซึ่งสามารถทำได้ทั้งกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการทางฟิสิกส์ โดยพื้นฐานแล้วกระบวนการเคลือบฟิล์มบางมีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน (Smith, 1995) ดังนี้คือ

1. การสร้างสารเคลือบ (Source) โดยทั่วไปแล้วสารเคลือบอาจอยู่ในรูปของ ของแข็ง ของเหลว ไอ หรือแก๊ส ก็ได้ แต่สารเคลือบทั่วๆ ไปจะเป็นต้องอยู่ในรูปของไอระเหยเท่านั้น ซึ่งวิธีการทำให้สารเคลือบกลายเป็นไอระเหยสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การให้ความร้อนหรือการระดมยิงด้วยอนุภาคที่มีพลังงานสูง เป็นต้น

2. การเคลื่อนย้ายสารเคลือบมายังวัสดุรองรับ (Transport) ในภาวะสัญญาศาสตร์ไอระเหยของสารเคลือบอาจจะมีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ไปยังวัสดุรองรับ หรืออาจจะเคลื่อนที่ไปในลักษณะของไอล ซึ่งจะทำให้ไอระเหยของสารเคลือบมีการชนกับอนุภาคอื่นภายในภาชนะสัญญาศาสตร์ นอกจากนี้ไอระเหยอาจจะเคลื่อนที่ไปยังวัสดุรองรับในลักษณะของพลาสมาก็ได้

3. การสะสมพอกพูน (Deposition) เป็นขั้นตอนการพอกพูนของสารเคลือบและโถเข็นจนกลายเป็นชั้นของฟิล์มบางบนวัสดุรองรับ ขั้นตอนนี้จะขึ้นกับเงื่อนไขของวัสดุรองรับหรือการทำปฏิกริยาของสารเคลือบกับวัสดุรองรับ ความสะอาดของผิววัสดุรองรับ ตลอดจนพลังงานที่ใช้ในการเคลือบ



ภาพที่ 2-1 ประเภทของกระบวนการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ (Wasa & Hayakawa, 1992)

การเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (Wasa & Hayakawa, 1992) (ภาพที่ 2-1) ได้แก่

1. การเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการทางเคมี (Chemical Process) เป็นการเคลือบที่อาศัยการแตกตัวของสารเคมีในสภาพของแก๊สแล้วเกิดปฏิกิริยาเคมีกลایเป็นสารใหม่ (New Species) ตกเคลือบบนวัสดุรองรับ เช่น วิธี Plasma CVD และ วิธี Laser CVD เป็นต้น
2. การเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการทางพิสิกส์ (Physical Process) เป็นการเคลือบที่อาศัยการทำให้อหอตอมของสารเคลือบทลุดออกจากผิวแล้วฟุ้งกระจายหรือวิ่งเข้าไปจับและยึดติดกับผิวของวัสดุรองรับ เช่น วิธีระเหยสาร (Evaporation) และ วิธีสปัตเตอริง (Sputtering) เป็นต้น

สำหรับการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศด้วยกระบวนการทางพิสิกส์นั้นจะอาศัยการทำให้อหอตอมของสารเคลือบทลุดออกจากผิวของสารเคลือบทั้งตัน แล้วฟุ้งกระจายวิ่งไปจับและยึดติดกับผิวของวัสดุรองรับ แล้วพอ กพุนเป็นชั้นของฟิล์มบางในที่สุด สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีหลักๆ (พิเชษฐ์ ลิ่มสุวรรณ และธนัสสา รัตนะ, 2547; Wasa & Hayakawa, 1992) คือ

1. การเคลือบด้วยวิธีระเหยสาร (Evaporation) เป็นการพอกพุนของชั้นฟิล์มบางของสารเคลือบที่ทำให้ระเหยซึ่งเกิดขึ้นในสุญญากาศ ทำได้โดยการให้ความร้อนที่มากพอที่จะทำให้สารเคลือบกลایเป็นไอซึ่งไอของสารเคลือบนี้จะฟุ้งไปกระทบกับวัสดุรองรับที่มีอุณหภูมิเหมาะสมก็จะเกิดการควบแน่นของสารเคลือบและพอกพุนโดยเป็นชั้นของฟิล์มบางต่อไป การให้ความร้อนในการระเหยสารเคลือบทาได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้และไม่ยุ่งยากคือการให้ความร้อนแก่ภาชนะบรรจุสารเคลือบด้วยวิธีทางไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีวิธีอื่น เช่น การให้ความร้อนจากตัวต้านทาน (Resistive Heating) การระเหยแบบวาวแสง (Flash Evaporation) การระเหยด้วยเลเซอร์ (Laser Evaporation) การระเหยด้วยลำอิเล็กตรอน (Electron Beam Evaporation) การระเหยด้วยการอาร์ค (Arc Evaporation) การให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Heating) การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีนี้นิยมใช้เคลือบสารไดอิเล็กทริก (Dielectric) เช่น แมgnีเซียมไดฟลูออไรด์ (MgF_2) หรือ ออกไซด์ (Oxide) ของโลหะที่มีสมบัติโปร่งใสบนวัตถุที่ต้องการ

เคลือบ เช่น เลนส์กล้องถ่ายรูป แวนต้าและกระจกเลเซอร์ ฯลฯ สำหรับข้อเสียของการเคลือบวิธีนี้คือแรงยึดติดระหว่างสารเคลือบและวัสดุรองรับจะไม่สูงนักจึงต้องอาศัยกระบวนการอบด้วยความร้อนหรืออุ่นช่วยให้การยึดเกาะของสารเคลือบดีขึ้น นอกจากนี้ฟิล์มบางที่ได้อาจมีการเป็นเปื้อนของสารที่ใช้ทำภาชนะบรรจุสารเคลือบได้ ถ้าภาชนะบรรจุสารเคลือบมีจุดหลอมเหลวต่ำหรือใกล้เคียงกับสารเคลือบ

2. การเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริง (Sputtering) เป็นการพอกพูนของชั้นฟิล์มบางของสารเคลือบที่ได้จากการกระบวนการสปัตเตอริง การเคลือบด้วยวิธีนี้เกิดขึ้นเมื่ออัตโนมัติของสารเคลือบที่ได้จากการกระบวนการสปัตเตอริงวิ่งเข้าชนวัสดุรองรับและมีการพอกพูนเป็นฟิล์มบางในที่สุด กระบวนการสปัตเตอริง คือ การทำให้อัตโนมัติจากผิวของวัสดุโดยการชนของอนุภาคพลังงานสูงโดยมีการแลกเปลี่ยนพลังงานและโมเมนตัมระหว่างอนุภาคที่วิ่งเข้าชนกับอัตโนมัติที่ผิวสารเคลือบ เนื่องจากไออกอนที่ได้จากการกระบวนการสปัตเตอริงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่าวิธีการระเหยสารมาก ดังนั้นเมื่ออัตโนมัติของสารเคลือบวิ่งเข้ากระทบแผ่นวัสดุรองรับก็จะฝังตัวแน่นลงในเนื้อวัสดุที่ต้องการเคลือบมากกว่าวิธีระเหยสาร ดังนั้นการเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริง จะทำให้การยึดเกาะระหว่างสารเคลือบกับวัสดุรองรับดีกว่า

2.2 การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง

การเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริงเป็นการพอกพูนของสารเคลือบจากการกระบวนการสปัตเตอร์ การเคลือบเกิดขึ้นเมื่ออัตโนมัติของสารเคลือบที่ได้จากการกระบวนการสปัตเตอร์วิ่งเข้าชนวัสดุรองรับและมีการพอกพูนและโตเป็นฟิล์มบางในที่สุด กระบวนการสปัตเตอริงคือการทำให้อัตโนมัติจากผิวของวัสดุโดยการชนของอนุภาคพลังงานสูงแล้วมีการแลกเปลี่ยนพลังงานและโมเมนตัมระหว่างอนุภาคที่วิ่งเข้าชนกับอัตโนมัติที่ผิวสารเคลือบ โดยอนุภาคที่วิ่งเข้าชนอาจเป็นกลางทางไฟฟ้าหรือมีประจุกได อีกทั้งยังมีพลังงานสูงดังนั้นเมื่ออัตโนมัติของสารเคลือบวิ่งกระทบแผ่นวัสดุรองรับก็จะฝังตัวลงในเนื้อวัสดุมากกว่าวิธีระเหยสารทำให้การยึดเกาะดีมาก (พิเชฐ ลิมสุวรรณ และ รันสสา รัตนะ, 2547; Chapman, 1980)

เมื่อผิวหน้าของวัสดุจะลดลงด้วยอนุภาคพลังงานสูงจะทำให้เกิดการสึกกร่อนและมีอนุภาคที่ผิวหน้าของวัสดุนั้นหลุดมา เนื่องจากการชนของอนุภาคพลังงานสูงกับอนุภาคที่ผิวหน้า ปรากฏการณ์ที่อนุภาคผิวหน้าวัสดุหลุดออกมานี้เรียกว่า สปัตเตอร์ (Sputter) หรือสปัตเตอริง (Sputtering) กระบวนการสปัตเตอริงนี้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมาโดย Grove ซึ่งในขณะนั้นสปัตเตอริงเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความเสียหายกับค่าトイดและกริดในหลอดดิสชาร์จแต่ปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เช่น การทำความสะอาดผิวหน้า (Surface Cleaning) การกัดเซาะ (Etching) การวิเคราะห์ชั้นผิวหน้าของวัสดุ (Surface Layer Analysis) และการเคลือบฟิล์มบาง

สำหรับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสปัตเตอริ่ง (ภาพที่ 2-2) อธิบายได้ดังนี้

1. อันตรกิริยะระหว่างไออ่อนและผิวเป้าสารเคลือบ เมื่อวิ่งชนผิวน้ำวัสดุจะเกิดปรากฏการณ์ดังนี้

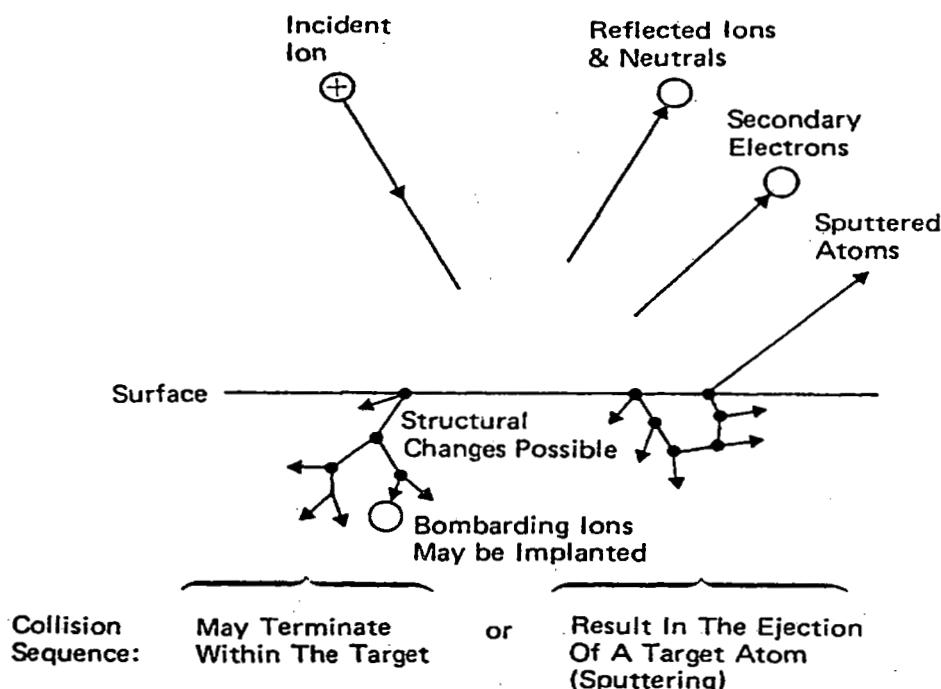
1.1 การสะท้อนที่ผิวน้ำของไออ่อน (Reflected Ion and Neutral) ไออ่อนอาจสะท้อนกลับจากผิวน้ำซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนออกมานิรูปของอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอันเกิดจากการรวมตัวกับอิเล็กตรอนที่ผิวเป้าสารเคลือบ

1.2 การปลดปล่อยอิเล็กตรอนชุดที่สอง (Secondary Electron Emission) จากการชนของไออ่อนอาจทำให้เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนชุดที่สองจากเป้าสารเคลือบถ้าไออ่อนนั้นมีพลังงานสูงพอ

1.3 การฝังตัวของไออ่อน (Ion Implantation) ไออ่อนที่วิ่งชนเป้าสารเคลือบนั้นอาจฝังตัวลงในสารเคลือบ โดยความลึกของการฝังตัวจะแปรผันโดยตรงกับพลังงานไออ่อน ซึ่งมีค่า $10 \text{ วั้ง sterom/} \text{พลังงานไออ่อน } 1 \text{ keV}$ สำหรับไออ่อนของแก๊สอาร์กอนที่ฝังตัวในห้องเดง

1.4 การเปลี่ยนโครงสร้างของผิวน้ำเป้าสารเคลือบ (Target Material Structural Rearrangements) การชนของไออ่อนบนผิวสารเคลือบที่ทำให้เกิดการเรียงตัวของอะตอมที่ผิวสารเคลือบใหม่และเกิดความบกพร่องของผลึก (Lattice Defect) โดยเรียกว่าจัดตัวใหม่ของโครงสร้างผิวน้ำว่า Altered Surface Layer

1.5 การสปัตเตอร์ (Sputter) การชนของไออ่อนอาจทำให้เกิดกระบวนการชนกันแบบต่อเนื่องระหว่างอะตอมของเป้าอันทำให้เกิดการปลดปล่อยอะตอมจากเป้าสารเคลือบซึ่งเรียกว่ากระบวนการสปัตเตอริ่ง



ภาพที่ 2-2 อันตรกิริยะระหว่างไออ่อนกับพื้นผิวน้ำ (Chapman, 1980)

2. กระบวนการสปัตเตอริง เป็นกระบวนการที่อะตอมผิวน้ำของวัสดุถูกทำให้หลุดออกจากด้วย การชนของอนุภาคพลังงานสูง โดยมีการแลกเปลี่ยนพลังงานและโมเมนต์ระหว่างอนุภาคที่วิ่งเข้าชนกับ อะตอมที่ผิวน้ำดังกล่าว กระบวนการนี้อนุภาคที่วิ่งเข้าชนอาจเป็นกลางทางไฟฟ้าหรือมีประจุได้ดังนั้นสิ่งที่ จำเป็นในกระบวนการสปัตเตอริง คือ

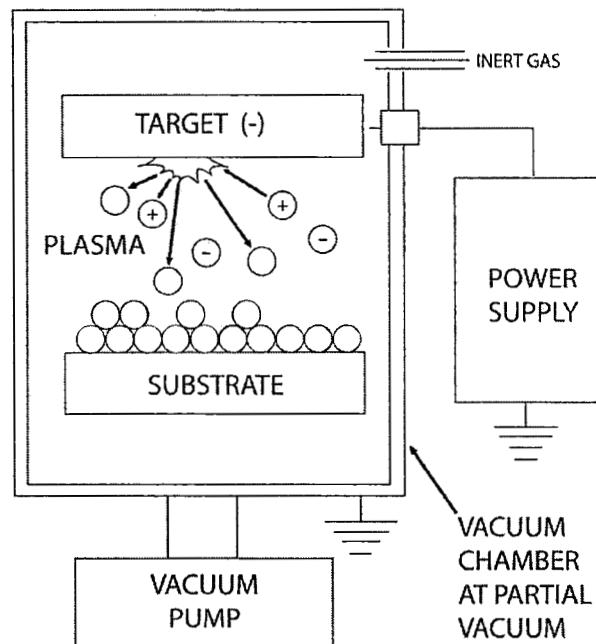
2.1 เป้าสารเคลือบ ทำหน้าที่เป็นเป้าให้อนุภาคพลังงานสูงวิ่งเข้าชนมีการปลดปล่อยอะตอม ของสารเคลือบลงเคลือบบนวัสดุรองรับ

2.2 อนุภาคพลังงานสูง ซึ่งวิ่งชนเป้าสารเคลือบ แล้วทำให้อะตอมของเป้าสารเคลือบทหลุด ออกมา ปกติอนุภาคพลังงานสูงนี้อาจเป็นกลางทางไฟฟ้า เช่น นิวตรอน หรืออะตอมของธาตุต่าง ๆ โดยการ เร่งไอนอนของแก๊สในสนามไฟฟ้าเป็นอนุภาควิ่งชนเป้าสารเคลือบซึ่งให้อัตราการปลดปล่อยเป้าสารเคลือบ สูงเพียงพอ กับความต้องการ

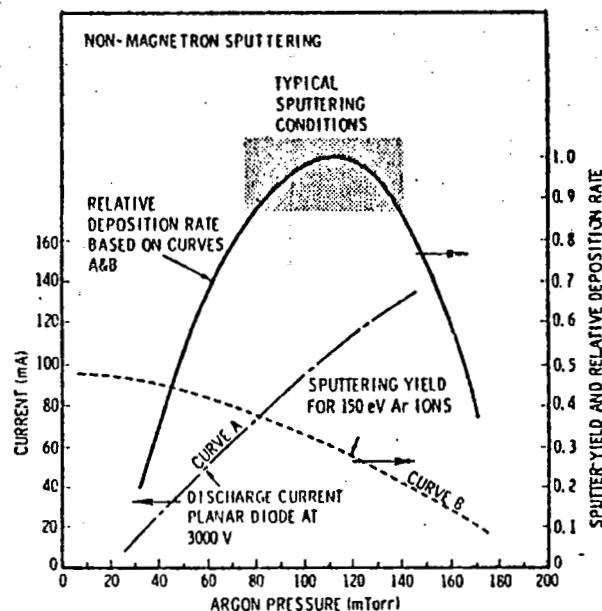
2.3 การผลิตอนุภาคพลังงานสูง อนุภาคพลังงานสูงในระบบสปัตเตอริงนี้จะต้องถูกผลิตขึ้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการเคลือบเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจนได้ความหนาพิล์มบางตามต้องการ ซึ่งทำ ได้หลายวิธี เช่น ใช้ลำอนุภาคจากปืนไออกอนที่มีปริมาณการผลิตไออกอนในอัตราสูง หรือจากกระบวนการ โกล์วิดิษาร์จ เมื่อจากปืนไออกอนมีรากค่าค่อนข้างสูงและไออกอนในพื้นที่แคบ กระบวนการสปัตเตอริง ทั่วไปในระดับอุตสาหกรรมจึงนิยมใช้กระบวนการโกล์วิดิษาร์จในการผลิตอนุภาคพลังงานสูง

2.3 ระบบเคลือบแบบ ดีซี สปัตเตอริง

ระบบเคลือบแบบ ดีซี สปัตเตอริง อย่างง่ายที่สุด แสดงได้ดัง ภาพที่ 2-3 (พิเชชฐ์ ลิ้มสุวรรณ และธนสักา รัตน์, 2547; Bunshah, 1982; Smith, 1995) ซึ่งประกอบด้วยค่าトイด คือ แผ่นเป้า สารเคลือบและอาโนด คือ ที่วางวัสดุรองรับหรือชิ้นงานที่ต้องการเคลือบ ปกติระยะระหว่างค่าトイดและ วัสดุรองรับจะอยู่ระหว่าง 4 cm - 10 cm เพื่อป้องกันการสูญเสียอะตอมสารเคลือบที่ผ่านของภาชนะ สูญญาณ โดยทั่วไประยะดาร์คสเปช อยู่ระหว่าง 1 cm - 4 cm โดยอาโนดจะอยู่บริเวณนาทีฟโกล์ว ส่วนอุปกรณ์ทำงานจะอยู่ในช่วงขอบnor์มอลโกล์วิดิษาร์จ แก๊สที่ใช้เป็นแก๊สเฉียบซึ่งให้ยืดสูงและไม่ทำ ปฏิกิริยากับสารเคลือบ (ปกติใช้แก๊สอาร์กอน) ขณะเกิดโกล์วิดิษาร์จ กระบวนการไออกอนจะรักษา สภาพโกล์วิดิษาร์จไว้ทราบที่ระยะดาร์คสเปชไม่มากกว่าระยะระหว่างค่าトイดและอาโนด เมื่อความดัน ลดลงหรือแรงดันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดสูงขึ้น ระยะปลดการชนของอิเล็กตรอนจะสูงขึ้น ทำให้ระยะ ดาร์คสเปชขยายตัวออกและแหล่งพลังไออกอนในระบบมีปริมาตรน้อยกระแสน้ำลดลงและอะตอมที่ถูก สปัตเตอร์มีปริมาณลดลงตามปริมาณของไออกอนและกระแสไฟฟ้าในระบบ ที่ความดันต่ำกว่า 10^{-2} mbar ระยะดาร์คสเปชจะยาวกว่าระยะระหว่างอิเล็กโทรด และกระแสไฟฟ้าลดลงสู่ศูนย์ ทำให้กระบวนการผลิต ไออกอนสิ้นสุดลงและไม่มีอะตอมหลุดออกจากเป้าสารเคลือบเนื่องจากการสปัตเตอร์อีก



ภาพที่ 2-3 ลักษณะของเครื่องเคลือบสุญญากาศ แบบ ดีซี สปัตเตอริ่ง

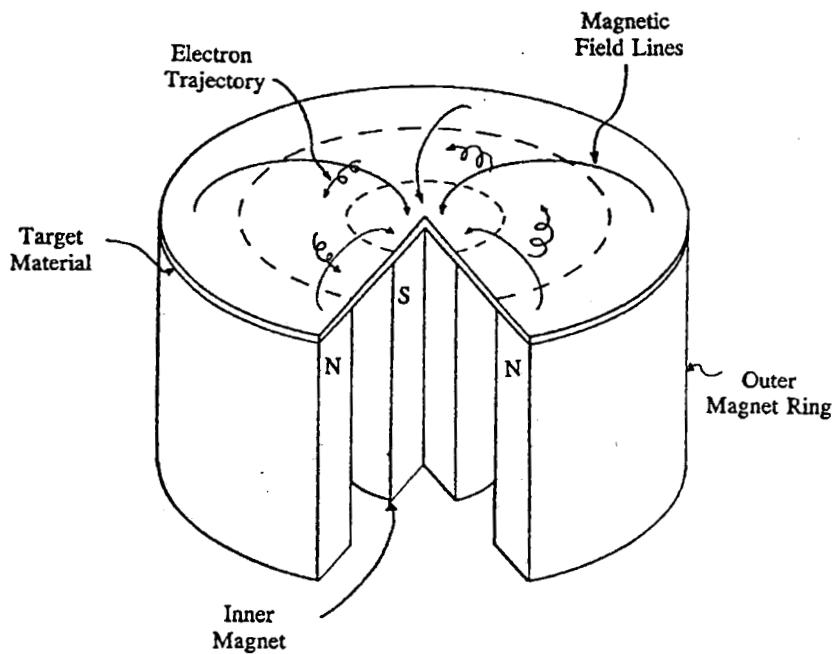


ภาพที่ 2-4 ผลของความดันในระบบที่มีผลต่ออัตราเคลือบ ค่าyield และกระแสไฟฟ้าในระบบสปัตเตอริ่งของนิกелиที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างขั้วอิเล็กโตรด ที่ห่างกัน 4.5 cm (Vossen & Kerns, 1978)

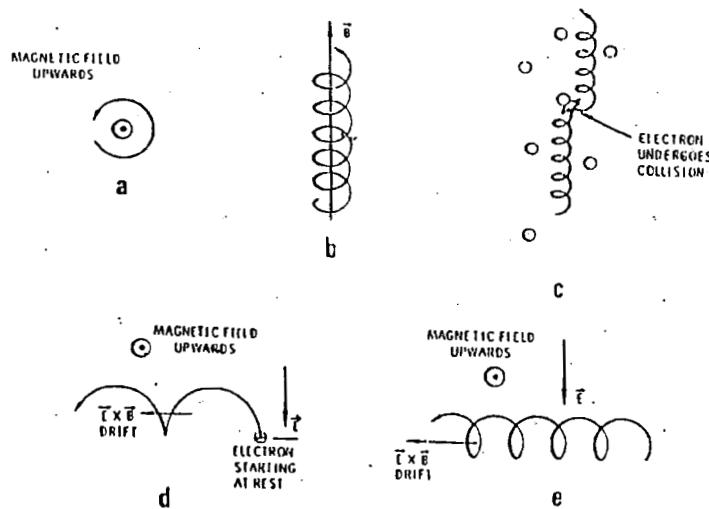
ขณะที่ความดันสูงขึ้นจะมีผลต่อการผลิตไออกอนมีปริมาตรสูงขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเพิ่มขึ้นและกระบวนการสปัตเตอร์ริงเกิดขึ้นในอัตราสูงตามความดัน ดังแสดงในภาพที่ 2-4 เส้นกราฟ A ขณะที่ความดันภายในระบบสูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อการชนระหว่างโมเลกุลของแก๊สมีค่าลดลง ขณะที่ความดันภายในเครื่องบินจะสูงกว่าสุดของรับได้จากภาระน้ำหนักตัวของเครื่องบิน ผลกระทบต่อการสปัตเตอร์มีค่าลดลง แต่เมื่อความดันสูงขึ้น ดังภาพที่ 2-4 เส้นกราฟ B ผลรวมระหว่างยีลเดอร์และกระแสไออกอนจะทำให้อัตราการเคลือบมีค่าสูงสุดที่ความดันค่าหนึ่งทั้งนี้พบว่าการสปัตเตอร์นิกีลเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า $3,000\text{ V}$ ระหว่างขั้วอิเล็กโตรดที่วางห่างกัน 4.5 cm ในแก้วส่วนก้อน การเคลือบจะหยุดที่ความดันมีค่าต่ำกว่า $2.6 \times 10^{-4}\text{ mbar}$ และที่ความดันสูงกว่า $1.6 \times 10^{-5}\text{ mbar}$ โดยอัตราเคลือบจะมีค่าสูงสุด และลดลงเมื่อความดันสูงเกินค่านี้ ดังนั้นบริเวณที่เหมาะสมกับกระบวนการสปัตเตอร์ริงคือบริเวณที่ให้อัตราเคลือบสูงและประสิทธิภาพดีที่สุด จากภาพที่ 2-10 พบว่าความดันที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบคือ $1.0 \times 10^{-5}\text{ mbar}$ ความหนาแน่นกระแสประมาณ 1.0 mA/cm^2 ด้วยอัตราเคลือบ $0.036\text{ }\mu\text{m/min}$ ซึ่งค่อนข้างต่ำในขณะที่ใช้แรงดันไฟฟ้าค่อนข้างสูง (พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ และธนัสสถา รัตนะ, 2547)

2.4 ระบบเคลือบแบบ ดีซี แมกนีตرون สปัตเตอร์

อัตราการเกิดสปัตเตอร์นั้นจะขึ้นกับผลคูณระหว่างยีลเดอร์และปริมาณไออกอนที่วิ่งชนเป้าสารเคลือบ ดังนั้นการเพิ่มอัตราการสปัตเตอร์นั้นนอกจากจะทำได้โดยการเพิ่มยีลเดอร์แล้วยังทำได้โดยการเพิ่มปริมาณไออกอนที่วิ่งเข้าชนเป้าสารเคลือบ ซึ่งในระบบ ดีซี สปัตเตอร์ ปกตินั้น ทำได้เพียงการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า ระหว่างอิเล็กโตรด หรือเพิ่มความดัน ซึ่งจะมีขีดจำกัดสูงสุดที่ ความหนาแน่นกระแสประมาณ 1 mA/cm^2 และความดันประมาณ $1.33 \times 10^{-5}\text{ mbar}$ นอกจากนี้ยังพบว่าในระบบ ดีซี สปัตเตอร์ ทั่วไปอัตราเคลือบต่ำกว่าในฟิล์มบางที่ได้มีค่าสูงด้วย (พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ และธนัสสถา รัตนะ, 2547) ต่อมามีการพัฒนาระบบที่มีคือ ระบบดีซี แมกนีตرون สปัตเตอร์ ซึ่งเป็นการใช้สนามแม่เหล็กช่วย โดยจ่ายสนามแม่เหล็กให้มีทิศทางกับผิวน้ำเป้าสารเคลือบและมีทิศตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าซึ่งจะช่วยเพิ่มระยะเวลาเดินของอิเล็กตรอนให้ยาวขึ้น โดยจำนวนของสนามแม่เหล็กจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นทางโค้ง (ภาพที่ 2-6) ทำให้การไออกอนซึ่งมีค่าสูงขึ้นทำให้อัตราการสปัตเตอร์สูงขึ้นด้วย



รูปที่ 2-5 การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก (Bunshah, 1994)



รูปที่ 2-6 การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามต่างๆ โดย a , b , c เป็นการเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็ก อาย่างเดียว ส่วน d และ e เป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า ร่วมกันในลักษณะต่างๆ (Bunshah, 1994)

ทั้งนี้จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก พบร้าถ้าอิเล็กตรอนมีพิสทางการเคลื่อนที่ตั้งจากกับสนามแม่เหล็ก อิทธิพลของสนามแม่เหล็กจะทำให้อุปภาคประจุนั้นเคลื่อนที่ในแนววงกลม (ภาพที่ 2-6 (a)) ด้วยรัศมี

$$r = \frac{3.37 \sqrt{W}}{B} \quad (2-2)$$

เมื่อ W คือพลังงานของอิเล็กตรอนในหน่วย eV

B คือความเข้มสนามแม่เหล็กในหน่วย gauss หมุนด้วยความถี่ไซโคลotron

$$v = 2.8 \times 10^6 \text{ Hz}$$

ถ้าพลังงานเฉลี่ยของอิเล็กตรอนในแนวตั้งจากกับสนามแม่เหล็กมีค่า 10 eV และสนามแม่เหล็กมีค่าความเข้ม 100 gauss รัศมีการหมุนมีค่าเท่ากับ 0.1 cm ด้วยความถี่การหมุนเท่ากับ 2.8×10^8 Hz ภาพที่ 2-6 (b) แสดงอิเล็กตรอนมีความเร็วส่วนหนึ่งในแนวขานกับสนามแม่เหล็กอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่หมุนคงรอบแนวสนามแม่เหล็กด้วยจำนวนเส้นแรงคงที่ค่านั้นระหว่างน้ำถ้าอิเล็กตรอนชนกับอะตอมแก๊ส ภาพที่ 2-6 (c) แนวการหมุนคงรอบสนามแม่เหล็กจะเปลี่ยนไป ถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ภายในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าซึ่งมีพิสทางตั้งจากกัน จำนวนของสนามทั้งสองนอกจากจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในแนวโคล์ดแล้วยังสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวตั้งจากกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบลอยเลื่อน (Drift motion) มีค่าเท่ากับ

$$V_d = \frac{10^8 E}{B} \quad (2-3)$$

เมื่อ E คือสนามไฟฟ้าน่วยเป็น V/cm

B คือความเข้มสนามแม่เหล็กในหน่วย gauss

กรณีสนามไฟฟ้าบริเวณดาร์คสเปชมีค่าประมาณ 1,000 V/cm และสนามแม่เหล็กมีค่าประมาณ 100 gauss จะให้ค่าความเร็วรอยเลื่อน (Drift Velocity) เท่ากับ 107 m/s ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างสูงกรณีพลังงานเริ่มต้นของอิเล็กตรอนมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับพลังงานที่ได้รับจากสนามไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะเป็นรูป Cycloid ดังภาพที่ 2-6 (d) ถ้าอิเล็กตรอนมีพลังงานเริ่มต้นสูงกว่าพลังงานที่ได้รับจากสนามไฟฟ้า การเคลื่อนที่แบบลอยเลื่อน จะอยู่ในแนววงกลมซ้อนกันดังแสดงในภาพที่ 2-6 (e) พฤติกรรมที่ปรากฏต่ออิเล็กตรอนนี้จะเด่นชัดมาก ถึงแม้จะใช้สนามแม่เหล็กมีค่าน้อย ๆ ระหว่าง 50 - 500 gauss แต่มีผลในการเบี่ยงเบนแนวทางเดินของไอออน (ซึ่งมีมวลสูงกว่าอิเล็กตรอนมาก) อย่างไม่เด่นชัด

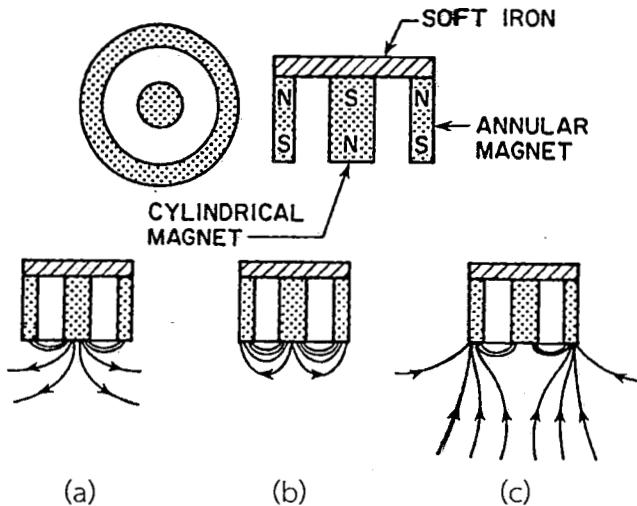
2.5 ระบบเคลือบแบบ อันบาลานซ์ เมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง

ถ้ามีการระดมยิงไอออนระหว่างการเกิดฟิล์มจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฟิล์มหลายอย่าง เช่น พฤติกรรมการเกิดนิวเคลียส (Nucleation Behaviour) สัณฐานวิทยา (Morphology) องค์ประกอบ (Composition) ทิศทางการจัดเรียงตัว และสมบัติเชิงกล เป็นต้น ในกรณีเมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง ไอออนที่ใช้ในการระดมยิงวัสดุรองรับจะมาจากการประจุไฟฟ้าที่อยู่รอบวัสดุรองรับ ซึ่งทำได้โดยการจ่ายศักย์ลบประมาณ 1 - 500 V ให้กับวัสดุรองรับ อย่างไรก็ได้ความหนาแน่นกระแสที่ฟิล์มหรือผิวน้ำของวัสดุรองรับ สำหรับ ระบบดีซี เมกนีตรอน ปกติจะมีค่าต่ำประมาณ 0.05 - 0.10 ไอออน/อะตอมสารเคลือบ (Rohde & Munz, 1991)

สำหรับการเคลือบแข็ง (Hard coating) ฟิล์มบางที่ต้องการนั้นจะต้องมีช่องว่าง (Voids) ในเนื้อฟิล์ม น้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ฟิล์มบางที่ได้นั้นมีความทนต่อการกัดกร่อน (Corrosion) และทนต่อการขัดสี (Wear Resistance) มากยิ่งขึ้น โดยการลดช่องว่างในเนื้อฟิล์มนี้สามารถทำได้โดยการเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้า ให้กับวัสดุรองรับ แต่ก็จะทำให้เกิดความเดินและความบกพร่อง (Defects) ภายในเกรน (Grain) ของฟิล์ม มากขึ้นเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะทำให้คุณภาพของฟิล์มและการยึดติดของฟิล์มกับวัสดุ รองรับลดลง ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยการเพิ่มความหนาแน่นของกระแสไอออน (อัตราส่วนของไอออน/อะตอมสารเคลือบ) ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ระบบเคลือบแบบอันบาลานซ์ เมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง (Unbalanced Magnetron Sputtering) (Rohde & Munz, 1991; Sproul, 1992)

ระบบอันบาลานซ์ เมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง ได้รับการคิดค้นและพิมพ์เผยแพร่โดย Window และ Savvides ครั้งแรกในปี ค.ศ.1986 โดยทั้งสองพบว่าการติดตั้งแม่เหล็กที่ค่าโอดของระบบสปัตเตอริ่งปกติ นั้น ถ้าหากทำให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กด้านใดด้านหนึ่งมากหรือน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งแล้ว สนามแม่เหล็กที่ค่าโอดจะมีลักษณะไม่สมมาตร ทำให้ปริมาณไอออนที่วิ่งเข้าชนหรือระดมยิงวัสดุรองรับนั้น มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของฟิล์มโดยตรงการจัดแม่เหล็กของระบบนี้อาจ แบ่งเป็น 3 แบบ คือความเข้มสนามของแม่เหล็กที่ด้านในมากกว่าด้านนอก (ภาพที่ 2-7 (a)) หรือกลับกัน (ภาพที่ 2-7 (c)) หรือไคล์เดียงกัน (ภาพที่ 2-7 (b))

ถ้าจัดแม่เหล็กตามภาพที่ 2-7 (a) ไอออนที่ระดมยิงวัสดุรองรับจะมีค่าต่ำ (อัตราส่วนไอออน/อะตอมสารเคลือบประมาณ 0.25 : 1) ส่วนการจัดแม่เหล็กตามภาพที่ 2-7 (c) ไอออนที่ระดมยิงวัสดุรองรับจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นทำให้อัตราส่วนไอออน/อะตอมสารเคลือบมีค่าสูงขึ้นคือประมาณ 2 : 1 (เมื่อใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่ม) ปัจจุบันมีนักวิจัยหลายกลุ่มที่นำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งมีทั้งที่ใช้แม่เหล็กแบบถาวรและแม่เหล็กไฟฟ้า จากการศึกษาของ Musil และ Kadlec ที่ระบบเคลือบใช้อันบาลานซ์พลาสมา เมกนีตรอนเดี่ยวและขาด漉ดแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ชด เคลือบไฟฟ้านามัยมีไตรด์ที่ระยะเป้าสารเคลือบและวัสดุรองรับประมาณ 200.0 mm โดยใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าในช่วง -5 ถึง -100 V พบร่วมกับการเคลือบแบบวัสดุรองรับประมาณ 6.0 mA/cm² ซึ่งสูงมากพอสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม (Munz, 1991)



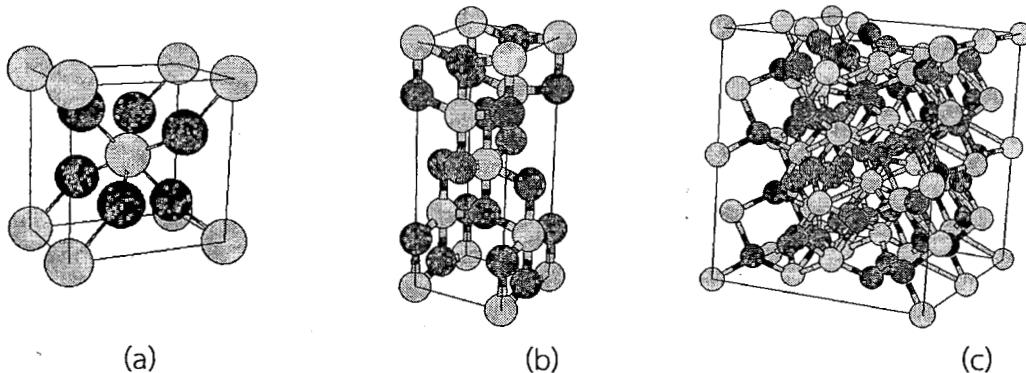
ภาพที่ 2-7 ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กของระบบอันบาลานซ์ แมgnitoron สปัตเตอริ่ง
(Rickerby & Matthews, 1991)

หากพิจารณาเปรียบเทียบระบบสปัตเตอริ่งทั้ง 3 ระบบจะพบว่าในกรณีระบบสปัตเตอริ่งปกตินั้น อิเล็กตรอนที่เกิดจากการไอออกอินซ์จะวิ่งไปจับที่อโนดโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสปัตเตอร์เลย ดังนั้น เพื่อให้ระบบสปัตเตอริ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีแนวคิดที่จะนำอิเล็กตรอนเหล่านี้เข้ามาช่วยในการกระบวนการสปัตเตอร์ซึ่งทำได้โดยการใช้สนามแม่เหล็กช่วยจึงเกิดระบบแมgnitoron สปัตเตอริ่ง ซึ่งเป็นที่ใช้สนามแม่เหล็กช่วยทำให้เกิดอิเล็กตรอนบริเวณหน้าค่าโทดเพิ่มขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนเหล่านี้จะมีส่วนช่วยทำให้กระบวนการสปัตเตอริ่งคงอยู่อย่างต่อเนื่อง จากจำนวนของสนามแม่เหล็กจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นทางโถงทำให้เกิดการไอออกในช่องตอนแก๊สเฉียบสูงขึ้น นอกจากนี้สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ายังทำให้การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่วิ่งเข้าชนเป้าสารเคลือบมีลักษณะเป็นการชนแบบซ้ำๆ ต่อเนื่องกันทำให้เกิดอิเล็กตรอนชุดที่สองออกมานในปริมาณมากขึ้นซึ่งทำให้เกิดการสปัตเตอร์มากตามไปด้วย แต่ก็ยังมีอิเล็กตรอนบางส่วนที่มีพลังงานสูงซึ่งสามารถหลุดออกจากอำนาจของสนามแม่เหล็กนี้ได้ซึ่งจะวิ่งเข้าหาข่าวโนดโดยทันที สำหรับในระบบอันบาลานซ์ แมgnitoron สปัตเตอริ่ง นั้นอิเล็กตรอนพลังงานสูงที่หลุดออกจากอำนาจของสนามแม่เหล็กจะถูกยึดไว้ด้วยเส้นแรงแม่เหล็กส่วนเกินของระบบแล้วเคลื่อนที่เป็นทางโถงไปตามเส้นแรงแม่เหล็กเข้าชนกับช่องตอนของแก๊สเฉียบและเกิดการไอออกอินซ์เป็นพลาสม่าชุดที่สองบริเวณผิวน้ำของวัสดุรองรับทำให้ความหนาแน่นกระแสที่วัสดุรองรับมีค่าสูงมากกว่าในระบบแมgnitoron สปัตเตอริ่ง ปกติมาก (ประมาณ $5.0 - 10.0 \text{ mA/cm}^2$ ปกติมีค่าน้อยกว่า 1.0 mA/cm^2) โดยพลาสม่าที่เกิดขึ้นนี้จะมีส่วนช่วยในการเคลือบฟิล์มที่เรียกว่า Ion-Assisted Deposition ซึ่งจะให้ฟิล์มบางที่ได้นั้นมีความหนาแน่นสูงและมีการยึดติดดีมาก (Munz, 1991)

2.6 ไฟฟานียมไดออกไซด์

โครงสร้างของไฟฟานียมไดออกไซด์เกิดจากอะตอมของไฟฟานียมจับกับอะตอมของออกซิเจน ซึ่งการจับกันมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ เพราะไฟฟานียมมีประจุเป็น Ti^0 , Ti^{2+} , Ti^{3+} และ Ti^{4+} ส่วนออกซิเจนมีประจุเป็น O_2^- ทำให้มีโอกาสรวมกันเป็น TiO ที่มีโครงสร้างเป็นเฟสเซ็นเตอร์ คิวบิก (Face Center Cubic, Fcc) (TiO_x ($0.9 \leq x \leq 1.5$)) ซึ่งเป็นฟิล์มที่มีความแข็งมาก Ti_2O_3 มีโครงสร้างเป็นไตรโอกอนอล (Trigonal) และ TiO_2 มีโครงสร้างเป็นเตตራโอกอนอล (Tetragonal) ซึ่งเป็นฟิล์มที่มีดัชนีหักเหสูง เป็นต้น โครงสร้างเหล่านี้มีการจับตัวกันด้วยพันธะสมของไอออนิก (Ionic) โคเวเลนต์ (Covalent) และพันธะโลหะ (Metallic) ฟิล์มเหล่านี้มีลักษณะที่โปร่งแสง สีของฟิล์มเปลี่ยนตามโครงสร้าง นั่นคือเปลี่ยนตามปริมาณออกซิเจนที่ให้ โดยค่อยๆ เปลี่ยนจากสีเหลืองทอง (Golden Yellow) คือ TiO_{1+x} ($0 \leq x \leq 0.25$) ไปเป็นน้ำตาล (Brown) ไปเป็นสีน้ำเงินเข้ม (Dark Blue) และไปเป็นโปร่งใสเมื่อสี (Transparent) คือ TiO_{1+x} ($0.95 \leq x \leq 1$) (Bally, Hones, Sanjines, Schmid, & Levy, 1998)

ไฟฟานียมไดออกไซด์ว่าเป็นสารประกอบออกไซด์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มวิจัยทั่วโลกเนื่องจากมีสมบัติที่น่าสนใจหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติทางแสง อาทิ สมบัติการส่งผ่านแสง มีค่าดัชนีหักเหสูง มีเสถียรภาพทางเคมี (Jin, Miao, Tanemura, Xu, Tazawa, and Yoshimura , 2003) ทำให้มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในงานด้านหัศนศาสตร์และการเคลือบเพื่อป้องป้องผิว รวมทั้งงานทางด้านเส้นใยแก้วนำแสง ปกติไฟฟานียมไดออกไซด์มี 3 เฟส ได้แก่ รูไทล์ อนาคต และ บรูไกท์ เพสอนาคตและเฟสรูไทล์มีโครงสร้างผลึก (Crystal Structure) เป็นแบบเตตราโอกอนอล (Tetragonal) ส่วนเฟสบรูไกท์มีโครงสร้างเป็นแบบออร์โทรมบิก (Orthorhombic) ซึ่งเหมาะสมสำหรับงานต่างๆ กัน เช่น เพสอนาคต มีสมบัติตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง นิยมนำมาใช้ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กระจกที่มีสมบัติโพโต喀탈ลิส ส่วนเฟสรูไทล์ จะมีความสามารถในการทำอุปกรณ์ที่ใช้ในร่างกาย เช่น ลิ้นหัวใจเทียม เป็นต้น



ภาพที่ 2-8 เฟสของไฟฟานียมไดออกไซด์

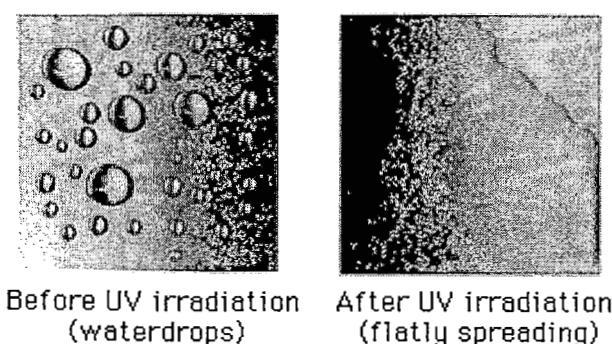
(a) เฟสรูไทล์ (b) เพสอนาคต (c) เพสบรูไกท์

2.7 สมบัติไฮโดรฟิลิก

ไฮโดรฟิลิกเป็นสมบัติสำคัญของกระเจาทำความสะอาดด้วยตัวเอง โดย พรนภา สุจิตรกุล (2548) อธิบายไว้ว่าเมื่อไหานีมไดออกไซด์ถูกกระตุนด้วยแสงอัลตราไวโอเลต น้ำที่เกาะบนพื้นผิวของไหานีมไดออกไซด์ไม่สามารถคงตัวอยู่เป็นหยดน้ำได้ แต่กระเจาเป็นพิล์มบางๆ ปกคลุมผิวอย่างสม่ำเสมอทำให้กระเจานั้นแห้งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอหรือคราบสิ่งสกปรกให้เห็น ผลให้กระเจาไม่เป็นฝ้ามัวเนื่องจากมุ่สัมผัสของกระเจาที่เคลือบด้วยพิล์มไหานีมไดออกไซด์ มีค่าต่ำกว่าจนเป็นศูนย์ ที่เรียกว่า สภาพไฮโดรฟิลิกยิ่งขวด (Super-Hydrophilicity) ปกตินั้นผิวของกระเจาเมื่อมีความชื้นในอากาศมาสัมผัสก็จะเกิดเป็นหยดน้ำเล็กจำนวนมากมาเกาะได้ง่าย ทำให้เกิดเป็นฝ้ามัว และโดยทั่วไปแล้วมุ่สัมผัสระหว่างหยดน้ำกับผิวของกระเจามีค่าอยู่ที่ประมาณ 20-30 องศา หยดน้ำบนผิวจึงคงสภาพเป็นหยดดังภาพที่ 2-9

สมบัติไฮโดรฟิลิกของไหานีมไดออกไซด์ พิจารณาจากค่ามุ่สัมผัสระหว่างหยดน้ำกับวัสดุรองรับซึ่งแบ่งเป็น (1) ไฮโดรฟิลิก (Hydrophilic) และ (2) ไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic) โดยสภาพไฮโดรฟิลิก มีค่ามุ่สัมผัสของหยดน้ำอยู่กว่า 90 องศา (Mardare, Luca Teodorescu, & Macovei, 2007) ถ้ามุ่สัมผัสมีค่าน้อยกว่า 5 องศา เรียกว่า สภาพไฮโดรฟิลิกยิ่งขวด (Super-Hydrophilic) (Zhao et al., 2005) ในขณะที่สภาพไฮโดรโฟบิกมุ่สัมผัสมีค่ามากกว่า 90 องศา และถ้ามุ่สัมผัสมีค่ามากกว่า 150 องศา จะเรียกว่า สภาพไฮโดรโฟบิกยิ่งขวด (Super-Hydrophobic) (McHale, Shirtcliffe, & Newton, 2004)

สำหรับกลไกในการเกิดสภาพไฮโดรฟิลิกของพิล์มบางไหานีมไดออกไซด์ Guan (2005) ได้อธิบายไว้วัดนี้ สภาพไฮโดรฟิลิกของไหานีมไดออกไซด์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหานีมไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารก่อตัวนำได้รับแสงอัลตราไวโอเลต ทำให้เกิดคู่ของอิเล็กตรอนกับไฮด์โรด โดยอิเล็กตรอนจะรีดิวช์ Ti (IV) Cation เป็น Ti (III) ส่วนไฮด์โรดจะออกซิเดช์ซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน (O_2^-) และในกระบวนการนี้จะทำให้อะตอมของออกซิเจนหลุดออกจากเกิดสภาพว่างขาดออกซิเจน (Oxygen Vacancy) ขึ้น ดังนั้นโมเลกุลของน้ำจึงสามารถเข้ามาแทนที่บริเวณดังกล่าวจนทำให้เกิดการดูดซึบหมู่ไฮดรอกรอกซิล (OH) ซึ่งหมู่ดังกล่าวจะช่วยให้ไหานีมไดออกไซด์มีสภาพไฮโดรฟิลิก



ภาพที่ 2-9 สภาพไฮโดรฟิลิกของกระเจาเคลือบพิล์มไหานีมไดออกไซด์ก่อนและหลังสัมผัสแสง UV

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Chen et al. (2004) ศึกษาการเจือในไตรเจนในฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนแผ่นอลูมิเนียมด้วย วิธี รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง (Reactive Magnetron Sputtering) และให้อุณหภูมิแผ่นอลูมิเนียมเท่ากับ 300°C นำฟิล์มที่ได้ไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวโดยใช้เทคนิค AFM และทดสอบสมบัติไฟโตเคตตัลไลติก โดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การลดลงของ benzamide จากการศึกษาพบว่าฟิล์มบางมีโครงสร้างผสมของเฟสอนาคตและรูไทล์ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของโครงสร้างผลึกเฟสอนาคตมากกว่า และเมื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจน ทำให้เปอร์เซ็นต์ของโครงสร้างผลึกเฟสอนาคตลดลงและเพิ่มขึ้น เกรนของฟิล์มบางมีขนาดใหญ่ขึ้น และฟิล์มบางแสดงสมบัติไฟโตเคตตัลไลติกได้ดีขึ้น โดยที่เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนเท่ากับ 80% ฟิล์มบางแสดงสมบัติไฟโตเคตตัลไลติกดีที่สุด

Vaz et al. (2004) ศึกษาการเตรียมฟิล์มไทเทเนียมออกซิไนไตรด์ที่มีสี โดยวิธี อาร์เอฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆ เช่น การให้สักกี้เบแอดและอัตราการไหลของแก๊สไวปฏิกิริยา ผลการศึกษาพบว่าสีของฟิล์มเปลี่ยนจากสีทองสว่าง (Shiny golden) เป็นสีน้ำเงินเข้มเนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนต่ำ (ลักษณะของฟิล์มไทเทเนียมในไตรด์) ถึงสีน้ำเงินเข้มเนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนสูง องค์ประกอบของฟิล์มวิเคราะห์โดยเทคนิค Rutherford backscattering spectrometry (RBS) ผลของการเสียบแบบรังสีเอกซ์ (XRD) แสดงให้เห็นการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกแบบ face-centred-cubic ฐาน (111) (ไทเทเนียมในไตรด์มีค่าคงที่และทิชประมาณ 0.429 nm) และการกระจายของเฟสออกไซด์ (oxide phases) ผลการวัดความแข็งด้วยเทคนิค Nanoindentation พบร่วมความแข็งของฟิล์มอยู่ระหว่าง 20 และ 40 GPa ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและโครงสร้างจุลภาคของฟิล์ม ความเค้นอัดของฟิล์มมีค่าอยู่ระหว่าง -0.5 และ -0.6 GPa

Silveyra et al. (2005) ศึกษาการเจือในไตรเจนด้วยวิธีทางความร้อน (Thermal Treatment) ในฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) โดยกำหนดให้อุณหภูมิในการ treatment เท่ากับ 600, 700 และ 800°C แล้วนำฟิล์มที่ได้ไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วย XRD วัดสมบัติทางแสงและทดสอบสมบัติไฟโตเคตตัลไลติกของสารละลายฟีโนลด้วยเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ จากการศึกษาพบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้ มีโครงสร้างผลึกส่วนใหญ่เป็นเฟสอนาคต โดยมีโครงสร้างผลึกเฟสอนาคตและรูไทล์เท่ากับ 80% และ 40% ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่ออุณหภูมิ treatment เพิ่มขึ้น พบร่วมอัตราส่วนของโครงสร้างผลึกเฟสอนาคตฐาน 101 ต่อโครงสร้างผลึกเฟสรูไทล์ฐาน (110) มีค่าลดลง แต่พลังงานมีค่าลดลงอยู่ในช่วง 2.88 – 3.01 eV นอกจากนี้ที่อุณหภูมิ treatment เท่ากับ 600°C พบร่วมฟิล์มบางแสดงสมบัติไฟโตเคตตัลไลติกดีที่สุด

Herman, Sicha, and Musil (2006) ศึกษาลักษณะเฉพาะและวิธีการเตรียมการเจือในไตรเจนในพิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ ด้วยวิธีรีแอคตีฟ แมgnีตرون สปัตเตอร์ริง จากเป้าสารเคลือบไทเทเนียม (Ti) ในแก๊สผสมของ Ar / O₂ / N₂ โดยไม่ให้ความร้อนแก่สัดส่วนรับ การสปัตเตอร์พิล์มไทเทเนียมออกซิไนไตรดีใช้ระบบ Dual magnetron แหล่งจ่ายไฟแบบ dc bipolar pulsed ปริมาณของไนโตรเจนในพิล์มไทเทเนียมออกซิไนไตรด้มีอยู่ในช่วง 5 ถึง 40 at.%. โครงสร้างของพิล์มวิเคราะห์ด้วยเทคนิค X-ray diffraction (XRD) ช่องว่างแถบพลังงาน (Optical Band Gap) คำนวณจาก Tauc plot และการลดลงของมุ่งสัมผัส (α_{ir}) หลังการฉายแสงอัลตราไวโอเลตชั้นอยู่กับปริมาณของไนโตรเจน (N at.%) พิล์มไทเทเนียมออกซิไนไตรด์มีสีเหลืองเมื่อปริมาณของไนโตรเจนสูงประมาณ 8 at.% ซึ่งทำให้ช่องว่างแถบพลังงานมีค่าลดลงเป็น 2.7 eV การเจือในไตรเจนในพิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณที่น้อยกว่า 6 at.% ทำให้พิล์มที่ได้ใส่มีลักษณะดับนานโน (เฟสอนาคต+รูไอล์)

Wong, Chou, and Yang (2006) ศึกษาการเจือในไตรเจนในพิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO_xN_y) เตรียมโดยวิธีรีแอคตีฟ แมgnีตرون สปัตเตอร์ริง ของเป้าสารเคลือบไทเทเนียมในแก๊สผสมอาร์กอน, ออกซิเจนและไนโตรเจนที่ก่อตัวในพิล์มตามสัดส่วนของแก๊สในไตรเจน (F_{N2}) มี 2 แบบคือในไตรเจนที่เข้าไปในเฟสอนาคตของไทยาเนียและในไตรเจนที่เข้าไปในเฟสไทเทเนียมในไตรด์ (TiN) สัดส่วนของแก๊สในไตรเจนมีค่าจาก 0 ถึง 0.57 พิล์ม TiO_xN_y มีโครงสร้างอนาคตเมื่อมีไนโตรเจนระหว่าง 1.0 ถึง 1.4 at.% และพิล์มแสดงการเลื่อนไปทางสีแดง ไปยังความยาวคลื่นประมาณ 500 nm จากการดูดกลืนแสงประมาณ 380 nm ของการไม่เจือไทเทเนียมไดออกไซด์ การเจือในไตรเจนในพิล์มอย่างรวดเร็วในไตรเจนไอกอนที่มีพลังงานในพลาสม่าจะทำให้พิล์มที่ได้มีสมบัติความเป็นโพโตคัทไอลิกในช่วงตากองเห็น เมื่อสัดส่วนของแก๊สในไตรเจนมากกว่า 0.75 ทำให้ปริมาณในไตรเจนมี 20.8 at.% ซึ่งทำให้เกิดพิล์มไทเทเนียมในไตรด์ที่มีลักษณะทึบและทำลายการเกิดโพโตคัทไอลิก

Chiu et al. (2007) ศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สในไตรเจนที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติโพโตคัทไอลิกของพิล์มบางไหเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วย วิธี ดีซี รีแอคตีฟ แมgnีตرون สปัตเตอร์ริง อัตราไหลแก๊สในไตรเจนอยู่ในช่วง 0 - 20 mL/min และให้ศักย์ในแอกซิบาร์สุดสูงรับเท่ากับ -50 V พบร้า พิล์มบางที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกส่วนใหญ่เป็นเฟสอนาคต และมีโครงสร้างผลึกเฟสรูไอล์ปนอยู่เล็กน้อย และเมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นทำให้พิล์มบางมีความเป็นผลึกลดลง เกรนมีขนาดใหญ่ขึ้น ความหนาแน่นลดลง ความชุรุยะมีค่าเพิ่มขึ้น และท่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 20 mL/min พบร้า เกรนมีขนาดเล็กและจัดเรียงตัวกันอยู่หนาแน่น ทั้งนี้การเพิ่มอัตราไหลแก๊สในไตรเจนทำให้แถบพลังงานมีค่าลดลงโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 3.15 – 3.35 eV พิล์มบางแสดงสมบัติโพโตคัทไอลิกมากขึ้นและลดลงโดยท่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 5 mL/min พิล์มบางแสดงสมบัติโพโตคัทไอลิกได้ดีที่สุด

Luca et al. (2007) ศึกษาการผลของความดันของแก๊สในไตรเจนที่เจือไปในฟิล์มบาง $TiO_{2-x}N_x$ ที่เคลือบด้วยวิธี อาร์ เอฟ แมกนีตرون สปีตเตอริง จากนั้นนำฟิล์มบางที่เคลือบได้ไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD และทดสอบสมบัติไฮดรophilic ด้วยการวัดมูมสัมผัส จากการศึกษาพบว่าฟิล์มบางที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกเฟสสองของอัณฑูรและอนาเทสกับรูไทล์ เมื่อความดันของแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ weight percent ของโครงสร้างผลึกเฟสอนาคตเพิ่มขึ้นและลดลงโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 50 % แบบพัลส์งานมีค่าเพิ่มขึ้นและลดลงโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.20 eV ทั้งนี้ยังพบว่าฟิล์มบางที่ผ่านการเจือทั้งหมดจะส่งผ่านแสงในช่วงตามองเห็นแต่ส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลตลดลงอย่างมาก และยังแสดงสภาพขอบน้ำแบบบึงยาวเมื่อได้รับแสงอัตราไวโอเลตจนถึงแสงในช่วงตามองเห็นได้

Park and Heo (2007) ศึกษาการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมโดยออกไซด์และฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจน ด้วยวิธี ดีซี รีแอคติฟ แมกนีตرون สปีตเตอริง เพื่อนำไปใช้ในการเคลือบฟิล์มบางบนวัสดุรองรับขนาดใหญ่ จากนั้นนำฟิล์มบางที่เคลือบได้ไปอบอ่อนในบรรยายกาศแก๊สในไตรเจนที่อุณหภูมิ $300 - 500^{\circ}\text{C}$ และนำเป็นวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD วัดความหนาและลักษณะพื้นผิวด้วยเทคนิค FE-SEM วัดค่าความหยาบผิวด้วยเทคนิค AFM สุดท้ายศึกษาสมบัติทางแสงและสมบัติไฟฟ์โพร็อกตัลไลติกด้วยเครื่องUV-vis spectrophotometer จากการศึกษาพบว่าฟิล์มบางที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกส่วนใหญ่เป็นเฟสอนาคต และเมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มขึ้น พบร่องรอยของผลึกเฟสรูไทล์ ลักษณะพื้นผิวใกล้เคียงกัน ฟิล์มบางมีความหยาบผิวดลงโดยมีค่าความหยาบผิวอยู่ระหว่าง $13.2 - 15.9 \text{ \AA}$ นอกจากนี้เมื่อเจือด้วยไนโตรเจนพบว่าฟิล์มบางที่เคลือบได้เกิดเลื่อนไปทางสีแดงและแสดงสมบัติไฟฟ์โพร็อกตัลไลติกที่ความยาวคลื่นในช่วงตามองเห็นได้

Hernández-Rodríguez et al. (2008) ศึกษาการเจือในไตรเจนในฟิล์มไทเทเนียมโดยออกไซด์ (TiO_xN_y) เตรียมด้วยวิธีรีแอคติฟ แมกนีตرون สปีตเตอริง จากเป้าสารเคลือบไทเทเนียม (Ti) ในแก๊สผสมอาร์กอนออกซิเจนและไนโตรเจน องค์ประกอบของฟิล์มแบบตามอัตราการไอล $O_2 : N_2$ โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มวิเคราะห์ด้วยเทคนิค X-ray diffraction (XRD) และ UV-vis spectroscopy ตามลำดับ สเปกตรัมรังสีเอกซ์สำหรับอัตราการไอล $O_2 : N_2$ ที่แตกต่างกันแสดงถึงการเกิดฟิล์มไทเทเนียมได้ออกไซด์มีความเป็นผลึกมากขึ้นเมื่อปริมาณแก๊สในไตรเจนในแซมเบอร์ต่ำสุด ปริมาณไนโตรเจนในแซมเบอร์เปลี่ยนเพสไทเทเนียมโดยออกไซด์เป็นเฟสอนาคต สำหรับปริมาณแก๊สในไตรเจนสูงสุด diffractrogram แสดงเพสไทเทเนียมไนโตรดในฟิล์มเท่านั้น ค่าการส่องผ่านแสงและค่าซึ่งว่างแบบพัลส์งานเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการไอล $O_2 : N_2$ เพิ่ม และเมื่ออัตราการไอล $O_2 : N_2$ ต่ำสุด ฟิล์ม TiO_xN_y มีลักษณะทึบและการดูดกลืนแสงเปลี่ยนเป็นค่าต่ำ

Liu et al. (2008) ศึกษาโครงสร้างและสมบัติไฟฟ้าคงตัวของพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไนโตรเจน โดยเคลือบด้วยวิธี อาร์ เอฟ รีแอคติฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง เป็นเวลา 90 นาที กำลังไฟฟ้าในการเคลือบท่ากับ 75, 95 และ 130 W จากเทคนิค XRD พบว่า พิล์มบางที่เคลือบได้มีความเป็นผลึกต่ำ และเมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น พิล์มบางทั้งหมดมีความเป็นผลึกมากขึ้นโดยมีโครงสร้างผลึกเฟสอนาคต แต่มีความเป็นผลึกน้อยกว่าพิล์มที่ไม่ได้เจือด้วยไนโตรเจน ทั้งนี้ค่า d-spacing ยังลดลงด้วย จากเทคนิค SEM พบว่าการเจือไนโตรเจนเป็นการทำลายความเป็นผลึกของพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์ นอกจากนี้เมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นพิล์มบางมีความหนามากขึ้น และพลังงานลดลงโดยมีค่าอยู่ในช่วง 2.7 – 3.11 eV สุดท้ายเมื่อนำพิล์มบางไปทดสอบสมบัติไฟฟ้าคงตัว พบว่าพิล์มบางที่เจือแล้วแสดงสมบัติไฟฟ้าคงตัวที่ความยาวคลื่นในช่วงแสงอัตราไวโอลেตลดลง แต่เมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น พิล์มบางแสดงสมบัติไฟฟ้าคงตัวที่ความยาวคลื่นในช่วงตามองเห็นได้ดีขึ้น

Prabakar et al. (2008) ศึกษาการเพิ่มอัตราไฟลแก๊สในไนโตรเจนในกระบวนการเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์ด้วยวิธี ดีซี รีแอคติฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง จากนั้นนำพิล์มบางที่เคลือบได้มาวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD วัดความหนาด้วยเครื่อง Surface Profiler วัดค่าการส่งผ่านแสงด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์และทดสอบสมบัติไฟฟ้าคงตัวโดยเทคนิค FTIR จากการศึกษาพบว่าพิล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกส่วนใหญ่เป็นเฟสอนาคตโดยมีโครงสร้างผลึกเฟสรูไทร์ปนอยู่เล็กน้อย และเมื่ออัตราไฟลแก๊สในไนโตรเจนเพิ่มขึ้นพบว่าพิล์มมีความเป็นผลึกมากขึ้นและลดลง มีการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงขึ้นและมีการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่ำลง มีค่าແบพพลังงานอยู่ระหว่าง 2.8 – 3.1 eV โดยที่อัตราไฟลแก๊สในไนโตรเจนเท่ากับ 2 sccm พิล์มบางมีค่าແบพพลังงานต่ำที่สุดและการดูดกลืนแสงเปลี่ยนจากความยาวคลื่น 390 nm ไปเป็น 490 nm.

บทที่ 3

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

3.1 เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ดังนี้

1. การเตรียมพิล์มบาง

1.1 เครื่องเคลือบสูญญากาศ ระบบ ดีซี แมกนีตرون สปัตเตอริง (ภาพที่ 3-1)

1.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

1.2.1 เป้าสารเคลือบ (target) ไทยเนียม ความบริสุทธิ์ 99.97 %

1.2.2 วัสดุรองรับ (Substrate) มี 2 ชนิดคือ

- กระจกแผ่นเรียบ สำหรับทดสอบการเคลือบ

- แผ่นชิลิกอน สำหรับใช้หาลักษณะเฉพาะของพิล์มบาง

1.2.3 แก๊ส (Gas) ประกอบด้วยแก๊ส 2 ชนิดคือ

- แก๊สอาร์กอน (99.999%) เป็นแก๊สสปัตเตอร์ (Sputtered Gas)

- แก๊สออกซิเจน (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา (Reactive Gas)

- แก๊สไนโตรเจน (99.995%) เป็นแก๊สเจือ (Doped Gas)

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพิล์มบาง

2.1 X-Ray Diffractometer สำหรับศึกษาโครงสร้างผลึก ใช้เครื่อง X-ray Diffractometer

Bruker รุ่น D8 โดยใช้ Cu-K α ($\lambda = 1.54056 \text{ \AA}$) (ภาพที่ 3-2)

2.2 Atomic Force Microscope สำหรับศึกษาความหนา และลักษณะพื้นผิว ใช้เครื่อง Atomic Force Microscope รุ่น Nanoscope IV (Veeco Instruments Inc.) (ภาพที่ 3-3)

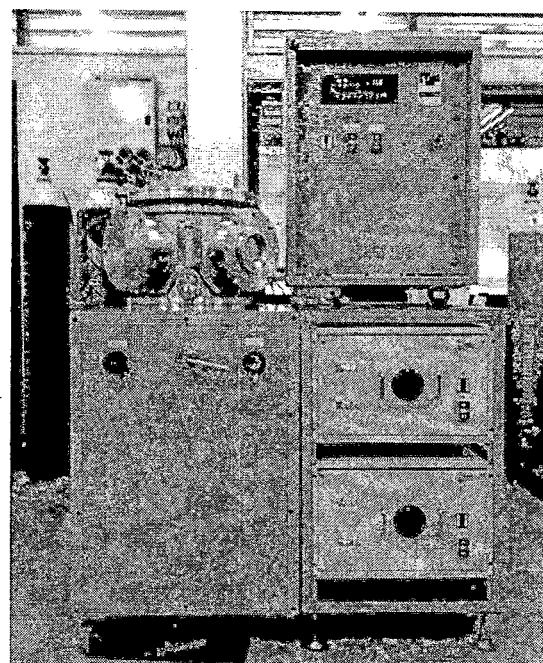
2.3 Spectrophotometer สำหรับวัดค่าการส่งผ่านแสงในช่วง 200-2500 nm ใช้เครื่อง Spectrophotometer รุ่น UV-VIS-NIR 3600 (Shimadzu Co., Ltd) (ภาพที่ 3-4)

3. การทดสอบสมบัติไฮโดรฟิลิกของพิล์มบาง

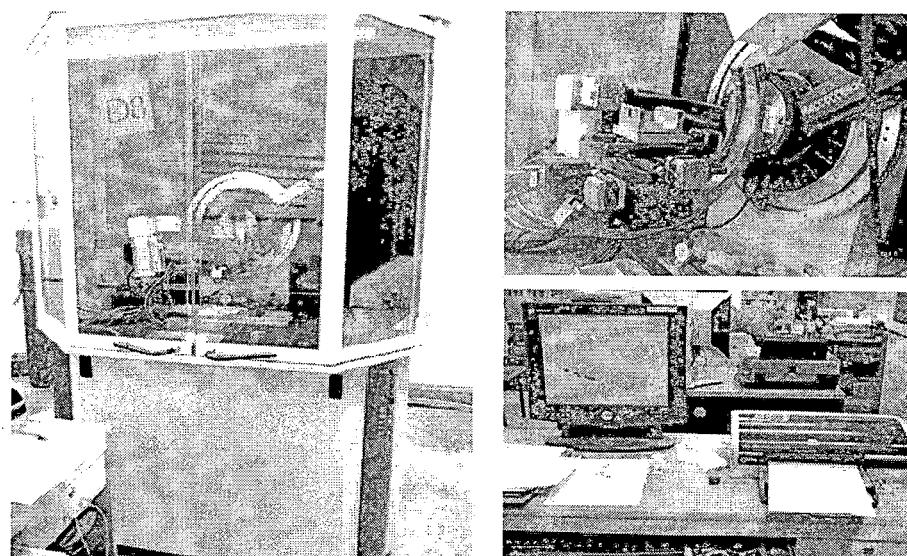
3.3 เครื่องวัดมุมสัมผัส สำหรับวัดมุมสัมผัสของน้ำที่หยดบนผิวน้ำของพิล์ม เพื่อศึกษาสมบัติไฮโดรฟิลิก เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ เครื่องวัดมุมสัมผัส รุ่น (Erma Tokyo) (ภาพที่ 3-5)

3.4 ชุดฉายแสง สำหรับเนี่ยน้ำให้พิล์มเกิดสมบัติไฮโดรฟิลิก เป็นกล่องแสงปิดสนิท มีเท่นวางชิ้นงาน ใช้หลอด UV และ หลอดฟูออร์เซน เป็นแหล่งกำเนิดแสง (ภาพที่ 3-6)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แเสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131



ภาพที่ 3-1 เครื่องเคลือบสุญญากาศระบบบริแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงที่ใช้ในงานวิจัย



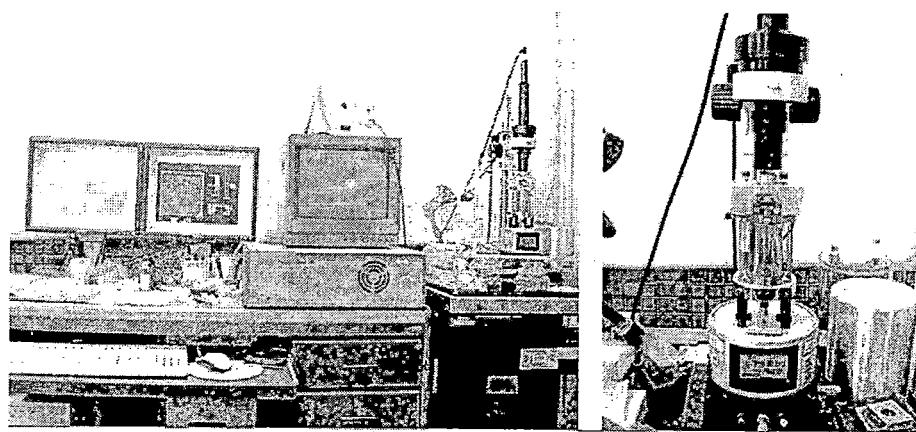
ภาพที่ 3-2 เครื่อง X-Ray Diffractrometer

530.4295

% 6480

1.3

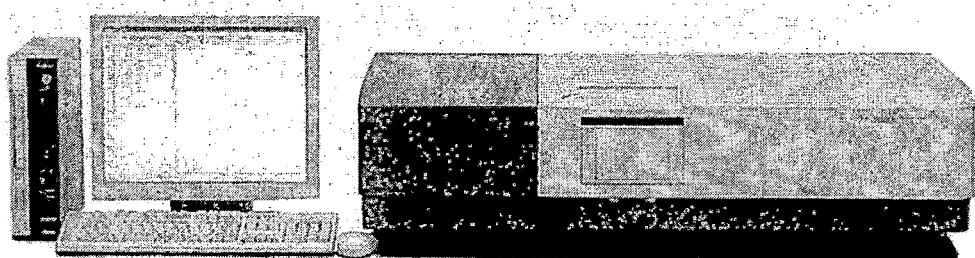
335576



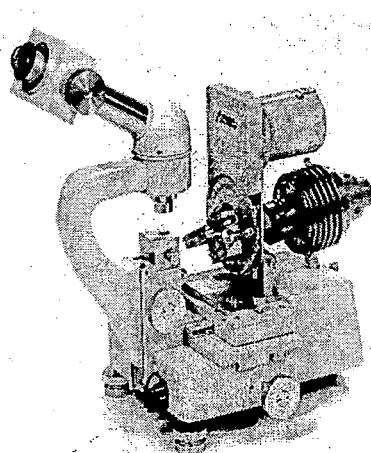
(a)

(b)

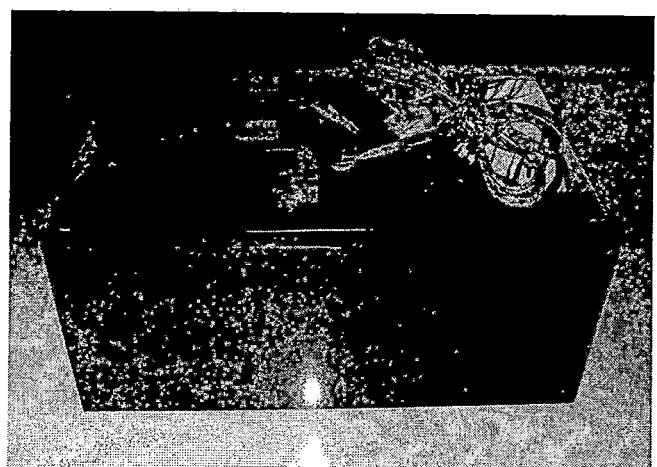
ภาพที่ 3-3 เครื่อง Atomic Force Microscope



ภาพที่ 3-4 เครื่อง Spectrophotometer



ภาพที่ 3-5 ชุดวัดมุมสัมผัส



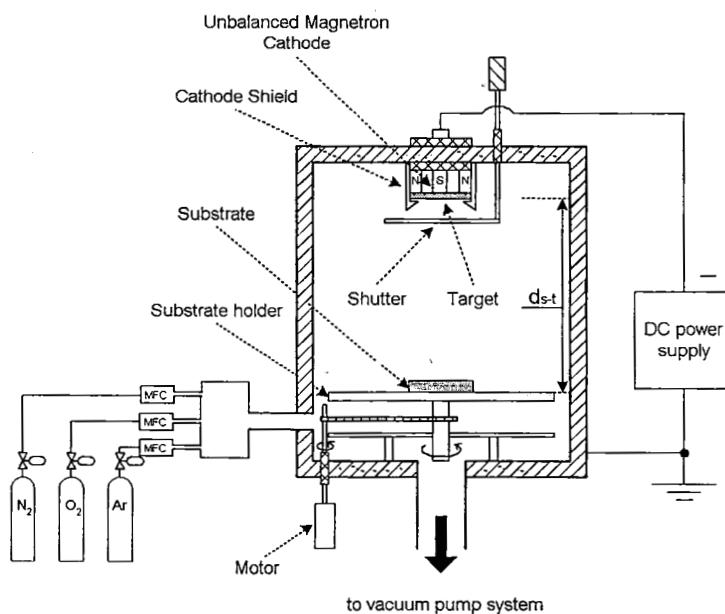
ภาพที่ 3-6 กล้องแสงสำหรับการดูต้นฟิล์ม

3.2 เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบ รีแอคติฟ ดีซี สปัตเตอริง

ฟิล์มบางในงานวิจัยนี้เตรียมจากเครื่องเคลือบระบบดีซีอันบาลานซ์แมกนีตرون สปัตเตอริง ด้วยเทคนิครีแอคติฟสปัตเตอริง ซึ่งเป็นกระบวนการเตรียมภายใต้สภาวะสูญญากาศ ดังนั้นเพื่อให้ฟิล์มบางที่ได้มีคุณภาพและสมบัติตามที่ต้องการ จะต้องลดความดันภายในห้องเคลือบให้อยู่ในระดับ 10^{-5} mbar ส่วนประกอบของเครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของระบบสูญญากาศ (Vacuum Parts) และ ส่วนของระบบเคลือบ (Coating Parts) ดังนี้

1. ส่วนของระบบสูญญากาศ ประกอบด้วย ห้องเคลือบทรงระบบทอกทำจาก สเตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 310.0 mm สูง 370.0 mm ระบบเครื่องสูบสูญญากาศของเครื่องเคลือบประกอบด้วย เครื่องสูบแบบแพร์โอล์เอบร้ายความร้อนด้วยน้ำและมีเครื่องสูบกลโตรารีเป็นเครื่องสูบท้าย สำหรับ การวัดความดันภายในภาชนะสูญญากาศใช้มาตรวัดความดันของ PFEIFFER ซึ่งใช้ส่วนแสดงผล รุ่น TPG262 และ มาตรวัดความดันชนิด Compact Full Range Gauge รุ่น PKR251 ภาพที่ 3-7 เป็นไดอะแกรมของเครื่องเคลือบที่ใช้ในงานวิจัย.

2. ส่วนของระบบเคลือบ เป็นส่วนในการเตรียมฟิล์มบาง แมกนีตرونค่าโถด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 54.0 mm ระยะความร้อนด้วยน้ำติดตั้งเป้าไทยเนียม (99.97%) ที่ค่าโถด พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ภาคจ่ายความต่างศักย์ไฟแอดส์ ใช้แก๊สอาร์กอนความบริสุทธิ์สูง (99.999%) เป็นแก๊สสปัตเตอร์ ใช้แก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนความบริสุทธิ์สูง (99.999%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา สำหรับการจ่ายแก๊สในกระบวนการเคลือบควบคุมด้วย Mass Flow Controller ของ MKS type247D

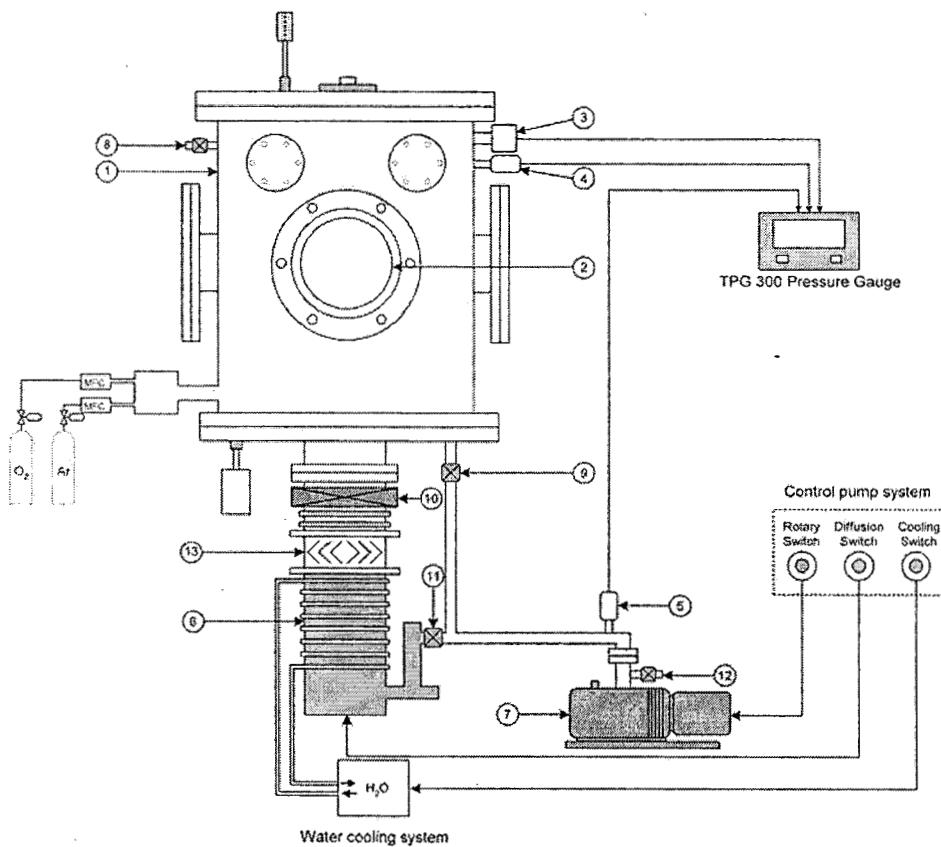


ภาพที่ 3-7 ไดอะแกรมของเครื่องเคลือบในสูญญากาศระบบสปัตเตอริงที่ใช้ในงานวิจัย

3.3 การสร้างสภาวะสุญญากาศ

การเคลือบฟิล์มในห้องเคลือบด้วยวิธีสปิตเตอริง จำเป็นต้องลดความดันในห้องเคลือบให้อยู่ในภาวะสุญญากาศที่ระดับสุญญากาศสูง (High Vacuum) ความดันประมาณ 10^{-3} - 10^{-5} mbar เพื่อลดการปนเปื้อนของฟิล์มที่เคลือบได้นៃองจากการคงค้างของแก๊สในห้องเคลือบ โดยสร้างภาวะสุญญากาศจะใช้ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร์โอหనุหลังด้วยเครื่องสูบกลโกรตารีที่ต่อเข้ากับห้องเคลือบด้วยท่อและมี瓦ล์วควบคุม การปิด-เปิดดังแสดงในภาพที่ 3-8 สำหรับขั้นตอนการสร้างภาวะสุญญากาศมีดังนี้

1. ตรวจเช็คバル์วหายาบ (หมายเลข 9) วาล์วท้าย (หมายเลข 11) และวาล์วสุญญากาศสูง (หมายเลข 10) ให้อยู่ในสภาพปิดทั้งหมด
2. เปิดสวิทซ์หลัก เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบต่าง ๆ ของเครื่อง เช่น ระบบวัดความดันและระบบควบคุมการทำงานของระบบเครื่องสูบสุญญากาศ เป็นต้น หลังจากนั้นเปิดสวิทซ์ Rotary เพื่อให้เครื่องสูบกลโกรตารี (หมายเลข 7) ทำงาน
3. สูบอากาศออกจากเครื่องสูบแบบแพร์โอ โดยใช้เครื่องสูบกลโกรตารี โดยเปิดวาล์วท้าย เพื่อให้เครื่องสูบกลโกรตารีสูบอากาศออกจากเครื่องสูบแบบแพร์โอ (หมายเลข 6) จนความดันในเครื่องสูบแบบแพร์โอ เมื่อ่านจากพิรานีเกจ (หมายเลข 4) มีค่าอยู่กว่า 10^{-2} mbar ซึ่งเป็นความดันที่เครื่องสูบแบบแพร์โอ สามารถทำงานได้ พร้อมทั้งเปิดสวิทซ์ Diffusion เพื่อให้ตัวทำความร้อนของเครื่องสูบแบบแพร์โอทำงานเป็นการเริ่มต้นมั่น ใช้ประมาณ 20 นาที
4. ระหว่างการต้มน้ำมันนำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบวางในห้องเคลือบ โดยก่อนวางวัสดุรองรับต้องตรวจสอบความดันใน ห้องเคลือบยังคงอยู่ในสภาวะเป็นสุญญากาศหรือไม่ ถ้ายังเป็นสุญญากาศก็ทำการเปิดวาล์วปล่อย เพื่อให้อากาศเข้าสู่ห้องเคลือบ จนความดันในห้องเคลือบท่ากับความดันบรรยายกาศ จากนั้นทำการเปิดฝาครอบห้องเคลือบออก นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบไปวาง ปิดฝาครอบและปิดวาล์วปล่อยให้สนิท
5. สร้างสภาวะสุญญากาศขั้นต้นในห้องเคลือบโดยใช้เครื่องสูบกลโกรตารี โดยการปิดวาล์วท้าย แล้วเปิดวาล์วหายาบเพื่อให้เครื่องสูบกลโกรตารีสูบอากาศออกจากห้องเคลือบ จนความดันในห้องเคลือบ มีค่าประมาณ 10^{-2} mbar เมื่อ่านความดันจากมาตรวัดความดันแบบช่วงกว้าง (หมายเลข 3)
6. เมื่อต้มน้ำมันจนครบ 20 นาที ทำการสร้างสภาวะสุญญากาศสูง ในห้องเคลือบ ด้วยเครื่องสูบแบบแพร์โอ โดยปิดวาล์วหายาบ แล้วเปิดวาล์วท้าย หลังจากนั้นเปิดวาล์วสุญญากาศสูง เพื่อให้เครื่องสูบแบบแพร์โอสูบอากาศออกจากห้องเคลือบเพื่อทำความสะอาดในห้องเคลือบให้อยู่ในระดับสภาวะสุญญากาศสูง หรืออยู่ในช่วง 10^{-5} - 10^{-6} mbar
7. จับเวลาและรอจนความดันในห้องเคลือบมีค่าประมาณ 3×10^{-5} mbar ซึ่งกำหนดให้เป็นค่าความดันพื้น (P_B) ก่อนเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มบางต่อไป



ภาพที่ 3-8 ไดอะแกรมระบบเครื่องสูบสุญญาแก๊ส ของระบบเคลือบสเป็ตเตอร์ิง

1. ห้องเคลือบ (Vacuum Chamber)
2. หน้าต่าง (Window)
3. มาตรวัดความดันแบบเพนนิ่ง (Penning Gauge)
4. มาตรวัดความดันแบบพิรานี (Pirani Gauge)
5. มาตรวัดความดันแบบพิรานี (Pirani Gauge)
6. เครื่องสูบแบบแพร์โซ (Diffusion Pump)
7. เครื่องสูบกลอโรตารี (Rotary Pump)
8. วาล์วปล่อย (Vent Valve)
9. วาล์วหายา (Roughing Valve)
10. วาล์วสุญญาแก๊สสูง (High Vacuum Valve)
11. วาล์วท้าย (Backing Valve)
12. วาล์วปล่อย (Vent Valve)
13. แบฟเฟิล (Baffle)

3.4 ขั้นตอนการเคลือบฟิล์มบาง

สำหรับขั้นตอนในการเคลือบฟิล์มบางแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การสร้างสภาพวัสดุร่องรับ : เริ่มจากนำวัสดุร่องรับ (substrate) หรือชิ้นงานที่ต้องการเคลือบเข้าห้องเคลือบ โดยวางบนแท่นวางชิ้นงานซึ่งสามารถปรับระดับของวัสดุร่องรับให้ห่างจากหน้าเป้าสารเคลือบ (d_{sub}) ได้ตามต้องการ เเลื่อนชัตเตอร์มาปิดระหว่างวัสดุร่องรับและเป้าสารเคลือบ จากนั้นเป็นการสร้างสภาพวัสดุร่องรับโดยลดความดันภายในห้องเคลือบให้ได้ความดันพื้น (P_b) เท่ากับ 5×10^{-5} mbar

2. การทำความสะอาดหน้าเป้า : ขั้นนี้เป็นการทำ pre-sputtering หน้าเป้าสารเคลือบในบรรยากาศแก๊สอาร์กอน เพื่อทำความสะอาดหน้าเป้าก่อนการเคลือบจริง โดยปิดชัตเตอร์ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคลือบที่หลุดออกจากหน้าเป้าขณะทำ pre-sputtering ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

3. การเคลือบฟิล์มบาง : ขั้นนี้เป็นการเคลือบชิ้นงานตามที่ต้องการภายหลังการทำความสะอาดหน้าเป้าโดยการ pre-sputtering แล้ว โดยเริ่มจากการจ่ายแก๊สอาร์กอนและแก๊สไนโตรเจนเข้าห้องเคลือบเพื่อทำการเคลือบ ในขั้นนี้หากต้องการควบคุมความดันรวมขณะเคลือบ (P_s) สามารถทำได้โดยการปรับวัล์วสูญญากาศสูงของเครื่องเคลือบเพื่อเพิ่มหรือลดอัตราการสูบของเครื่องสูบ เพื่อให้ได้ความดันตามต้องการ (ปกติกำหนดให้เท่ากับ 5×10^{-3} mbar) จากนั้นจึงจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงให้แก่ค่าโถด เพื่อสร้างสารเคลือบจากการกระบวนการโกลว์ดิสชาร์จ (ชัตเตอร์ยังปิดอยู่ ขั้นนี้สามารถกำหนดกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการเคลือบโดยการปรับค่ากระแสหรือความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ค่าโถด ซึ่งสามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าให้คงที่ หรือศักย์ไฟฟ้าให้คงที่ก็ได้ขึ้นกับเงื่อนไขในการทดลอง) เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้ค่าโถดและกระแสค่าโถดที่วัดได้ไม่เปลี่ยนแปลง จึงเริ่มการเคลือบฟิล์มบาง โดยเปิดชัตเตอร์ที่ปิดหน้าเป้าสารเคลือบออก เพื่อเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มลงบนวัสดุร่องรับ พร้อมบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า (I) ค่าศักย์ไฟฟ้า (V) และค่าความดันรวม (P_s) ขณะเคลือบ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบฟิล์มตามระยะเวลาที่กำหนด (t) ปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ปิดการจ่ายแก๊สที่ใช้เคลือบแล้วปิดล้ออากาศเข้าห้องเคลือบ เพื่อนำวัสดุร่องรับออก

4. การวิเคราะห์ฟิล์มบางเบื้องต้น : ขั้นนี้เป็นการนำชิ้นงานที่เคลือบแล้วออกจากเครื่องเคลือบแล้วพิจารณาลักษณะทางกายภาพและสีของฟิล์มที่เคลือบได้ด้วยตาเปล่าก่อนส่งไปวิเคราะห์เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะด้านอื่นๆ ต่อไป

3.5 การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง

การวิเคราะห์ฟิล์มบางที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

1. โครงสร้างผลึกและลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบาง ขั้นตอนนี้เป็นการนำฟิล์มบางที่เคลือบได้มาศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิช ลักษณะพื้นผิวและความหนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึก โดยนำสตูรองรับที่เป็นแผ่นซิลิโคนที่เคลือบแล้ว มาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray Diffractrometer เพื่อหาโครงสร้างผลึกของฟิล์มที่เกิดขึ้น โดยใช้ Cu- $k\alpha$ เป็นแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ใน Mode Low Angle กำหนดมุมวัดอยู่ในช่วง $20^\circ - 65^\circ$ สเปกตรัมที่วัดได้นำไปเปรียบเทียบกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารในฐานข้อมูล JCPDS

1.2 การหาขนาดผลึก โดยคำนวณตามสมการของ Seherrer จากความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractrometer

1.3 การหาค่าคงที่แลตทิช หาจากรูปแบบโครงสร้างผลึกของฟิล์มจากเครื่อง X-Ray Diffractrometer โดยใช้สมการการหาระยะห่างระหว่างระนาบผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้

1.4 การหาความหนาของฟิล์ม นำสตูรองรับที่เป็นแผ่นซิลิโคนที่เคลือบแล้วไปวัดความหนาด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยใช้เข็มขนาดเล็กทำจากซิลิโคนในไตร์เคลื่อนที่กรัดบนผิวฟิล์มบางเพื่อตรวจวัดความหนา

1.5 การศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม โดยนำสตูรองรับที่เป็นแผ่นซิลิโคนที่เคลือบแล้วไปวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยมีความละเอียดในระดับนาโน และใช้พื้นที่ในการวิเคราะห์เท่ากับ $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ พร้อมวัดค่าความหยาบผิว

2. สมบัติทางแสงของฟิล์มบาง ขั้นนี้คำนวณหาค่าคงที่ทางแสงของฟิล์มบางด้วยเครื่องสเปกโตรไฟโตมิเตอร์วัดค่าการส่งผ่านแสงบนกระจำลสไลด์ที่เป็นสตูรองรับ แล้วนำมาคำนวณหา ด้วยหักเหสัมประสิทธิ์การดับสัญญา และแบบพลังงาน

3.6 แนวทางการทดลอง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสมบัติไฮโดรฟิลิกของพิล์มไทเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจน ทั้งนี้แนวทางการทดลองโดยรวมของงานวิจัยนี้คือ (1) ศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เฟสอนาคต (2) ศึกษาการเตรียมพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจน รวมถึง สมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ศึกษาสมบัติทางแสงของพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจนที่ได้ (4) ศึกษาสมบัติไฮโดรฟิลิกของพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เจือในไตรเจนที่ได้ รายละเอียดดังนี้

การทดลองที่ 1 การเตรียมพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เฟสอนาคต

วัตถุประสงค์ เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เฟสอนาคต แบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อยดังนี้

การทดลองที่ 1.1 ผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจน

วัตถุประสงค์ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เฟสอนาคต

วิธีการทดลอง

1. การเคลือบพิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์บนกระจกสไลด์ และแผ่นชิลิกอนโดยการแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจนในการเคลือบ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์ โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สออกซิเจนที่เท่ากับ 5 sccm และแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 5 sccm, 10 sccm และ 15 sccm ตามลำดับ ควบคุมความดันรวมขณะเคลือบให้คงที่เท่ากับ 7×10^{-3} mbar ใช้เวลาเคลือบนาน 90 นาที (ตารางที่ 3-1)

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพิล์มที่เคลือบได้ โดยศึกษาโครงสร้างผิว ขนาดผิว ค่าคงที่แลตทิช ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ตารางที่ 3-1 เงื่อนไขการเคลือบเมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจน

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	ไทเทเนียม (99.99%)
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์ และแผ่นชิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	5×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	7×10^{-3}
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	8
อัตราไหลแก๊สออกซิเจน (sccm)	5
อัตราไหลแก๊สออกซิเจน (sccm)	5, 10, 15
เวลาเคลือบ (min)	90

การทดลองที่ 1.2 ผลของความดันรวม
วัตถุประสงค์ เพื่อหาความดันรวมที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์เพสโโนเทส

วิธีการทดลอง

1. การเคลือบฟิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มบางไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์บนกระจกไอล์ตและแผ่นซิลิกอนโดยการแปรค่าความดันรวมในการเคลือบ เพื่อหาอัตราไฟลแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์ โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สออกซิเจนต่อแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ 5 : 15 sccm แปรค่าความดันรวมควบคุมความดันรวมเท่ากับ 3×10^{-3} mbar, 5×10^{-3} mbar, 7×10^{-3} mbar และ 9×10^{-3} mbar ตามลำดับ และใช้เวลาเคลือบนาน 90 นาที (ตารางที่ 3-2)

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่เคลือบได้ โดยศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิช ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ตารางที่ 3-2 เงื่อนไขการเคลือบเมื่อแปรค่าความดันรวม

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	ไฟฟ้าเนียม (99.99%)
วัสดุรองรับ	กระจกไอล์ต และแผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	5×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	3×10^{-3} , 5×10^{-3} , 7×10^{-3} , 9×10^{-3}
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	8
อัตราไฟลแก๊สออกซิเจน (sccm)	5
อัตราไฟลแก๊สออกซิเจน (sccm)	15
เวลาเคลือบ (min)	90

การทดลองที่ 2 การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน
วัตถุประสงค์ เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน
มีการทดลองดังนี้

วิธีการทดลอง

1. การเคลือบฟิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนบนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนโดยการปรค่าอัตราไหเลแก๊สในไตรเจนในการเคลือบ เพื่อหาอัตราไหเลแก๊สในไตรเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สสาร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ $5 : 15 \text{ sccm}$ ปรค่าอัตราไหเลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 0 sccm , 1 sccm , 2 sccm และ 3 sccm ตามลำดับ ควบคุมความดันรวมให้คงที่เท่ากับ $7 \times 10^{-3} \text{ mbar}$ และใช้เวลาเคลือบนาน 90 นาที (ตารางที่ 3-3)

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่เคลือบได้ โดยศึกษาโครงสร้างผิว ขนาดผิว ค่าคงที่แลตทิช ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ตารางที่ 3-3 เงื่อนไขการเคลือบเมื่อปรค่าอัตราไหเลแก๊สในไตรเจน

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	ไทเทเนียม (99.99%)
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์ และแผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	5×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	7×10^{-3}
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	8
อัตราไหเลแก๊สสาร์กอน (sccm)	5
อัตราไหเลแก๊สออกซิเจน (sccm)	15
อัตราไหเลแก๊สในไตรเจน (sccm)	0, 1, 2, 3
เวลาเคลือบ (min)	90

การทดลองที่ 3 สมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

วิธีการทดลอง

1. การศึกษาสมบัติทางแสง และแบบพลังงานของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน โดยนำฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่เคลือบบนกระจกสไลด์ จากการทดลองที่ 2 ไปวัดค่า การส่งผ่านแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตเมิเตอร์

2. นำค่าการส่งผ่านแสงที่ได้มาคำนวณหา ดัชนีหักเห และสัมประสิทธิ์การดับสูญ ด้วย วิธี Envelope ส่วนแบบพลังงานคำนวณจากสเปกตรัมการส่งผ่านแสง จากสมการ $\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^m$ เมื่อ $m = 2$ (Indirect Allowed Transition) (Chiu et al., 2007) โดยค่าแบบพลังงาน (E_g) มีค่าเท่ากับ จุดตัดบน แกน x ของกราฟระหว่าง $(\alpha h\nu)^{1/2}$ กับ $h\nu$

การทดลองที่ 4 สมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

วิธีการทดลอง

1. ทดสอบสมบัติไฮโดรฟิลิกของกระจกไม่เคลือบฟิล์ม โดยนำกระจกไปปลายรับแสงยูวี และ แสงฟลูออเรสเซนต์ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยในระหว่างการฉายแสงนำกระจกไม่เคลือบฟิล์มออกจากน้ำดม แล้วสัมผัสของหยดน้ำบนกระจกทุก ๆ 1 ชั่วโมง

2. ทดสอบสมบัติไฮโดรฟิลิกของกระจกเคลือบฟิล์ม โดยนำกระจกไปปลายรับแสงยูวี และ แสงฟลูออเรสเซนต์ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยในระหว่างการฉายแสงนำกระจกไม่เคลือบฟิล์มออกจากน้ำดม แล้วสัมผัสของหยดน้ำบนกระจกทุก ๆ 1 ชั่วโมง

บทที่ 4

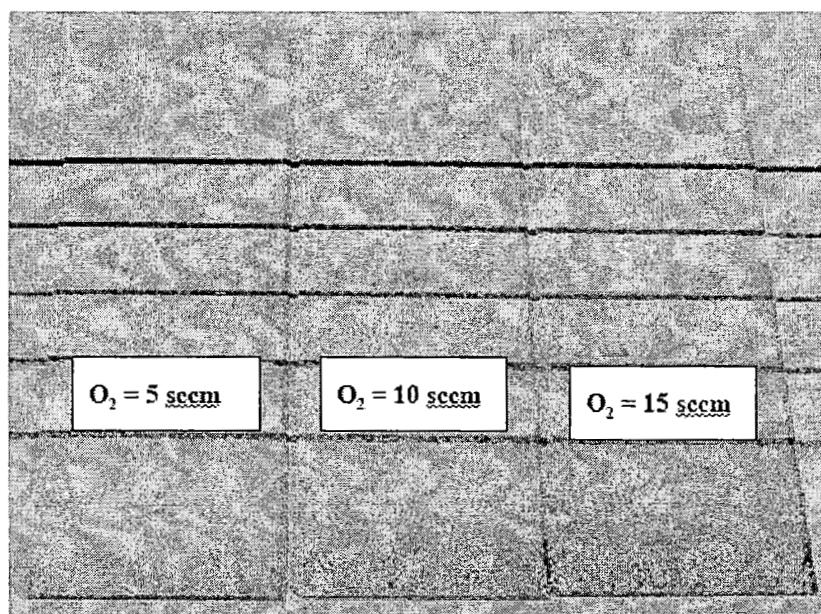
ผลและอภิปรายผล

4.1 การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาคต

ส่วนนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้จากวิธีรีแอคติฟดีซีแมกนีตรอนสปีตเตอร์วิง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) ผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจน และ (2) ผลของความดันรวม ดังนี้

1. ผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจน

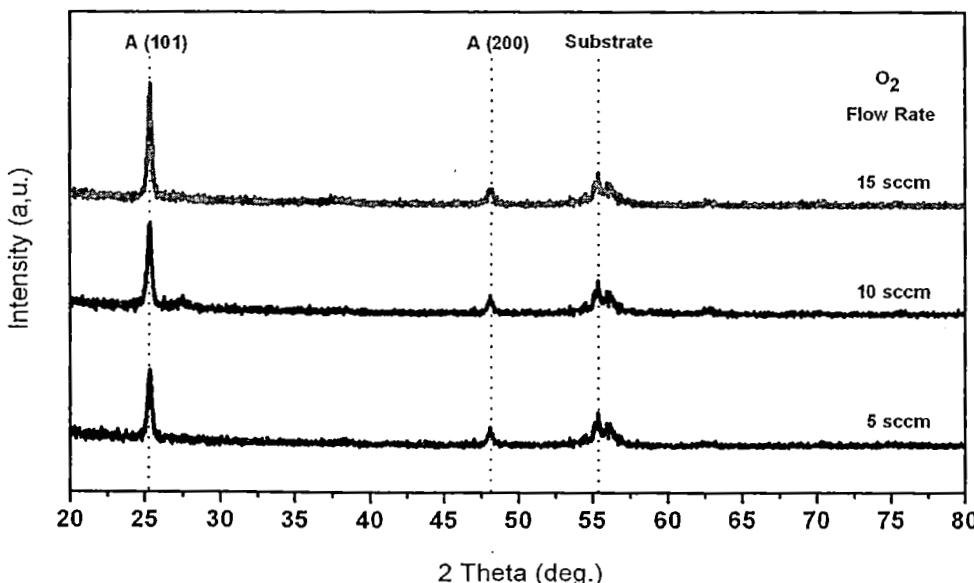
1.1 ลักษณะทางกายภาพ ฟิล์มบางที่เคลือบได้จากการแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจน พบร่วมกับฟิล์มมีลักษณะใส ส่งผ่านแสงได้ดี มีสีขาว หรือเขียวอ่อน ๆ เปลี่ยนไปตามอัตราไหลแก๊สออกซิเจน ดังแสดงในภาพที่ 4-1



ภาพที่ 4-1 ลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนกระจาสไลด์ ที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

1.2 โครงสร้างผลึก ภาพที่ 4-2 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบบนแผ่นซิลิกอน โดยแปรค่าอัตราไหլแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ พบร้าฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 5 sccm มีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 25.34° และ 47.98° ซึ่งตรงกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบไฟฟ่อนาเทสระนาบ (101) และ เฟสอนาคตระนาบ (200) ตามลำดับ และเมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็น 10 sccm และ 15 sccm ฟิล์มที่เคลือบได้มีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุมเดิมทั้งหมด แต่ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 25.34° เฟสอนาคตระนาบ (101) มีค่าเพิ่มขึ้น โดยที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 15 sccm ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางเฟสอนาคตระนาบ (101) มีค่าสูงสุด โดยที่มุม 56.50° เป็นรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของธาตุซิลิกอนซึ่งเป็นวัสดุรองรับ

โครงสร้างผลึกของฟิล์ม จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไฟฟ่อนียมได้ออกใช้ที่เคลือบได้ เมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่ใช้ในกระบวนการเคลือบ พบร้าฟิล์มที่เคลือบได้ทุกเงื่อนไขมีเฟสอนาคตระนาบ (101) และเฟสอนาคตระนาบ (200) โดยความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เฟสอนาคตระนาบ (101) มีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราไหลแก๊สออกซิเจน โดยที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 15 sccm มีความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zeman and Takabayashi (2002) ซึ่งเคลือบฟิล์มบางไฟฟ่อนียมได้ออกใช้ด้วยวิธีสปิตเตอริงแล้วพบว่าความดันຍ່ອຍแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไฟฟ่อนียมได้ออกใช้ที่เคลือบได้ซึ่งมีเฟสอนาคตระนาบ (101) มีค่าเพิ่มขึ้น



ภาพที่ 4-2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไฟฟ่อนียมได้ออกใช้ที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

ค่าคงที่แลตทิซของพิล์มที่เคลือบได้ จากสมการการคำนวณหาระยะห่างระหว่างรูปผลึกในระบบผลึกที่มีโครงสร้างแบบเตตรากอนอล โดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มบางที่ได้ พบว่า ค่าคงที่แลตทิซของพิล์มบางเฟสонаเทส คือ a มีค่าอยู่ในช่วง $3.784 \text{ \AA} - 3.785 \text{ \AA}$ และ c มีค่าอยู่ในช่วง $9.365 \text{ \AA} - 9.534 \text{ \AA}$ ตรงตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4921 ของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ เฟสонаเทส ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเตตรากอนอล ($a = 3.777 \text{ \AA}$ และ $c = 9.501 \text{ \AA}$) ดังตารางที่ 4-1

สำหรับขนาดผลึกของพิล์มที่เคลือบได้ คำนวณจากสมการของ Seherrer พบว่าขนาดผลึกมีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราไหหลแก๊สออกซิเจน เมื่ออัตราไหหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ขนาดผลึกมีค่าเพิ่มขึ้น โดยมีค่าอยู่ในช่วง $54.28 \text{ nm} - 65.14 \text{ nm}$ ดังแสดงในตารางที่ 4-2 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zeman and Takabayashi (2002) ที่เคลือบพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีสปัตเตอริ่ง แล้วพบว่า เมื่ออัตราไหหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ผลึกของพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้มีขนาดใหญ่ขึ้น

ตารางที่ 4-1 ค่าคงที่แลตทิซของพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสонаเทสที่

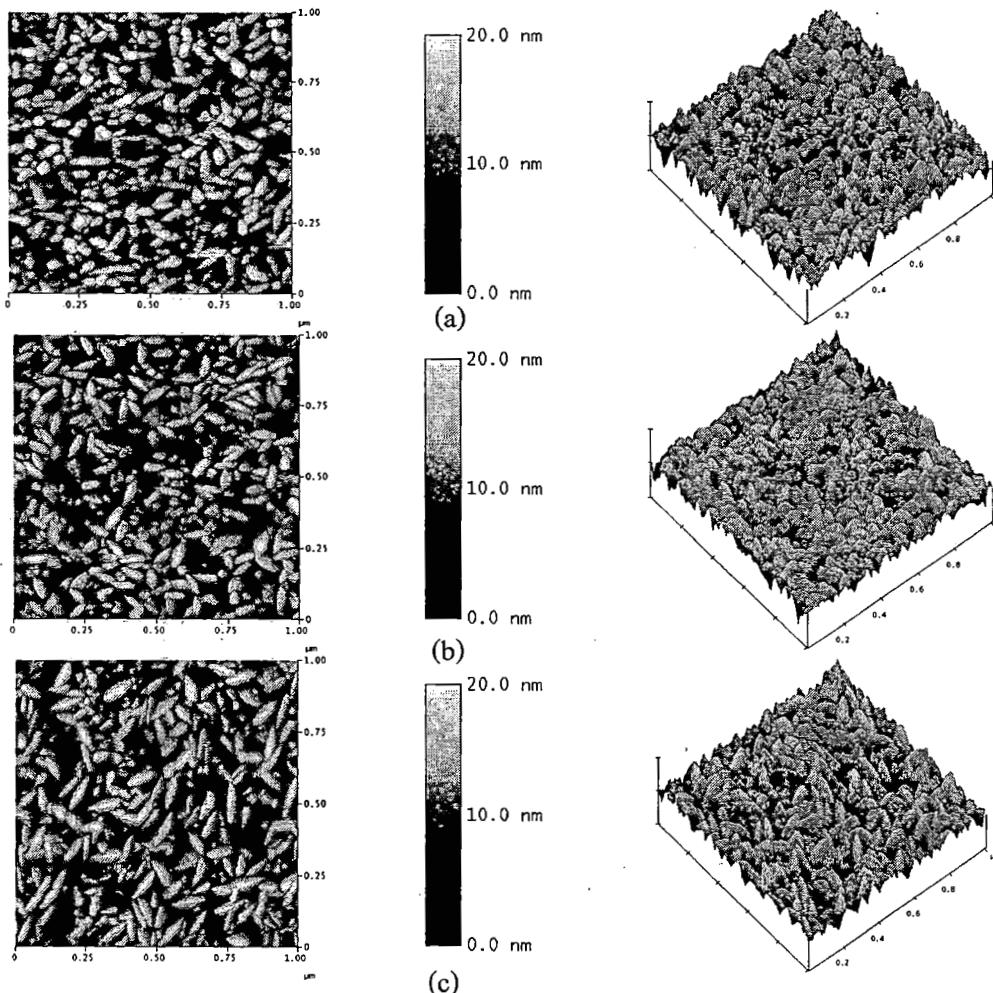
อัตราไหหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

ค่าคงที่แลตทิซ	มาตรฐาน JCPDS (89-4921)	อัตราไหหลแก๊สออกซิเจน (sccm)		
		5	10	15
$a (\text{\AA})$	3.777	3.784	3.784	3.785
$c (\text{\AA})$	9.501	9.499	9.534	9.365

ตารางที่ 4-2 ขนาดผลึกของพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อัตราไหหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

อัตราไหหลแก๊สออกซิเจน (sccm)	FWHM (องศา)	ขนาดผลึก (nm)
5	0.150	54.28
10	0.145	56.15
15	0.125	65.14

1.3 ความหนาและลักษณะพื้นผิว ภาพที่ 4-3 แสดงลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบที่อัตราไหลงแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ จากเทคนิค AFM พบร้าฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหลงแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 5 sccm และ 10 sccm เกรนมีลักษณะเล็กแหลม เมื่ออัตราไหลงแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็น 15 sccm เกรนเริ่มนีขนาดใหญ่ เรียว และแหลมขึ้น สำหรับความหนาและความหยาบผิวของฟิล์ม พบร้าเมื่ออัตราไหลงแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นจาก 5 sccm เป็น 15 sccm ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาและความหยาบผิวลดลงจาก 238 nm เป็น 215 nm และ 5.92 nm เป็น 4.85 nm ดังแสดงในตารางที่ 4-3



ภาพที่ 4-3 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM ที่อัตราไหลงแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

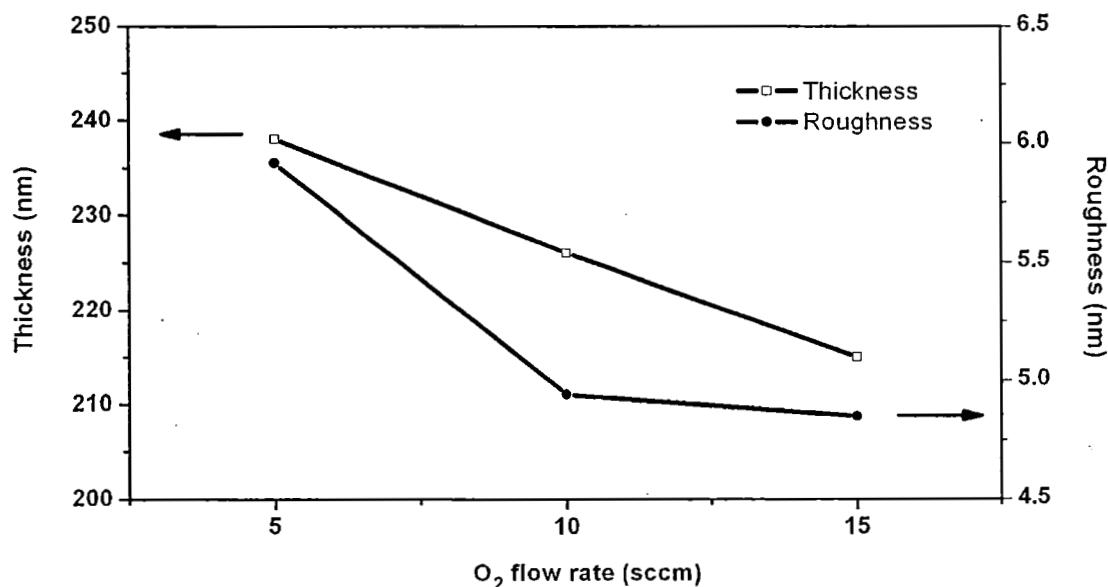
(a) 5 sccm

(b) 10 sccm

(c) 15 sccm

ตารางที่ 4-3 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์
ที่อัตราไฟลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

อัตราไฟลแก๊สออกซิเจน (sccm)	ความหนา (nm)	ความหยาบผิว (nm)
5	238	5.92
10	226	4.94
15	215	4.85



ภาพที่ 4-4 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่
อัตราไฟลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

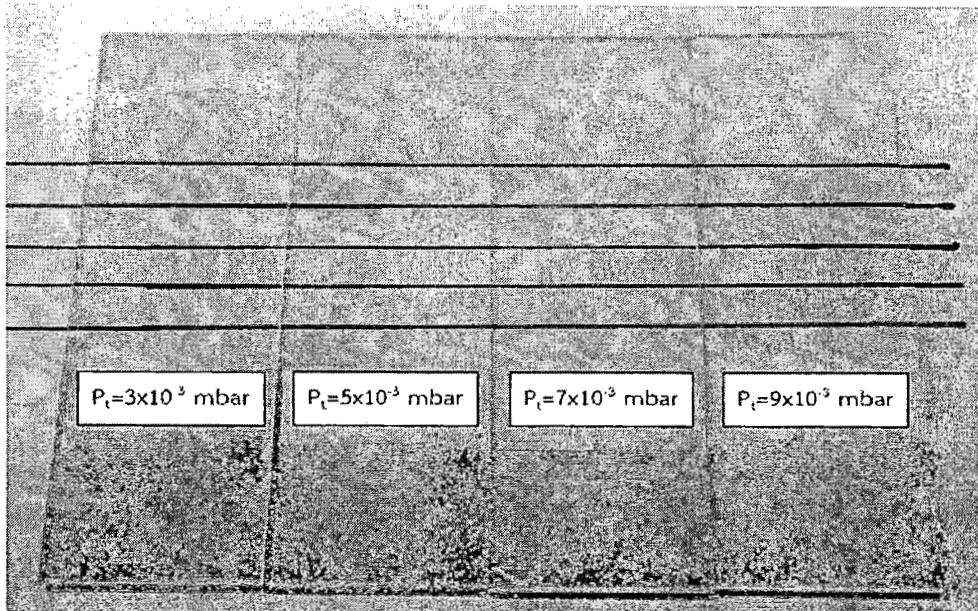
ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ พบว่าลักษณะเกรนของฟิล์มเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราไหล แก๊สออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น โดยฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 5 sccm และ 10 sccm เกรนมีลักษณะเล็กแหลม และเมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็น 15 sccm เกรนเริ่มมีขนาดใหญ่ เรียว และแหลมขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิศร บูรณวงศ์ (2551) ที่เคลือบฟิล์มบางไห้เนียม ได้ออกไซด์ด้วยวิธีสปัตเตอร์ริงแล้วพบว่า เมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ฟิล์มมีเกรนโตขึ้น แต่ขัดแย้งกับ งานวิจัยของ Toku et al. (2008) ที่ศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบาง ไห้เนียมได้ออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธีสปัตเตอร์ริง แล้วพบว่า เมื่อความดันย่อยแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ขนาดเกรนของฟิล์มเล็กลง

ความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้ พบว่า เมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ความหนาของฟิล์ม มีค่าลดลงจาก 238 nm เป็น 215 nm สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hunsche, Vergohr, and Ritz (2005) ซึ่งพบว่า ความหนาฟิล์มมีค่าลดลงตามความดันย่อยแก๊สออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก เมื่อปริมาณของ แก๊สออกซิเจนในระบบมีค่าเพิ่มขึ้น ตามอัตราไหลแก๊สออกซิเจนนั้น ส่งผลให้อัตราการสปัตเตอร์ของ เป้าสารเคลือบลดลง เนื่องจาก เมื่อแก๊สออกซิเจนมีปริมาณมาก อาจทำให้เกิดสารประกอบออกไซด์ที่หนา เป้าสารเคลือบ เป็นผลให้เป้าสารเคลือบถูกสปัตเตอร์ได้ยากขึ้น ส่งผลให้อะตอมของไห้เนียมที่จะทำ ปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน แล้วฟอร์มตัวเป็นชั้นฟิล์มบางเคลือบบนผิววัสดุรองรับน้อยลงด้วย เป็นผลให้ ฟิล์มมีความหนาลดลง

ความหยาบผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ พบว่า เมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ความหยาบผิว มีค่าลดลงจาก 5.92 nm เป็น 4.85 nm สอดคล้องกับงานวิจัยของ Toku et al. (2008) ที่ศึกษาผลของ ความดันย่อยแก๊สออกซิเจนต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบาง ไห้เนียมได้ออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธีสปัตเตอร์ริง แล้วพบว่า เมื่อความดันย่อยแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ความหยาบผิวของฟิล์มมีค่าลดลง เนื่องจาก เมื่อความดัน ย่อยแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น สารเคลือบที่ตกเคลือบลงบนวัสดุรองรับจะมีความบริสุทธิ์มากขึ้น ส่งผลให้พื้นผิว ของฟิล์มนี้ ความสม่ำเสมอและความหยาบผิวลดลง

2. ผลของความดันรวม

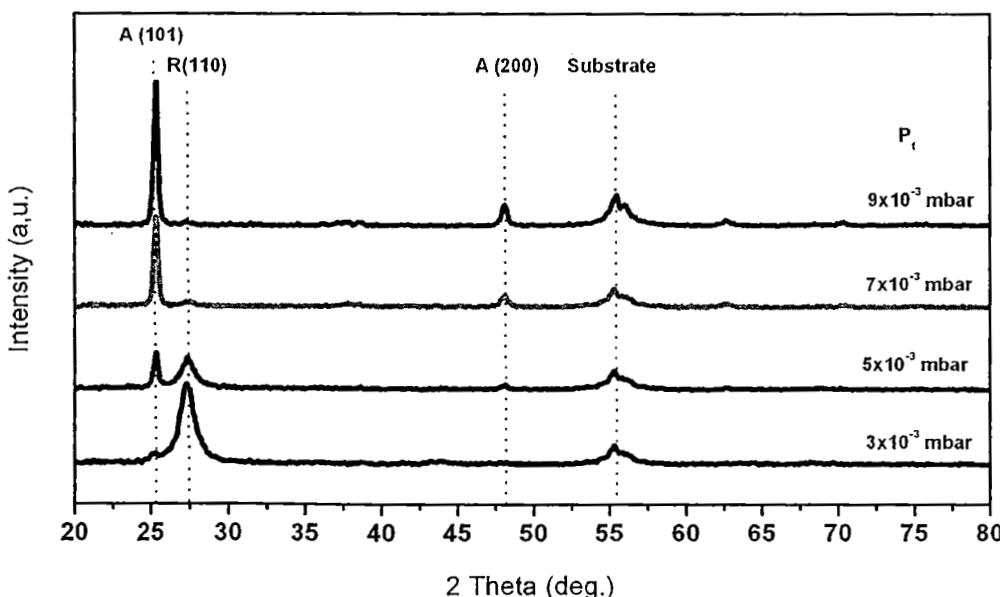
2.1 ลักษณะทางกายภาพ พิล์มบางที่เคลือบได้จากการแปรค่าความดันรวม มีลักษณะใส สั่งผ่านแสงได้ดี เมื่อสังเกตสีของพิล์มจากการสะท้อนและการส่งผ่านแสง พบว่าแสงสะท้อนที่ผิวน้ำของพิล์มน้ำจะเป็นสีม่วงอ่อนขณะที่แสงผ่านพิล์มและจะเป็นสีเขียวอมฟ้า ดังแสดงในภาพที่ 4-5



ภาพที่ 4-5 ลักษณะของพิล์มบางไหเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนกระจกสไลด์
ที่ความดันรวมต่าง ๆ

2.2 โครงสร้างผลึก ภาพที่ 4-6 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบบนแผ่นซิลิกอน โดยแปรค่าความดันรวม พบร้าฟิล์มที่เคลือบด้วยความดันรวมเท่ากับ 3×10^{-3} mbar มีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มุม 27.28° ซึ่งตรงกับสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ (JCPDS เลขที่ 89-4920) โครงสร้างผลึกแบบเตต拉โกลเฟสทรูไทล์ระนาบ (110) ที่ความดันรวมเท่ากับ 5×10^{-3} mbar พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 25.34° , 27.28° และ 47.98° ซึ่งตรงกับสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ (JCPDS เลขที่ 89-4920 และ 89-4921) ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเตต拉โกลเฟสонаเทสระนาบ (101) เฟสทรูไทล์ระนาบ (110) และเฟสонаเทส ระนาบ (200) เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7×10^{-3} mbar และ 9×10^{-3} mbar พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 25.34° และ 47.98° ซึ่งตรงกับสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ (JCPDS เลขที่ 89-4921) ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเตต拉โกลเฟสонаเทสระนาบ (101) และเฟสонаเทส ระนาบ (200)

โครงสร้างผลึกของฟิล์ม จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนแผ่นซิลิกอน พบร้าเมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้น โครงสร้างผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้จะเปลี่ยนไปโดยที่ความดันรวมต่ำ (3×10^{-3} mbar) ฟิล์มที่เคลือบได้มีเฉพาะเฟสทรูไทล์ เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้นเป็น 5×10^{-3} mbar พบร้าโครงสร้างผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้เป็นเฟสผสมของรูไทล์/อนาคต สุดท้ายที่ความดันรวมสูง (7×10^{-3} mbar และ 9×10^{-3} mbar) ฟิล์มที่เคลือบได้มีเฉพาะเฟสอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yamagishi et al. (2003) ซึ่งพบร้าโครงสร้างผลึกของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เปลี่ยนตามความดันรวมเนื่องจาก ที่ความดันรวมต่ำ ระยะปลดการชนเฉลี่ยมีค่ามาก ทำให้อะตอมสารเคลือบ (ไทเทเนียม) หรืออนุภาคของแก๊ส ที่มีพลังงานสูงสามารถเคลื่อนที่ไปยังวัสดุรองรับโดยปราศจากการชนกันทำให้อะตอมสารเคลือบมีพลังงานมากพอในการฟอร์มตัวเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสทรูไทล์ ซึ่งต้องใช้พลังงานสูงในการฟอร์มตัว ส่งผลให้การจัดเรียงตัวของอะตอมไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้มีเฟสทรูไทล์



ภาพที่ 4-6 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ

ค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์ หาได้จากสูตรการคำนวณหาระยะห่างระหว่างระนาบผลึกในระบบผลึกที่มีโครงสร้างแบบเตトラgonal โดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่ได้ พบว่าค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางเฟสонаเทส คือ a มีค่าอยู่ในช่วง $3.780 \text{ \AA} - 3.784 \text{ \AA}$ และ c มีค่าอยู่ในช่วง $9.446 \text{ \AA} - 9.485 \text{ \AA}$ ตรงตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4921 ส่วนฟิล์มเฟส្ងอิทัล (ความดันรวมเท่ากับ $3 \times 10^{-3} \text{ mbar}$) ไม่สามารถคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซได้ เนื่องจากฟิล์มที่เคลือบได้เกิดเพียงระนาบเดียว ดังแสดงในตารางที่ 4-4

สำหรับขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์จากสมการของ Seherrer โดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่ได้ พบว่าเมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้น ขนาดผลึกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีค่าอยู่ในช่วง $17.21 \text{ nm} - 58.16 \text{ nm}$ ดังแสดงในตารางที่ 4-5 โดยที่ความดันรวมเท่ากับ $3 \times 10^{-3} \text{ mbar}$ ฟิล์มมีเฟส្ងอิทัล ผลึกมีขนาดเท่ากับ 17.21 nm เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้นเป็น $5 \times 10^{-3} \text{ mbar}$ ฟิล์มมีเฟสสนมของรูอิทัล/อนาเทส ผลึกมีขนาดเพิ่มเป็น 58.16 nm สุดท้ายที่ความดันรวมเท่ากับ $7 \times 10^{-3} \text{ mbar}$ และ $9 \times 10^{-3} \text{ mbar}$ ฟิล์มมีเฟสонаเทส ผลึกมีค่าเท่ากับ 49.35 nm และ 50.89 nm ตามลำดับ

ตารางที่ 4-4 ค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เฟสонаเทสที่ความดันรวมต่าง ๆ

ค่าคงที่แลตทิซ	มาตรฐาน JCPDS (89-4921)	ความดันรวม (mbar)			
		3×10^{-3}	5×10^{-3}	7×10^{-3}	9×10^{-3}
$a (\text{\AA})$	3.777	-	3.783	3.784	3.780
$c (\text{\AA})$	9.501	-	9.471	9.466	9.485

ตารางที่ 4-5 ขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ

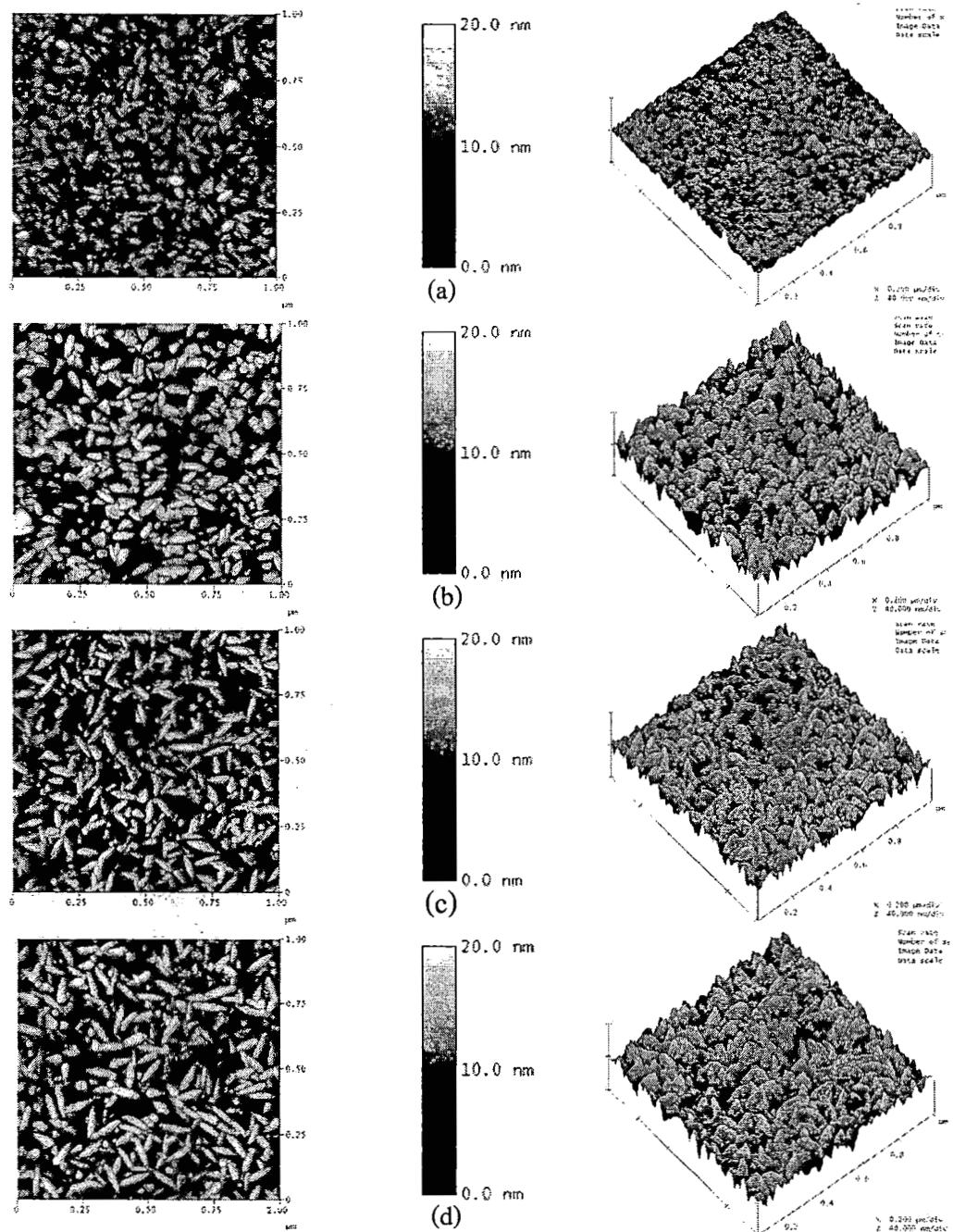
ความดันรวม (mbar)	FWHM (องศา)	ขนาดผลึก (nm)
3×10^{-3}	0.475	17.21
5×10^{-3}	0.140	58.16
7×10^{-3}	0.165	49.35
9×10^{-3}	0.160	50.89

2.3 ความหนาและลักษณะพื้นผิว ภาพที่ 4-7 แสดงลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์เคลือบที่ความดันรวมต่ำๆ จากเทคนิค AFM พบร้าฟิล์มที่เคลือบด้วยความดันรวมเท่ากับ 3×10^{-3} mbar เกรนมีลักษณะเล็กกลมมน เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้น เกรนเริ่มมีขนาดเล็ก เรียว และแหลมขึ้น สำหรับความหนาและความหยาบผิว เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้นจาก 3×10^{-3} mbar เป็น 9×10^{-3} mbar ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาเพิ่มขึ้นจาก 190 nm เป็น 220 nm ส่วนความหยาบผิวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยยกเว้นที่ความดันรวมเท่ากับ 5×10^{-3} mbar มีความหยาบผิวสูงสุด (ตารางที่ 4-6)

ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ พบร้า ลักษณะเกรนของฟิล์มเปลี่ยนไปตามความดันรวมที่เพิ่มขึ้น โดยฟิล์มที่เคลือบด้วยความดันรวมเท่ากับ 3×10^{-3} mbar เกรนมีลักษณะเล็กกลมมน เมื่อความดันรวมเพิ่มเป็น 5×10^{-3} mbar, 7×10^{-3} mbar และ 9×10^{-3} mbar เกรนเริ่มมีขนาดเล็ก เรียว และแหลมขึ้น สาเหตุที่ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่เคลือบได้เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นผลมาจากการพลังงานของสารเคลือบซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Zhou et al. (2006) ที่อธิบายว่าพลังงานในการเคลื่อนย้ายอะตอมหรือโมเลกุลมีผลต่อขนาดเกรนของฟิล์มที่เคลือบได้ โดยหากพลังงานในการเคลื่อนย้ายมาก ทำให้สามารถฟอร์มตัวเป็นฟิล์มได้ดีและมีขนาดเกรนใหญ่

ความหนาของฟิล์ม พบร้า เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้น ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาเพิ่มขึ้นจาก 190 nm เป็น 220 nm เนื่องจากที่ความดันรวมสูง ปริมาณของแก๊สอาร์กอนในห้องเคลือบมีจำนวนมาก ส่งผลให้อ่อนของแก๊สอาร์กอนสามารถสปัตเตอร์อะตอมของไฟฟ้าเนียมออกมานะในปริมาณสูง และรวมตัวกับแก๊สออกซิเจนเป็นสารประกอบของฟิล์มตกลงเคลือบบนวัสดุรองรับได้มาก ทำให้ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนามากขึ้น แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Sirghi, Aoki, and Hatanaka (2002) ซึ่งพบร้าความดันรวมเพิ่มขึ้น อัตราเคลือบมีค่าลดลง ส่งผลให้ความหนาของฟิล์มลดลง เนื่องจากอัตราเคลือบขึ้นกับอัตราการสปัตเตอร์และความน่าจะเป็นของการชนแบบกระเจิง (Scattering Collisions) ของสปัตเตอร์อะตอมกับอะตอมของแก๊สที่อยู่รอบ ๆ

ความหยาบผิวของฟิล์ม พบร้า เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้น ความหยาบผิวของฟิล์มที่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยที่ความดันรวมเท่ากับ 5.0×10^{-3} mbar มีค่าความหยาบผิวสูงสุดเท่ากับ 5.9 nm เนื่องจากฟิล์มที่เคลือบได้เป็นเฟสเดียวของรูไทร์/อนาเทส ลักษณะเกรนของฟิล์มเป็นแบบแหลมสูงและหลุมลึกขนาดต่ำๆ ทำให้ผิวน้ำของฟิล์มมีลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ แตกต่างกันมาก ส่งผลโดยตรงต่อค่าความหยาบผิว ส่วนที่ความดันรวมเท่ากับ 3.0×10^{-3} mbar ฟิล์มที่ได้เป็นเฟสรูไทร์ และที่ความดันรวมเท่ากับ 7.0×10^{-3} mbar และ 9.0×10^{-3} mbar ฟิล์มที่เคลือบได้เป็นเฟสアナเทส โดยโครงสร้างพลีกของฟิล์มแต่ละแบบนั้นมีผลต่อค่าความหยาบผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Li et al. (2006) ที่อธิบายผลของการดันรวมต่อความหยาบผิวของฟิล์มไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์ว่า เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้นจะทำให้ฟิล์มบางไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์มีความหยาบผิวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อความดันรวมมีค่าเพิ่มขึ้นจะทำให้ความน่าจะเป็นในการชนกันของอนุภาคสารเคลือบเพิ่มขึ้น แต่ทำให้พลังงานของอนุภาคสารเคลือบลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการเคลื่อนที่ของอนุภาคสารเคลือบและ Adatom บนวัสดุรองรับมีค่าลดลง จนความหยาบผิวมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

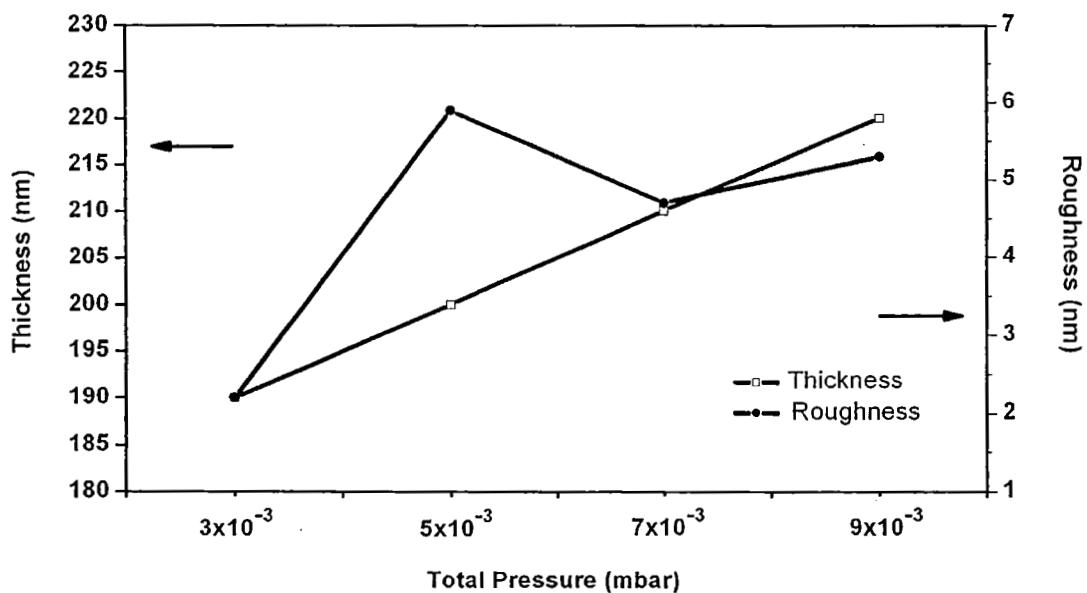


ภาพที่ 4-7 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM ที่ความดันรวมต่าง ๆ

- (a) 3×10^{-3} mbar
- (b) 5×10^{-3} mbar
- (c) 7×10^{-3} mbar
- (d) 9×10^{-3} mbar

ตารางที่ 4-6 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ

ความดันรวม (mbar)	ความหนา (nm)	ความหยาบผิว (nm)
3×10^{-3}	190	2.2
5×10^{-3}	200	5.9
7×10^{-3}	210	4.7
9×10^{-3}	220	5.3



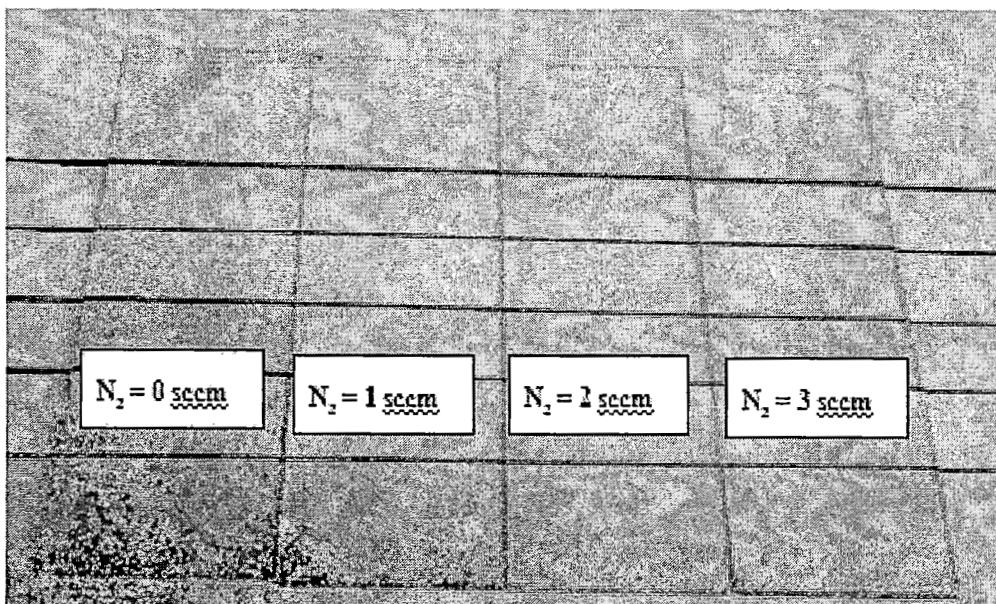
ภาพที่ 4-8 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ

4.2 การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน

ส่วนนี้เป็นการเสนอผลการศึกษาโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ่ง โดยลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนที่ศึกษาประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างผลึก ค่าคงที่แลตทิช ขนาดผลึก ความหนา ลักษณะพื้นผิว และสมบัติทางแสงของฟิล์มบางที่เคลือบได้ ตอนนี้เป็นการศึกษาผลการเจือในโตรเจนต่อ ลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่เคลือบได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

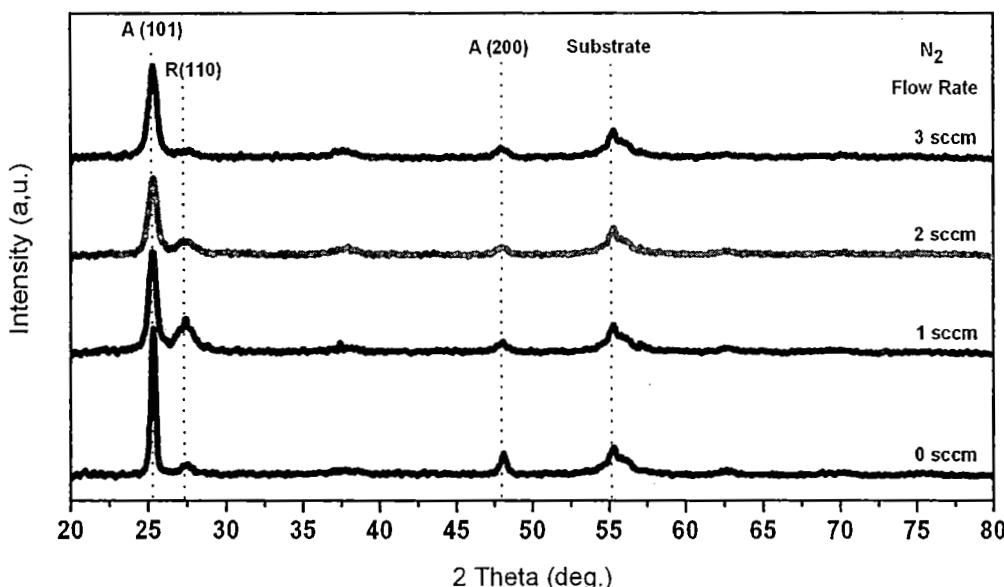
1. ผลของอัตราไหลงแก๊สในโตรเจน

1.1 ลักษณะทางกายภาพ พิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนที่เคลือบได้มีอ แปรค่าอัตราไหลงแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่ามีลักษณะใส ส่องผ่านแสงได้ ดังแสดงในภาพที่ 4-9



ภาพที่ 4-9 ลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนที่เคลือบบนกระจกสไลด์ที่ อัตราไหลงแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ

1.2 โครงสร้างผลึก ภาพที่ 4-10 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ของพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนเคลือบบนแผ่นซิลิกอน เมื่อปรับค่าอัตราไหเดแก๊สในโตรเจนพบว่าพิล์มที่เคลือบโดยไม่เจือแก๊สในโตรเจน มีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 25.34° , 27.28° และ 47.98° ซึ่งตรงกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4920 และ 89-4921 ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเตต拉ゴโนอลที่เฟสонаเทสระนาบ (101), เพส្តรุ่ท์ระนาบ (110) และ เพส្តอนາเทสระนาบ (200) ตามลำดับ และเมื่อเพิ่มอัตราไหเดแก๊สในโตรเจนที่เจือในกระบวนการเคลือบเป็น 1 sccm, 2 sccm และ 3 sccm พิล์มที่ได้มีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุมเดิมทั้งหมด แต่ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของทุกรอบนาบมีแนวโน้มลดลง โดยที่เฟสอนาคตระนาบ (101) มีความเข้มของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hernández-Rodríguez et al. (2008) ที่อธิบายผลของอัตราไหเดแก๊สในโตรเจนที่มีต่อโครงสร้างผลึกของพิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนว่า เมื่ออัตราไหเดแก๊สในโตรเจนเพิ่มขึ้นพิล์มที่เคลือบได้ยังคงมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบอนาคตไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราไหเดแก๊สในโตรเจน



ภาพที่ 4-10 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนที่ อัตราไหเดแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ

ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มที่ได้จากสูตรการคำนวณหาระยะห่างระหว่างระนาบผลึกในระบบผลึกแบบเตตระโนกอล โดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่ได้ พบว่าค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางเฟสอนาคต คือ a มีค่าอยู่ในช่วง $3.781 \text{ \AA} - 3.792 \text{ \AA}$ และ c มีค่าอยู่ในช่วง $9.361 \text{ \AA} - 9.567 \text{ \AA}$ ตรงตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4921 ของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาคต ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเตตระโนกอล ($a = 3.777 \text{ \AA}$ และ $c = 9.501 \text{ \AA}$) ส่วนฟิล์มบางเฟสรูไทล์นั้นไม่สามารถคำนวณหาค่าคงที่แลตทิชได้ เนื่องจากฟิล์มที่เคลือบได้เกิดเพียงระนาบเดียว ดังแสดงในตารางที่ 4-7

สำหรับขนาดผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้จากสมการของ Seherrer จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่เคลือบได้ พบว่าเมื่ออัตราไหหลแก๊สในโตรเจนเพิ่มขึ้น ขนาดผลึกมีแนวโน้มลดลง โดยมีค่าอยู่ในช่วง $27.14 \text{ nm} - 50.88 \text{ nm}$ ดังแสดงในตารางที่ 4-8 โดยขนาดผลึกของฟิล์มที่ไม่เจือในโตรเจน มีขนาดเท่ากับ 50.88 nm เมื่อเจือในโตรเจนในกระบวนการเคลือบด้วยอัตราไหหลแก๊สในโตรเจนเท่ากับ 1 sccm ผลึกมีขนาดลดลงเป็น 31.36 nm และสุดท้ายเมื่ออัตราไหหลแก๊สในโตรเจนเท่ากับ 2 sccm และ 3 sccm ผลึกมีขนาดเท่ากับ 30.72 nm และ 27.14 nm ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chiu et al. (2007) ซึ่งพบว่าเมื่ออัตราไหหลแก๊สในโตรเจนที่ใช้เจือในกระบวนการเคลือบเพิ่มขึ้น ฟิล์มที่เคลือบได้มีขนาดผลึกลดลง เนื่องจากในโตรเจนที่เจือในกระบวนการเคลือบจะไปลดความสามารถในการเคลื่อนที่ (Mobility) ของอะตอมไทเทเนียมและออกซิเจนซึ่งส่งผลต่อการเกิดนิวคลีโอซั่น (Nucleation) ของสารเคลือบที่จะฟอร์มตัวเป็นฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนในที่สุด (Hukaru et al., 2002; Mohamed et al., 2004)

ตารางที่ 4-7 ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนที่ เมื่อใช้อัตราไหหลแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ

ค่าคงที่แลตทิช	มาตรฐาน JCPDS (89-4921)	อัตราไหหลแก๊สในโตรเจน (sccm)			
		0	1	2	3
$a (\text{\AA})$	3.777	3.783	3.783	3.783	3.783
$c (\text{\AA})$	9.501	9.444	9.444	9.444	9.444

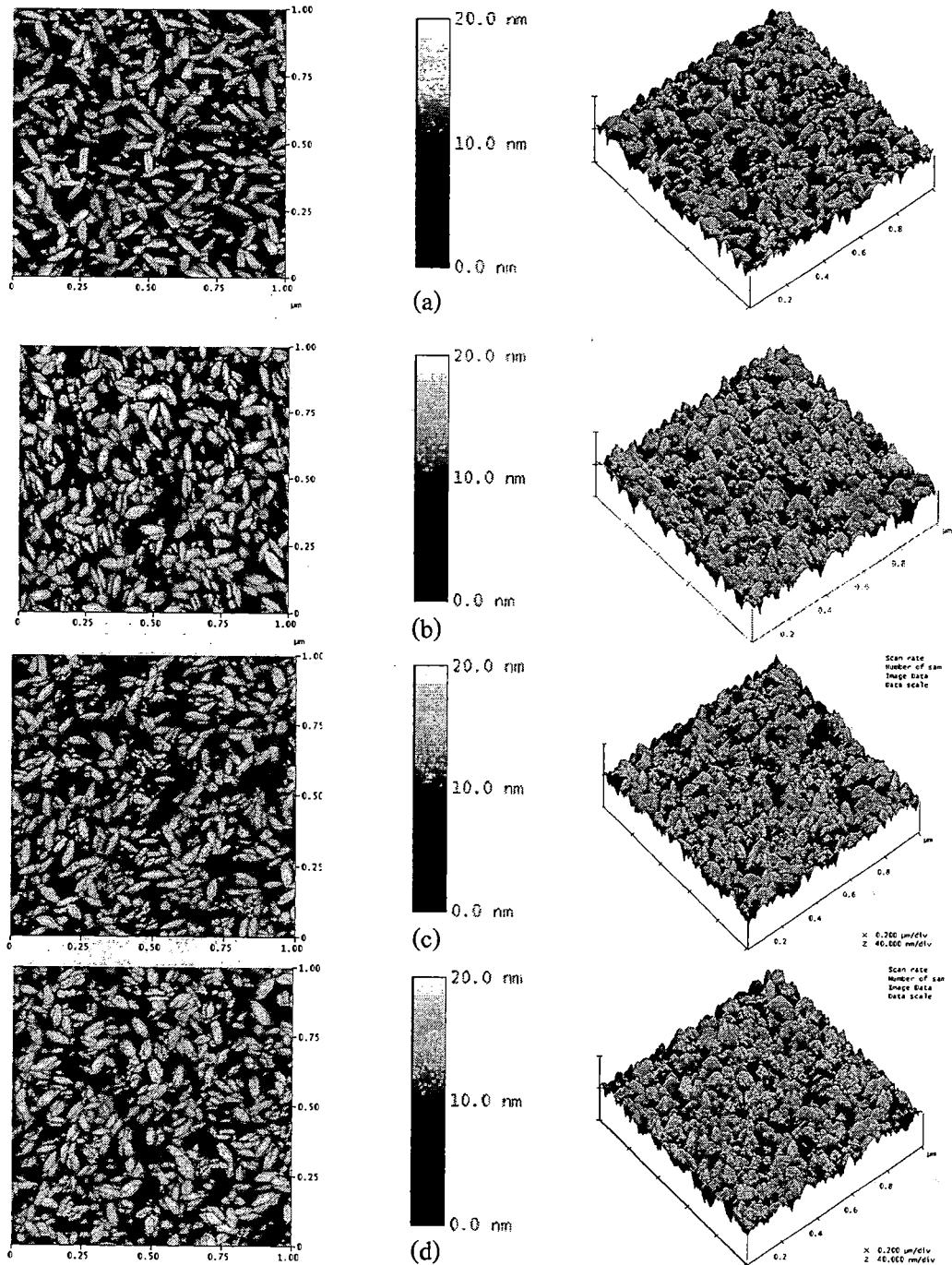
ตารางที่ 4-8 ขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนที่ อัตราไหหลแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ

อัตราไหหลแก๊สในโตรเจน (sccm)	FWHM (องศา)	ขนาดผลึก (nm)
0	0.016	50.8
1	0.260	31.3
2	0.265	30.7
3	0.300	27.1

1.3 ความหนาและลักษณะพื้นผิว ภาพที่ 4-11 แสดงลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนซึ่งเคลือบด้วยอัตราไหლแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ จากเทคนิค AFM พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เม็ดไดเจือในโตรเจน ที่ผิวหน้าฟิล์มมีเกรนขนาดใหญ่ เรียวกะกระจายอยู่ ทั่วพื้นผิว และเมื่อเจือในโตรเจนในฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยอัตราไหลแก๊สในโตรเจนเท่ากับ 1 sccm, 2 sccm และ 3 sccm พบร้าเกรนเริ่มเปลี่ยนเป็นขนาดเล็ก และจับกลุ่มกันเป็นก้อนกระจายอยู่ทั่วผิวหน้า ฟิล์ม สำหรับความหนาและความหมายของพื้นผิวของฟิล์มพบว่า เมื่ออัตราไหลแก๊สในโตรเจนเพิ่มขึ้น ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาเพิ่มขึ้น จาก 225 nm เป็น 236 nm ส่วนความหมายผิวมีค่าอยู่ในช่วง 4.1 nm – 5.4 nm ดังแสดงในตารางที่ 4-9

ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ พบร้าลักษณะเกรนของฟิล์มเปลี่ยนไปตามอัตราไหลแก๊ส ในโตรเจน โดยฟิล์มที่เคลือบเมื่อไม่เจือในโตรเจน พบร้าเกรนมีขนาดใหญ่และเรียวยาว แต่เมื่อเจือในโตรเจนในกระบวนการเคลือบฟิล์มด้วยอัตราไหลแก๊สในโตรเจนเท่ากับ 1 sccm, 2 sccm และ 3 sccm เกรนของฟิล์มเริ่มจับกลุ่มกันเป็นก้อนและมีขนาดเล็ก ซึ่งต่างกับงานวิจัยของ Chui et al. (2007) ที่พบว่า ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบเมื่อไม่เจือในโตรเจนเกรนของฟิล์มมีลักษณะเป็นก้อนกลม (Small Round-Shape Nodules) แต่เมื่อเจือในโตรเจนในกระบวนการเคลือบพบว่า เกรนของฟิล์มมีลักษณะเป็น ก้อนแหลม (Acute Angle-Shape Nodules)

ความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้ พบร้าเมื่ออัตราไหลแก๊สในโตรเจนในกระบวนการเคลือบเพิ่มขึ้น ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเพิ่มขึ้นจาก 225 nm เป็น 236 nm เนื่องจากเมื่อปริมาณ แก๊สในโตรเจนในระบบเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แก๊สในโตรเจนสามารถรวมตัวกับอัตราไหลแก๊ส ออกซิเจนเป็นสารเคลือบและตกเคลือบบนวัสดุรองรับได้มาก ซึ่งทำให้ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนามากขึ้น ส่วนความหมายผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ พบร้าเมื่ออัตราไหลแก๊สในโตรเจนในกระบวนการเคลือบเพิ่มขึ้น ความหมายผิวมีค่าอยู่ในช่วง 4.1 nm - 5.4 nm

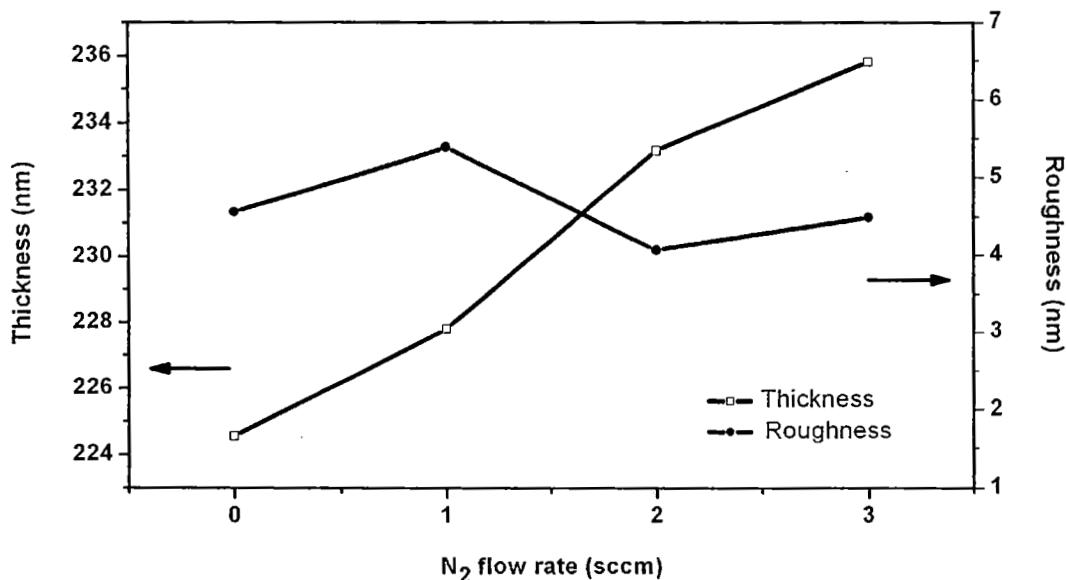


ภาพที่ 4-11 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ในโตรเจนที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM ที่อัตราไฟลแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ

- (a) 0 sccm
- (b) 1 sccm
- (c) 2 sccm
- (d) 3 sccm

ตารางที่ 4-9 ความหนา และความหยาบผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนที่อัตราไหเลแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ

อัตราไหเลแก๊สในโตรเจน (sccm)	ความหนา (nm)	ความหยาบผิว (nm)
0	225	4.6
1	228	5.4
2	233	4.1
3	236	4.5



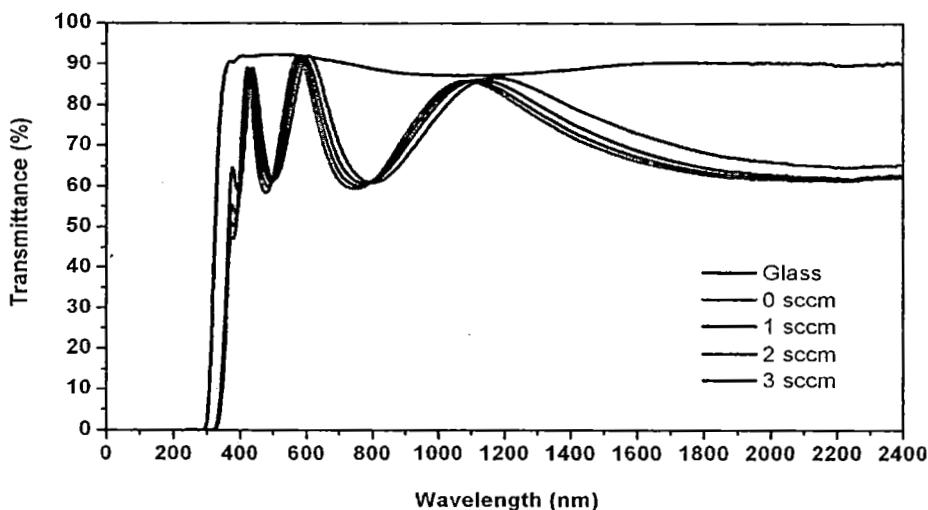
ภาพที่ 4-12 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนที่อัตราไหเลแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ

4.3 สมบัติทางแสงและแบบพลังงานของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

ส่วนนี้เป็นผลการศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่เคลือบบนกระจกสไลด์ โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ 5 sccm : 15 sccm และปริมาณอัตราไหหลแก๊สในไตรเจนอยู่ในช่วง 1 sccm – 3 sccm เพื่อศึกษาผลของอัตราไหหลแก๊สในไตรเจนต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน โดยสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่ศึกษาประกอบด้วย การส่งผ่านแสง ด้านนี้หักเห สัมประสิทธิ์การดับสูญ และแบบพลังงาน

1. การส่งผ่านแสง

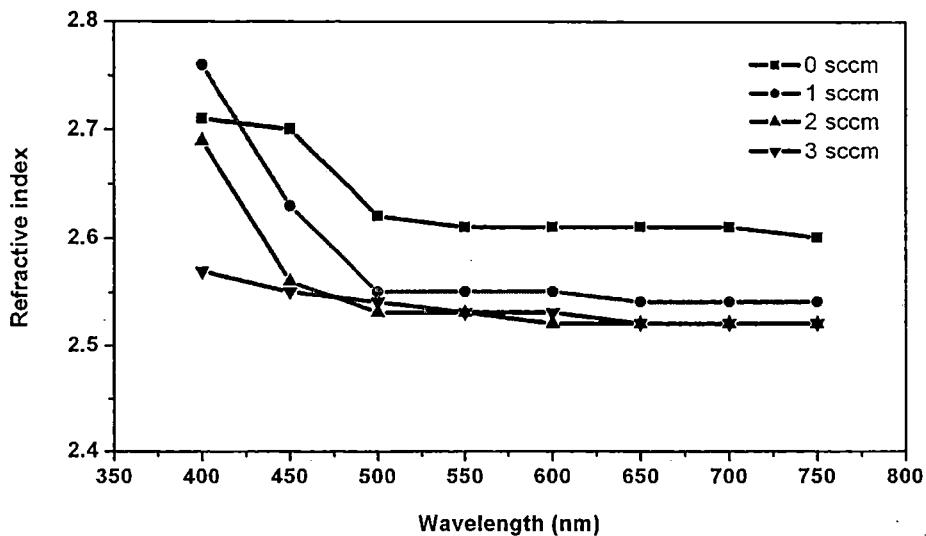
ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่เคลือบ เมื่อแบรค่าอัตราไหหลแก๊สในไตรเจน มีค่าการส่งผ่านแสงได้ดีในช่วงตามหัวและอนฟราเรดใกล้ (ความยาวคลื่นในช่วง 300 nm - 2500 nm) โดยมีค่าการส่งผ่านแสงสูงตลอดความยาวคลื่นที่พิจารณา ทั้งนี้หากพิจารณาสเปกตรัมการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่เคลือบได้ทั้งหมดพบว่ามีลักษณะคล้ายการกระเพื่อมของคลื่นกล่าวคือมีค่าเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันตลอดความยาวคลื่นแสงที่พิจารณา เนื่องจากการแทรกสอดของแสงผ่านชั้นของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่เคลือบบนแผ่นกระจกสไลด์นั้นเอง



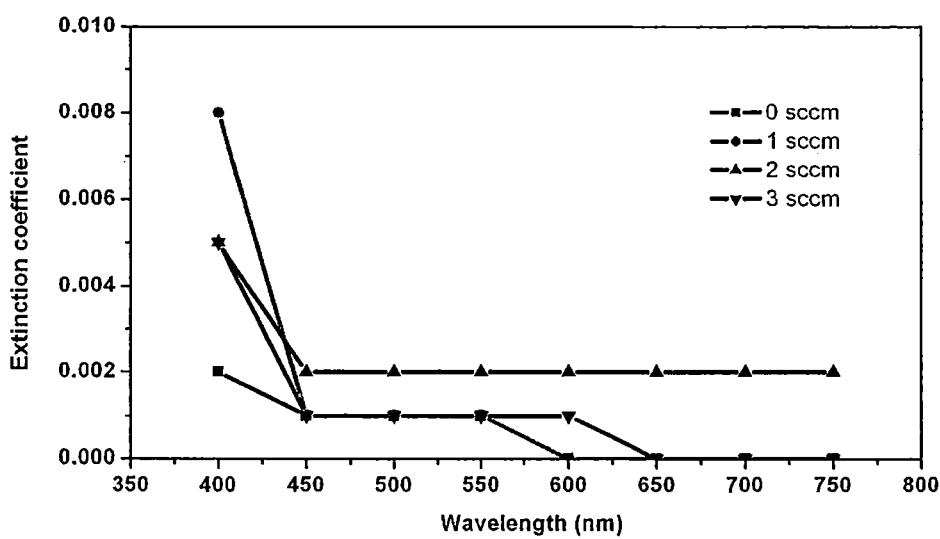
ภาพที่ 4-13 การส่งผ่านแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน
ที่อัตราไหหลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

2. ดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสูญ

สำหรับค่าดัชนีหักเห (*k*) และสัมประสิทธิ์การดับสูญ (*k*) ของฟิล์มที่เคลือบได้ หาจากวิธี Envelope โดยใช้ข้อมูลสเปกตรัมการส่งผ่านแสงมาคำนวณในช่วงความยาวคลื่น 400 nm – 750 nm สำหรับแต่ละอัตราไหลแก๊สในโตรเจน พบร้าค่าดัชนีหักเหของฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าเปลี่ยนไปตามความยาวคลื่น โดยในช่วงความยาวคลื่นเท่ากับ 400 nm – 500 nm ดัชนีหักเหมีค่าลดลง และมีค่าค่อนข้างคงที่ในช่วงความยาวคลื่นเท่ากับ 500 nm – 750 nm ทั้งนี้พบว่าดัชนีหักเหมีค่าลดลงเมื่ออัตราไหลแก๊สในโตรเจนเพิ่มขึ้น โดยที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 550 nm ฟิล์มบางไหเทเนียมได้ออกไซด์เจือในโตรเจน มีค่าดัชนีหักเหลดลงจาก 2.61 เป็น 2.53 (ภาพที่ 4-14) สำหรับฟิล์มที่เคลือบได้เมื่อเจือในโตรเจน ในช่วง 1 sccm - 3 sccm ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wu, Ma, and Shang (2005) ที่ศึกษาผลการเจือในโตรเจนต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไหเทเนียมได้ออกไซด์แล้ว พบร้าค่าดัชนีหักเหของฟิล์มที่เจือในโตรเจนมีค่าลดลง เมื่ออัตราไหลแก๊สในโตรเจนในการเจือเพิ่มขึ้น ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญของฟิล์มที่เคลือบได้นั้น มีแนวโน้มลดลงซึ่งเปลี่ยนไปตามความยาวคลื่นและอัตราไหลแก๊สในโตรเจนที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วงความยาวคลื่นเท่ากับ 400 nm – 450 nm ค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญลดลงอย่างเห็นได้ชัด ที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 550 nm ฟิล์มบางไหเทเนียมได้ออกไซด์เจือในโตรเจนมีค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญอยู่ในช่วง 0.001 – 0.002 (ภาพที่ 4-15) ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญของฟิล์มที่เคลือบได้ พบร้าสำหรับฟิล์มชุดที่ไม่เจือในโตรเจน สัมประสิทธิ์การดับสูญมีค่าเท่ากับ 0.001 ซึ่งใกล้เคียงศูนย์แสดงให้เห็นว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีการดูดกลืนตัวจึงมีลักษณะใสส่งผ่านแสงได้ดี ขณะที่ฟิล์มชุดที่เคลือบโดยมีการเจือในโตรเจนในกระบวนการเคลือบฟิล์มด้วยอัตราไหลแก๊สในโตรเจนเท่ากับ 1 sccm ถึง 3 sccm พบร้าค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญมีค่าในช่วง 0.001-0.002 ใกล้เคียงฟิล์มชุดที่ไม่เจือในโตรเจน



ภาพที่ 4-14 ดัชนีหักเหของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน
ที่อัตราไหโลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ



ภาพที่ 4-15 สัมประสิทธิ์การดับสูญของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน
ที่อัตราไหโลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

3. แบบพลังงาน

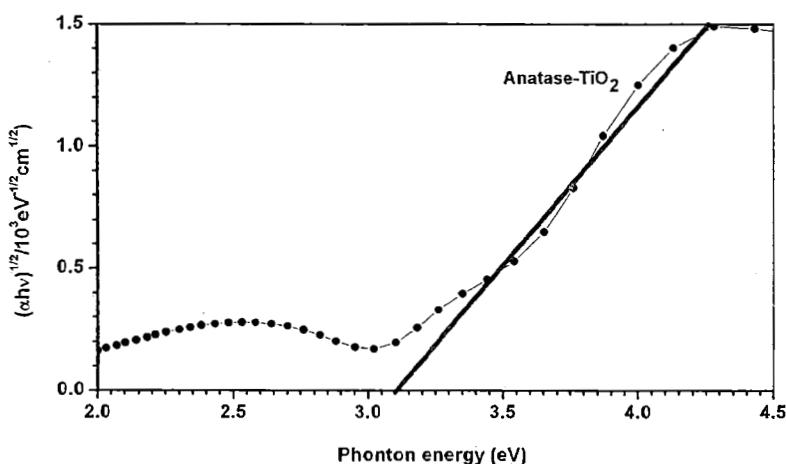
ค่าแบบพลังงานของฟิล์มที่เคลือบได้ จาก $\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^m$ เมื่อ $m = 2$ (Chiu et al., 2007) ได้ผลสรุปดังตารางที่ 4-10 พบว่าสำหรับกรณีฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาคต ไม่เจือในไตรเจน พบว่า มีค่าแบบพลังงานเท่ากับ 3.10 eV (รูปที่ 4-16) ส่วนฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน พบว่ามีค่าแบบพลังงาน 2 ช่วง คือ (1) มีค่าเท่ากับ 3.20 eV ซึ่งเป็นค่าแบบพลังงานของฟิล์มบางไทเทเนียม ไดออกไซด์เฟสอนาคต และ (2) มีค่าอยู่ในช่วง 2.40 eV – 2.60 eV นอกจากนี้ยังพบว่าค่าแบบพลังงาน ของฟิล์มที่เคลือบได้ มีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่ออัตราไหโลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 4-17)

สำหรับค่าแบบพลังงานของฟิล์มบางที่เคลือบได้ พบร่วมกับค่าฟิล์มชุดที่เคลือบได้เมื่อไม่เจือในไตรเจน มีค่าแบบพลังงานเท่ากับ 3.10 eV ใกล้เคียงค่าแบบพลังงานของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Luca et al. (2007) ซึ่งเคลือบฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์โดยไม่เจือในไตรเจน แล้วได้เฟสอนาคตซึ่งมีค่าแบบพลังงานเท่ากับ 3.09 eV

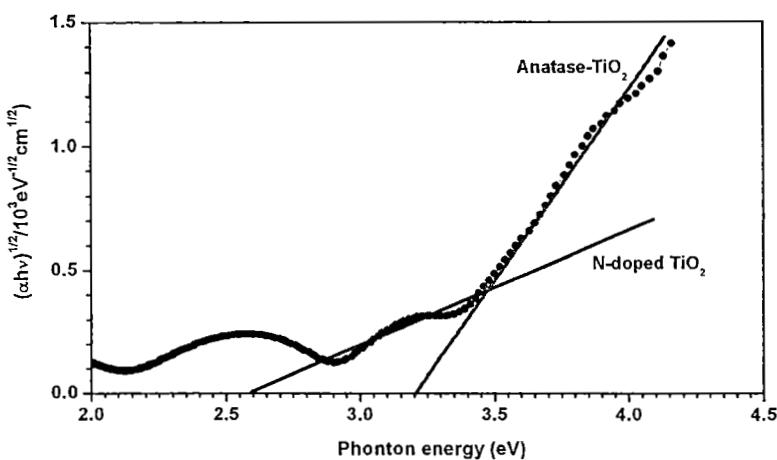
ส่วนฟิล์มที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้เมื่อเจือในไตรเจนด้วยอัตราไหโลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 1 sccm ถึง 3 sccm พบร่วมกับค่าแบบพลังงานของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาคต (3.20 eV) (Herman et al., 2006) และ (2) มีค่าแบบพลังงานประมาณ 2.50 eV ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าแบบพลังงานของ ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาคต และมีค่าลดลงเมื่ออัตราไหโลแก๊สในไตรเจนที่เจือมีค่าเพิ่มขึ้น โดยแบบพลังงานของฟิล์มที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้มีค่าลดลงจาก 2.60 eV เป็น 2.40 eV สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Hernández-Rodríguez et al. (2008) ที่พบว่าเมื่อเจือในไตรเจนจะทำให้ค่าแบบพลังงาน ของฟิล์มเปลี่ยนไป คือมีค่าลดลงจาก 3.50 eV เป็น 2.70 eV ทั้งนี้จากการเปลี่ยนค่าแบบพลังงานของฟิล์ม ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้ เมื่อมีการเจือในไตรเจนในกระบวนการ การเคลือบ จาก 3.20 eV เป็น 2.50 eV สรุปได้ว่า งานวิจัยนี้สามารถเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนได้สำเร็จ

ตารางที่ 4-10 แบบพลังงานของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือและไม่เจือในไตรเจน

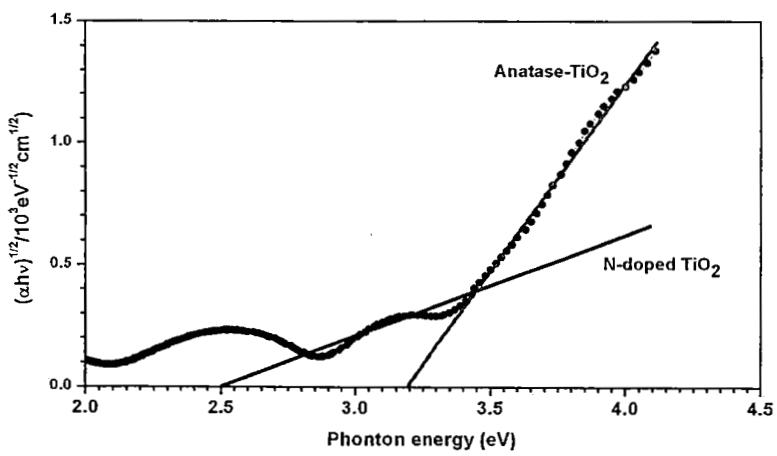
อัตราไหลแก๊สในไตรเจน (sccm)	แบบพลังงาน (eV)	
	ไทเทเนียมไดออกไซด์ เฟสอนาคต	ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ ในไตรเจน
0	3.10	-
1	3.20	2.60
2	3.20	2.50
3	3.20	2.40



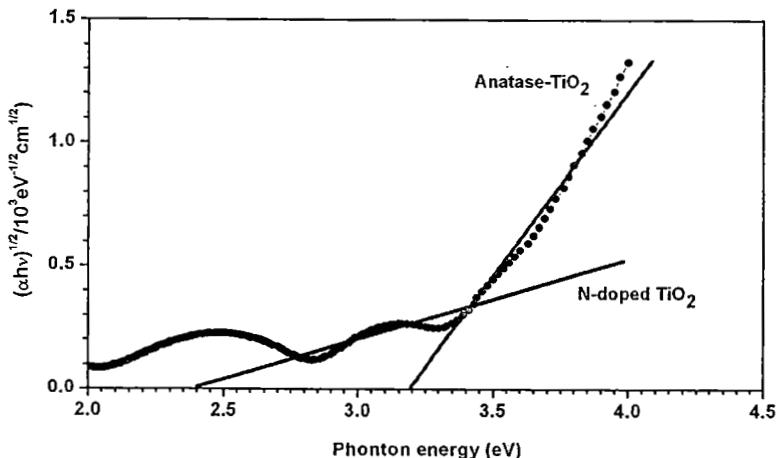
ภาพที่ 4-16 แบบพลังงานของฟิล์มบางฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาคต



(a)



(b)



(c)

ภาพที่ 4-17 แบบพลังงานของฟิล์มบางฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในตรรженที่อัตราไหโลแก๊สในตรรженต่าง ๆ

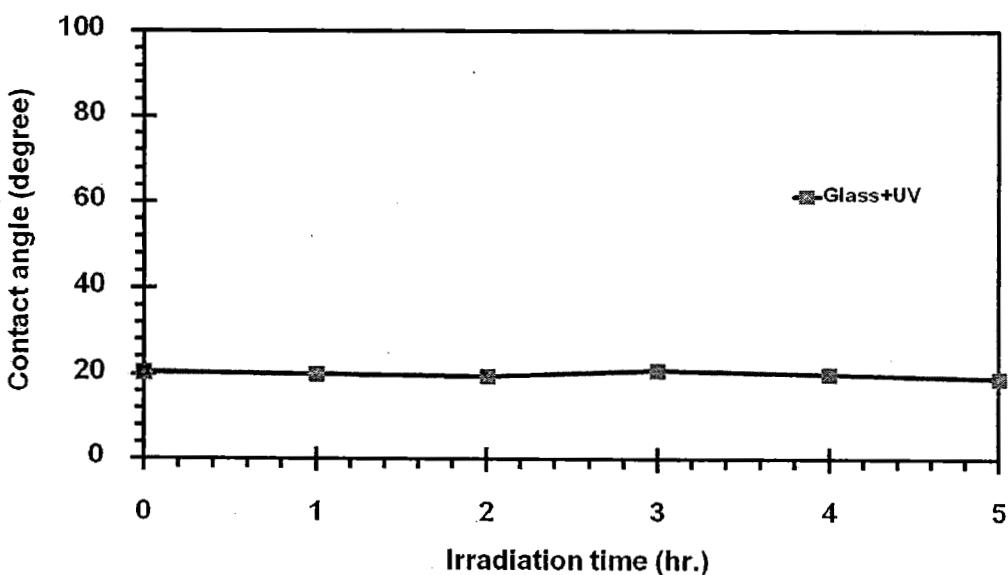
(a) = 1 sccm (b) = 2 sccm (c) = 3 sccm

4.4 สมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

ส่วนนี้เป็นผลการศึกษาสมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนเคลือบบนกระจกสไลเดอร์ ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้

1. สมบัติไฮโดรฟิลิกของกระจกไม่เคลือบฟิล์ม

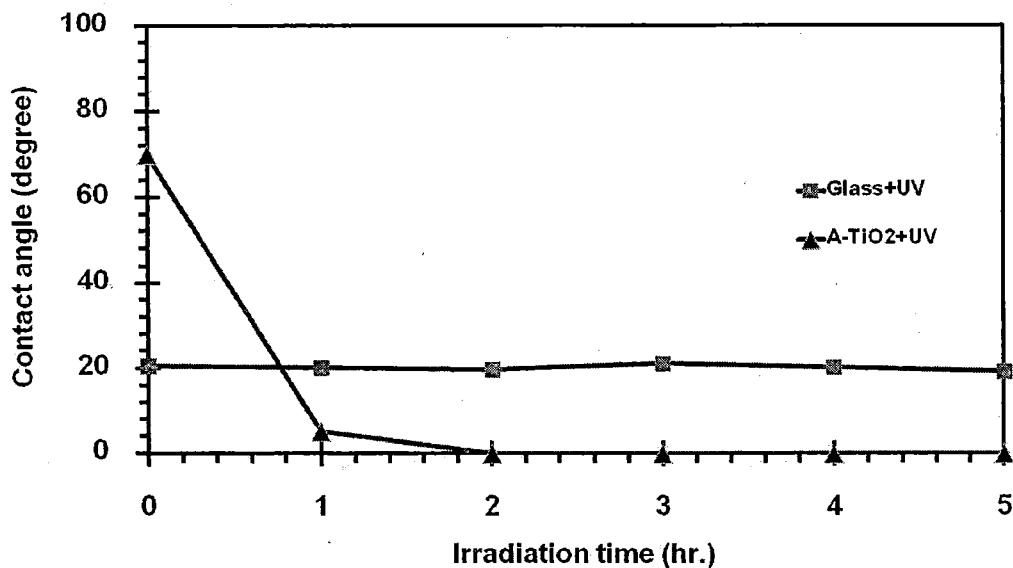
เมื่อนำกระจกที่ไม่เคลือบฟิล์มมาวัดมุมสัมผัสของหยดน้ำบนพื้นผิวน้ำของกระจกสไลเดอร์ พบร่วมมุมสัมผัสของหยดน้ำบนกระจกไม่เคลือบฟิล์มก่อนฉายแสงยูวีของกระจกมีค่าประมาณ 20 องศา เมื่อนำไปฉายแสงยูวีเป็นเวลา 5 ชั่วโมง พบร่วมมุมสัมผัสยังคงมีค่าประมาณ 20 องศา แสดงว่ากระจกที่ไม่เคลือบฟิล์มไม่สามารถแสดงสมบัติไฮโดรฟิลิก สอดคล้องกับรายงานของ พรนภา สุจิตรรกุล (2548) ที่กล่าวว่าโดยทั่วไปมุมสัมผัสของกระจกแผ่นเรียบธรรมดามีค่าประมาณ 20-30 องศา (ภาพที่ 4-18)



ภาพที่ 4-18 ค่ามุมสัมผัสกับเวลาการฉายแสงอัลตราไวโอเลตของกระจกที่ไม่เคลือบฟิล์ม

2. สมบัติไฮโดรฟิลิกของกระเจ้าเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสонаเทส

เมื่อนำกระเจ้าที่เคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสонаเทสมาวัดมุ่งสัมผัสของหยดน้ำพบว่ามุ่งสัมผัสของหยดน้ำบนกระเจ้าเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสонаเทสก่อนฉายแสงอัลตราไวโอเลตมีค่าประมาณ 70 องศา เมื่อนำไปฉายแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 5 ชั่วโมง พบร่วมสัมผัสดลงตามเวลาที่ฉายแสง โดยเมื่อฉายไปเป็นนาน 1 ชั่วโมง มุ่งสัมผัสดลงเหลือประมาณ 5 องศา และ มีค่าเป็น 0 องศา เมื่อฉายแสงอัลตราไวโอเลตนาน 2 ชั่วโมง (ภาพที่ 4-19)

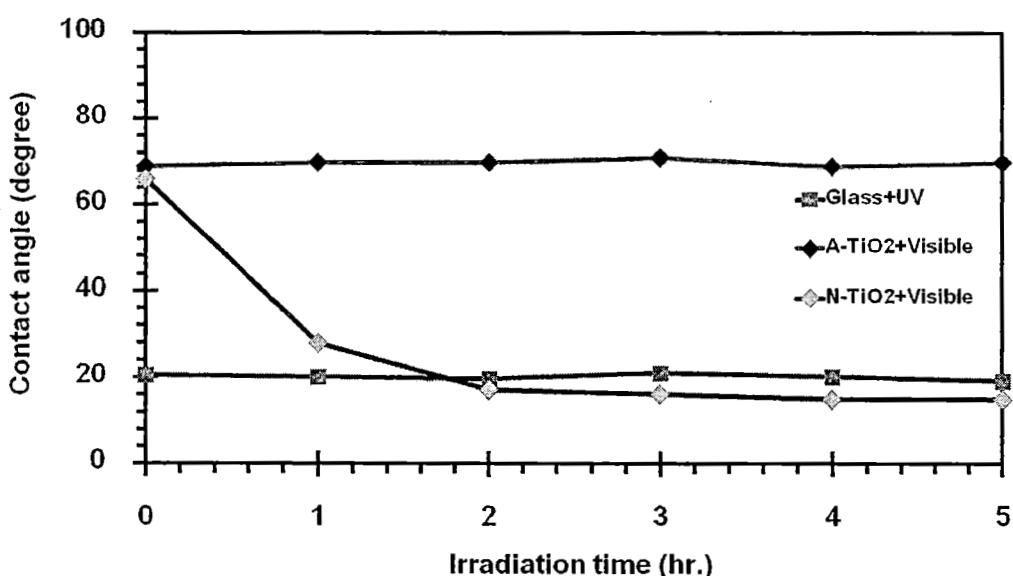


ภาพที่ 4-19 ค่ามุ่งสัมผัสดับเวลาการฉายแสงอัลตราไวโอเลตของกระเจ้าเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสонаเทส

3. สมบัติไฮโดรฟิลิกของกระจกเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เจือในโตรเจน

เมื่อนำกระจกที่เคลือบพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เจือในโตรเจนที่อัตราไอลแก๊สในโตรเจนเท่ากับ 3 sccm มาวัดมุมสัมผัสของหยดน้ำหลังการฉายรับแสงอัลตราไวโอเลต พบร่วมมุมสัมผัสของหยดน้ำก่อนฉายแสงฟูลอเรสเซนต์มีค่าประมาณ 65 องศา เมื่อนำไปฉายแสงฟูลอเรสเซนต์เป็นเวลา 5 ชั่วโมง พบร่วมมุมสัมผัสมีค่าลดลงตามเวลาที่ฉายแสง โดยเมื่อฉายไปเป็นนาน 1 ชั่วโมง มุมสัมผัสลดลงเหลือประมาณ 30 องศา และ มีค่าเป็น 20 องศาเมื่อฉายแสงนาน 2 ชั่วโมง และคงที่ไปจนเวลาในการฉายแสงเท่ากับ 5 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่ากระจกที่เคลือบพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เจือในโตรเจนสามารถแสดงสมบัติไฮโดรฟิลิกได้เมื่อสัมผัสแสงฟูลอเรสเซนต์ แต่ยังไม่ดีนัก (ภาพที่ 4-20)

ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบสมบัติไฮโดรฟิลิกของกระจกเคลือบพิล์มไทเทเนียมได้ออกไซด์เฟสонаเทส กับ กระจกเคลือบพิล์มไทเทเนียมได้ออกไซด์เจือในโตรเจน เมื่อฉายแสงฟูลอเรสเซนต์ โดยนำกระจกเคลือบพิล์มไทเทเนียมได้ออกไซด์เฟสонаเทสมาฉายรับแสงฟูลอเรสเซนต์เป็นเวลา 5 ชั่วโมง พบร่วมมุมสัมผัสของหยดน้ำบนกระจกเคลือบพิล์มไทเทเนียมได้ออกไซด์เฟสонаเทสก่อนฉายแสงฟูลอเรสเซนต์มีค่าประมาณ 70 องศา เมื่อนำไปฉายแสงฟูลอเรสเซนต์นาน 5 ชั่วโมง พบร่วมมุมสัมผัสรยังคงมีค่าใกล้เคียงค่าเริ่มต้นคือมีค่าประมาณ 70 องศา แสดงว่ากระจกเคลือบพิล์มไทเทเนียมได้ออกไซด์เฟสонаเทสไม่สามารถแสดงสมบัติไฮโดรฟิลิกได้เมื่อสัมผัสแสงฟูลอเรสเซนต์ (ภาพที่ 4-20)



ภาพที่ 4-20 ค่ามุมสัมผัสถ้าเวลาการฉายแสงอัลตราไวโอเลตของ กระจกเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์เจือในโตรเจน

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

1. การเตรียมพิล์มบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เฟสонаเทส

1.1 ผลของอัตราไหლแก๊สออกซิเจน

- พิล์มบางไทเทเนียมโดยออกไซด์ที่เคลือบได้มีสีม่วง และสีเขียวอ่อน

- โครงสร้างผลึกของพิล์มที่เคลือบได้ทุกเงื่อนไขมีเฟสонаเทสระนาบ (101) และ เฟส anaเทสระนาบ (200) โดยความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของเฟสонаเทสระนาบ (101) มีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราไหลแก๊สออกซิเจนในกระบวนการเคลือบ โดยที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 15 sccm มีความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด

- ขนาดผลึกของพิล์มที่เคลือบได้มีค่าเพิ่มขึ้นจาก ประมาณ 54 nm เป็น 65 nm เมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น

- อัตราไหลแก๊สออกซิเจนมีผลต่อความหนาและความหยาบผิวของพิล์มที่เคลือบได้โดยเมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นความหนาและความหยาบผิวของพิล์มมีค่าลดลงจาก 238 nm เป็น 215 nm และ 5.92 nm เป็น 4.85 nm ตามลำดับ

1.2 ผลของความดันรวม

- พิล์มบางไทเทเนียมโดยออกไซด์ที่เคลือบได้มีสีม่วงอ่อน และสีเขียวอมฟ้า

- โครงสร้างผลึกของพิล์มเปลี่ยนไปตามความดันรวม โดยที่ความดันรวมต่ำพิล์มที่เคลือบได้มีเฉพาะเฟสรูไทร์ แต่เมื่อความดันรวมเพิ่มสูงขึ้นพิล์มเปลี่ยนเป็นเฟสสมของรูไทร์/อนาเทส และเป็นเฟสонаเทสในที่สุด

- ขนาดผลึกของพิล์มที่เคลือบได้มีค่าเพิ่มขึ้นจาก ประมาณ 17 nm เป็น 58 nm เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้น

- ความดันรวมมีผลต่อความหนาและความหยาบผิวของพิล์มที่เคลือบได้ โดยเมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้นความหนามีค่าเพิ่มขึ้นจาก 190 nm เป็น 220 nm ส่วนความหยาบผิวมีค่าอยู่ในช่วง 2.2 nm - 5.9 nm

2. การเตรียมพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

2.1 พิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่เคลือบได้มีลักษณะใส สั่งผ่านแสง

2.2 โครงสร้างผลึก พิล์มที่เคลือบเมื่อไม่เจือในไตรเจนมีเฟสสมของรูไทล์/อนาเทส พิล์มชุดที่เจือในไตรเจนในกระบวนการเคลือบ ยังคงมีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เหมือนพิล์มชุดที่ไม่เจือในไตรเจน และเมื่ออัตราไทเทลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ลดลงทุกรายนาบ

2.3 อัตราไทเทลแก๊สในไตรเจนมีผลต่อความหนาและความหยาบผิวของพิล์มบางที่เคลือบได้โดยเมื่ออัตราไทเทลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นพิล์มมีความหนาและความหยาบผิวมากขึ้นเล็กน้อย

3. สมบัติทางแสงและแบบพลังงานของพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

3.1 พิล์มบางที่เคลือบได้มีลักษณะใส สามารถส่งผ่านแสงได้ดีในช่วงตามองเห็นและอินฟราเรดใกล้ (ความยาวคลื่นในช่วง 300 – 2500 nm)

3.2 ดัชนีหักเหของพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่เคลือบได้ พิจารณาที่ความยาวคลื่นแสงเท่ากับ 550 nm พบร้าพิล์มมีค่าดัชนีหักเหเท่ากับ 2.6 และมีค่าลดลงเป็น 2.5 เมื่อเจือในไตรเจนในกระบวนการเคลือบ

3.3 ค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญของของพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่ได้พิจารณาที่ความยาวคลื่นแสงเท่ากับ 550 nm พบร้าพิล์มมีค่าเท่ากับ 0.001 และพิล์มชุดที่เคลือบได้ เมื่อการเจือในไตรเจนมีค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญอยู่ในช่วง 0.001 – 0.002 พบร้าใกล้เคียงพิล์มชุดที่ไม่เจือในไตรเจน

3.4 แบบพลังงาน (E_g) ของพิล์มที่เคลือบได้เมื่อไม่เจือในไตรเจนมีค่าเท่ากับ 3.10 eV ขณะที่พิล์มที่เคลือบได้เมื่อมีการเจือในไตรเจนมีแบบพลังงาน 2 ค่า คือ (1) มีค่าเท่ากับ 3.20 eV และ (2) มีค่าประมาณ 2.50 eV และมีค่าลดลงเมื่ออัตราไทเทลแก๊สในไตรเจนที่เจือในกระบวนการเคลือบ มีค่าเพิ่มขึ้น โดยมีค่าลดลงจาก 2.60 eV เป็น 2.40 eV แสดงว่า งานวิจัยนี้สามารถเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนได้สำเร็จ

4. สมบัติไฮโดรฟิลิกของพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

4.1 กระจกไม่เคลือบพิล์มมีมุนสัมผัสเท่ากับ 20 องศา เมื่อสัมผัสแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลานาน 5 ชั่วโมง มุนสัมผัสยังคงเท่าเดิมคือ 20 องศา แสดงว่ากระจกจะรرمดาไม่แสดงสมบัติไฮโดรฟิลิก

4.2 กระจกเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาคต แสดงสมบัติไฮโดรฟิลิกได้โดยมุนสัมผัสลดจาก 70 องศา เป็น 0 องศา เมื่อสัมผัสแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง

4.3 กระจกเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาคต ไม่แสดงสมบัติไฮโดรฟิลิก เมื่อสัมผัสแสงในช่วงตามองเห็น

4.4 กระจกเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนเฟสอนาคต สามารถแสดงสมบัติไฮโดรฟิลิกได้เมื่อสัมผัสแสงในช่วงตามองเห็น โดยมุนสัมผัสลดจากประมาณ 70 องศา เป็น 20 องศา เมื่อสัมผัสแสงในช่วงตามองเห็นเป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. งานวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงการศึกษาหลักการเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับเตรียมพิล์มบางที่มีสมบัติไฮโดรฟลิกเมื่อสัมผัสแสงในช่วงตามเห็นเท่านั้นดังนั้น ควรศึกษาเทคนิค ขั้นตอน ตลอดจนผลของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อสมบัติของพิล์มชนิดนี้
2. ควรมีการทดลองเคลือบเจือสารชนิดอื่นๆ เพื่อศึกษาข้อดี-ข้อเสียของสารเจือแต่ละชนิดต่อสมบัติไฮโดรฟลิกของพิล์มไทด์เนียมไดออกไซด์
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมตลอดจนสมบัติต่างๆ ของพิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์เจือในโตรเจน
4. ควรมีการทดลองเคลือบพิล์มบางไทด์เนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจนบนวัสดุชนิดต่างๆ

เอกสารอ้างอิง

- พรนภา สุจิตรกุล. (2548). กระจกвиเศษ ทำความสะอาดตัวเอง (Self-Cleaning Glass). *CERAMIC Journal*, 69-71.
- พิเชษฐ์ ลีมสุวรรณ และธนัสตา รัตนะ. (2547). การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวโลหะด้วยวิธีสปัตเตอร์링ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2. รายงานการวิจัยประจำปี 2547. ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (หน้า 163-166). กรุงเทพฯ: ภาควิชาพิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- อดิศร บูรณวงศ์. (2551). สภาพขอบน้ำของฟิล์มบางไฟฟานียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซี สปัตเตอร์ิง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพิสิกส์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
- Asahi, R., Morikawa, T., Ohwaki, T., Aoki, K, and Taga, Y. (2001). Visible-Light Photocatalysis in Nitrogen-Doped Titanium Oxides. *Science*, 293, 269 – 271.
- Bally, A. R., Hones, P., Sanjines, R., Schmid, P. E., & Levy, F. (1998). Mechanical and Electrical Properties of fcc TiO_{1+x} Thin Film Prepared by r.f. Reactive Sputtering. *Surface and Coatings Technology*, 108, 166-170.
- Barnes, M.C., Kumar, S., Green, L., Hwang, N.M. and Gerson, A.R. (2005). The mechanism of low temperature deposition of crystalline anatase by reactive DC magnetron sputtering. *Surface and Coatings Technology*, 190, 321-330.
- Bunshah, R. F. (1994). *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings* (2nd ed.). New Jersey: Noyes.
- Chapman, B. (1980). *Glow Discharge Processes*. New York: John Wiley & Sons.
- Chen, S-Z., Zhang, P-Y., Zhuang, D-M. and Zhu, W-P. (2004). Investigation of nitrogen doped TiO_2 photocatalytic films prepared by reactive magnetron sputtering. *Catalysis Communications*, 5, 677–680.
- Chiu, S-M., Chen, Z-S., Yang, K-Y., Hsu, Y-L. and Dershin, G. (2007). Photocatalytic activity of doped TiO_2 coatings prepared by sputtering deposition. *Journal of Materials Processing Technology*, 192–193, 60–67.
- Guan, K. (2005) Relationship between photocatalytic activity, hydrophilicity and self-cleaning effect of TiO_2/SiO_2 films. *Surface & Coatings Technology*, 191, 155-160.

- Herman, D., Sicha, J. and Musil, J. (2008). Magnetron sputtering of TiO_xNy films. *Vacuum* 81, 285-290.
- Hernández-Rodríguez, E., Márquez-Herrera, A. and Zapata-Navarro, A. (2008). Optical and structural characterization of TiO_xNy films deposited by reactive magnetron sputtering. *REVISTA MEXICANA DE FÍSICAx* 55, 102–104.
- Hoffmann, M.R., Martin, S.T., Choi, W. and Bahnemann, D.W. (1995). Environmental Applications of Semiconductor Photocatalysis. *Chem. Rev.*, 95, 69-96
- Li, G. K., Shen, J. J., Mi, W. B., Li, Z. Q., Wu, P., Jiang, E. Y., & Bai, H.L. (2006). Fabrication and Characterization of Facing-Target Reactive Sputtered Polycrystalline TiO₂ Films. *Applied Surface Science*, 253, 425-431.
- Liu, B., Wena, L. and Zhao, X. (2008). The structure and photocatalytic studies of N-doped TiO₂ films prepared by radio frequency reactive magnetron sputtering. *Solar Energy Materials & SolarCells*, 92, 1–10.
- Luca, D., Teodorescu, C.-M., Apetrei, R., Macovei, D. and Mardare, D. (2007). Preparation and characterization of increased-efficiency photocatalytic TiO_{2-x}N_x thin films. *Thin Solid Films*, 515, 8605–8610.
- McHale, G., Shirtcliffe, N. J., and Newton, M. I. (2004). Contact-Angle Hysteresis on Super-Hydrophobic Surfaces. *Langmuir*, 20, 10146-10149.
- Munz, W. D. (1991). The Unbalanced Magnetron : Current Status of Development. *Surface and Coatings Technology*, 48, 81-94.
- Park, S.K. and Heo, J.E. (2007). Characteristics of N-doped titanium oxide prepared by the large scaled DC reactive magnetron sputtering technique. *Separation and Purification Technology*, 58, 200–205.
- Prabakara, K., Takahashia, T., Nezukaa, T., Takahashia, K., Nakashimab, T., Kubotac, Y. and Fujishima, A. (2008). Visible light-active nitrogen-doped TiO₂ thin films prepared by DC magnetron sputtering used as a photocatalyst. *Renewable Energy*, 33, 277–281
- Rickerby, D. S., & Matthews, I. (1991). *Advanced Surface Coating: a Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.
- Rohde, S. L., & Munz, W. D. (1991). *Sputter Deposition in Advanced Surface Coatings: A Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.

- Serpone, N., Lawless, D., Disdier, J. and Herrmann, J.M. (1994). Spectroscopic, Photoconductivity, and Photocatalytic Studies of TiO₂ Colloids: Naked and with the Lattice Doped with Cr³⁺, Fe³⁺, and V⁵⁺ Cations. *Langmuir*, 10, 643-652.
- Silveyra, R., Sáenz, L., Flores, W., Martínez, V. And Elguézabal, A. (2005). Doping of TiO₂ with nitrogen to modify the interval of photocatalytic activation towards visible radiation. *Catalysis Today*, 107–108, 602–605
- Sirghi, L., Aoki, T., & Hatanaka, Y. (2002). Hydrophilicity of TiO₂ Thin Films Obtained by Radio Frequency Magnetron Sputtering Deposition. *Thin Solid Films*, 442, 55-61.
- Smith, D. L. (1995). *Thin-Film Deposition : Principle And Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Sproul, W. D. (1992). Unbalanced Magnetron Sputtering. 35th Annual Technical Conference Proceedings. *Society of Vacuum Coaters*, 236-239.
- Takeuchi, M., Yamashita, H., Matsuoka, M., Anpo, M., Hirao, T., Itoh, N. and Iwamoto, N. (2000). Photocatalytic decomposition of NO under visible light irradiation on the Cr-ion-implanted TiO₂ thin film photocatalyst. *Catalysis Letters*, 67, 135–137.
- Toku, H., Pessoa, R. S., Maciel, H. S., Massi, M., & Mengui, U.A. (2008). The Effect of Oxygen Concentration on the Low Temperature Deposition of TiO₂ Thin Films. *Surface and Coatings Technology*, 202, 2126-2131.
- Vaz, F., Cerqueira, P., Rebouta, L., Nascimento, S.M.C., Alves, E., Goudeau, Ph., Rivie're, J.P., Pischeda, K. and de Rijk, J. (2004). Structural, optical and mechanical properties of coloured TiNxOy thin. *Thin Solid Films* , 447–448, 449–454.
- Vossen, J. L., & Kerns, W. (1978). *Thin Films Processes*. New York: Academic Press.
- Wasa, K. & Hayakawa, S. (1992). *Handbook of sputter deposition technology: principles, technology and applications*. New Jersey:Noyes.
- Wong, Ming-Show., Chou, Hung Pang. and Yang, Tien-Syh. (2006). Reactively sputtered N-doped titanium oxide films as visible-light photocatalyst. *Thin Solid Films*, 494, 244 – 249.
- Wu, K.R., Wang, J.J., Liu, W.C., Chen, Z.S. and Wu, J.K. (2006). Deposition of graded TiO₂ films featured both hydrophobic and photo-induced hydrophilic properties. *Applied surface Science*, 255, 5829-5838.
- Wu, P.-G., Ma, C.-H., & Shang, J.K. (2004). Effects of nitrogen doping on optical properties of TiO₂ thin films. *Applied Physics A*, 81, 1411-1417.
- Yamagishi, M., Kuriki, S., Song, P. K., & Shigesato, Y. (2003). Thin Film TiO₂ Photocatalyst Deposited by Reactive Magnetron Sputtering. *Thin Solid Films*, 442, 227-231.

- Zeman, P. and Takabayashi, S. (2002). Effect of Total and Oxygen Partial Pressures on Structure of Photocatalytic TiO₂ Films Sputtered on Unheated Substrate. *Surface and Coatings Technology*, 153, 93-99.
- Zhao, X.T., Sakka, K., Kihara, N., Takada, Y., Arita, M. and Masuda, M. (2005). Structure and photo-induced features of TiO₂ thin films prepared by RF magnetron sputtering. *Microelectronics Journal*, 36, 549-551.
- Zou, Z., Ye, J., Sayama, K. and Arakawa, H. (2001). Direct splitting of water under visible light irradiation with an oxide semiconductor photocatalyst, *Nature*, 414, 625–627.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ผลงานของโครงการวิจัย

ผลงานของโครงการวิจัย

การเตรียมฟิล์มบางนาโนของ TiO_xNy สำหรับประยุกต์ในกระจกทำความสะอาดตัวเอง

1. ผลงานตีพิมพ์

1. วรรณิศา ชะงัดรัมย์, พัชรี ภักดีเสน่ห์, รุ่งทิวา อุสุวรรณ, อารีตัน สมหวังสกุล, นิรันดร์ วิทิตอนันต์, อดิศร บูรณวงศ์, สุรศิริ ไชยคุณ. 2556. ผลของการดันรวมต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไ泰เนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีเมกนีตรอนสปัตเตอร์. ใน การประชุมวิชาการ “ศринครินทร์วิโโรมวิชาการ” ครั้งที่ 7 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศринครินทร์วิโโรม จ.กรุงเทพฯ. 1-2 เมษายน 2556.
2. วรรณิศา ชะงัดรัมย์, นิรันดร์ วิทิตอนันต์, อดิศร บูรณวงศ์, สุรศิริ ไชยคุณ. 2556. โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไ泰เนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีอันบาลานซ์เมกนีตรอนสปัตเตอร์. ใน การประชุมวิชาการฟิสิกส์ประยุกต์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ อาคารนวัฒนธรรมราชวิถี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ. กรุงเทพฯ. 26 เมษายน 2556.
(ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น)

2. การบริการวิชาการ

การให้ความอนุเคราะห์ภาควิชาอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานและผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมของโครงการวิจัยฯ ตลอดจนเป็นวิทยกรบรรยายแก่ภาควิชาอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ 7 ครั้ง

3. การผลิตบุคลากร

โครงการวิจัยนี้มีนิสิต ระดับปริญญาโท วท.ม.(ฟิสิกส์) เข้าร่วม 1 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล นส.วรรณิศา ชะงัดรัมย์

หัวขอวิทยานิพนธ์ โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไ泰เนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน
ชีงเคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีเมกนีตรอนสปัตเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์

ผลงานตีพิมพ์ - 1



SWU7-077: ผลของความดันรวมต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไกเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟเดซิเมกนิตรอนสปัตเตอร์

**EFFECT OF TOTAL PRESSURES ON STRUCTURAL OF TITANIUM DIOXIDE THIN FILM
DEPOSITED BY REACTIVE DC MAGNETRON SPUTTERING METHOD**

วรรณิศา ชัยตั้มรัมย์^{1,2*}, พัชรี ภักติเสนหรา^{1,2}, รุ่งกิรา ญี่สุวรรณ^{1,2}, อารีรัตน์ สมหวังสกุล^{1,2}
นิรันดร์ วิทิตตันนนท์^{1,2}, อธิษร บูรณะวงศ์^{1,2}, สุรัสิงห์ ไชยคุณ^{1,2}

Wannisa Changadram^{1,2*}, Pacharee Pakdeesahneha^{1,2}, Rungtiwa Ausuwan^{1,2},
Areerat Somwangsakun^{1,2}, Nim Witit-anun^{1,2}, Adisorn Buranawong^{1,2}, Surasing Chaiyakun^{1,2}

¹ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

¹Department of Physics, Faculty of Science, Burapha University, Thailand.

²ห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสม่าสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) สกอ.

²Plasma for Surface Sciences Laboratory, Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP), CHE.,
Thailand.

*Corresponding author, E-mail: one-wannisa@hotmail.com

บทคัดย่อ

ฟิล์มบางไกเทเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) เป็นวัสดุสำคัญที่ถูกนำมาใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ความดันรวมต่อโครงสร้างของฟิล์มโดยวิธีรีแอคตีฟเดซิเมกนิตรอนสปัตเตอร์ เพื่อศึกษาผลของความดันรวมต่อโครงสร้างของฟิล์ม ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม โดยศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มทั้งทางเทคนิค XRD และ AFM ฟิล์มที่ได้รีแอคต์กับไนโตรเจนโดยใช้ไนโตรเจนในโครงสร้างของฟิล์ม XRD พบว่า ฟิล์มที่ได้เป็นแบบพหุผลลักษณะสัมพันธ์กับ R(110), A(101) และ A(200) โดยเปลี่ยนจากเฟสรูไทล์ เป็นเฟสสมของรูไทล์/อนาคต และอนาคต เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้น ขนาดผลึกจากสมการของ Scherrer มีค่าในช่วง 17-58 nm. ความหนาและความหมายพื้นผิวของฟิล์มจากผล AFM พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 190 nm ถึง 220 nm และ 2.2 nm ถึง 5.9 nm ตามลำดับ

คำสำคัญ: ฟิล์มบาง วิธีรีแอคตีฟเดซิเมกนิตรอนสปัตเตอร์ ไกเทเนียมไดออกไซด์

Abstract

Titanium dioxide (TiO_2) thin films are widely used as an essential material in the optical fields. In this work, TiO_2 films were deposited on glass slides and Si-wafer, by DC reactive magnetron sputtering system. The effect of total pressure on the crystalline structure, film's thickness and surface morphology was investigated. The films have been characterized by XRD and AFM. The as-deposited TiO_2 films were transparent. The crystal structures from XRD results show that the as-deposited films have polycrystalline structure, which corresponding to R(110), A(101) and A(200), which change from

rutile to mixed phases of rutile/anatase and anatase as total pressure increases. The crystal size from Scherrer's equation was in the range of 17-58 nm. The film's thickness and surface roughness values from AFM results were ranging from 190 nm to 220 nm and 2.2 nm to 5.9 nm, respectively.

Keyword: Thin film, DC reactive magnetron sputtering, Titanium dioxide

บทนำ

ฟิล์มบางไกเกเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) เป็นฟิล์มที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีสมบัติเด่นหลายด้าน เช่น มีค่าการส่งผ่านแสงสูงในช่วงคลื่นแสงของสารเคมีและการขัดสีได้ดี มีค่าตัวคงที่หักเหสูง (2.5 สำหรับ อนาเทส และ 2.7 สำหรับไกเกอร์) มีค่าแคนบลังงานกว้าง (3.18 eV สำหรับอนาเทส และ 3.03 eV สำหรับไกเกอร์) [1,2] จึงมีการนำไปใช้งานในด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นสารประกอบที่มีสมบัติไฟโคดตะโลดิกัตซ์ (photocatalytic) ที่ดี โดยเฉพาะไฟส่องสว่าง ซึ่งมีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายในได้และลดเวลาไวอเลตได้ดีทำให้เริ่มมีการนำไปประยุกต์เป็นชั้นเคลือบที่มีสมบัติในการฆ่าเชื้อ ยังสามารถเดินทางของเชื้อแบคทีเรีย หรือ ด้านการแพทย์ เนื่องจากสารประกอบไกเกเนียมไดออกไซด์ไกเกอร์มีสมบัติฆ่าเชื้อได้ดีกับร่างกายมนุษย์ (biocompatible) ทำให้สามารถนำมาทำชั้นส่วนทางการแพทย์สำหรับใส่ในร่างกายมนุษย์ได้ เช่น ใช้ทำเป็นลิ้นหัวใจเทียม เป็นต้น [3]

ไกเกเนียมไดออกไซด์ที่พบในธรรมชาติมี 3 เฟส ได้แก่ อนาเทส (anatase) ไกเกอร์ (rutile) และบูร์ไกเกอร์ (brookite) โดยอนาเทสและไกเกอร์ มีโครงสร้างผลึกแบบเดಡราโนกล (tetragonal) ส่วนบูร์ไกเกอร์ มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบออร์โธรอมบิก (orthorhombic) ปกติแล้วไกเกเนียมไดออกไซด์ที่พบทั่วไปมักมีโครงสร้างแบบอสัณฐาน อนาเทสและไกเกอร์ทำให้แน่น แต่ไม่พมเพสบูร์ไกเกอร์ในรูปของฟิล์มบาง [4] ทั้งนี้ฟิล์มไกเกเนียมไดออกไซด์ซึ่งเตรียมที่อุณหภูมิท้องมักมีโครงสร้างแบบอสัณฐาน แต่ถ้าเตรียมที่อุณหภูมิสูงประมาณ 500°C ฟิล์มที่ได้จะมีไฟส่องสว่าง และเปลี่ยนเป็นเฟล็กท์ไกเกอร์กอหุนทูมิที่ใช้สูงประมาณ 800°C แต่การให้ความร้อนขนาดเดียบฟิล์มอาจทำให้ไม่สามารถเตรียมฟิล์มนั้นลงได้ ความร้อนที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มนั้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อฟิล์ม โดยการเพิ่มหรือใช้ส่วนผสมเพล็ก ความเย็นสูงในกระบวนการเตรียมฟิล์ม นั่นเอง จึงต้องหาวิธีการเตรียมฟิล์มที่ดีที่สุด ที่สำคัญคือการเพิ่มเติมเช้าไปในกระบวนการ การเคลือบจะช่วยให้อ่อนในเพลาスマ หรือ อะตอมของสารเคลือบมีการระดมยิง (bombard) ไปที่ผิวหน้าฟิล์มนั้น วัสดุของรัตน钇ที่กำลังเกิดการสะสมพอกพูน (deposition) เป็นขั้นตอนของฟิล์มบางซึ่งทำให้เกิดความร้อนในตัวฟิล์ม ซึ่งเรียกว่า plasma heating effect เทคนิคการทำฟิล์มนั้น ทำให้สามารถเพิ่มความร้อนในกระบวนการการเคลือบได้ [5]

จากรายละเอียดต่างๆ ข้างต้น โครงสร้างผลึกหรือเฟสของฟิล์มไกเกเนียมไดออกไซด์จะมีสมบัติหรือเหมาะสมสำหรับงานที่แตกต่างกัน โดยโครงสร้างผลึกหรือเฟสของฟิล์มไกเกเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้มักเป็นสีน้ำเงินไปตามวิธีและเงื่อนไขของการเคลือบ ทั้งนี้การเตรียมฟิล์มไกเกเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีสปัตเตอร์ริงมีข้อได้เปรียบหลักคือการได้รับการเตรียมอย่างยิ่งจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผลึกหรือเฟสของฟิล์ม ซึ่งทำได้โดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเคลือบ เช่น ระยะห่างจากผู้ผลิตสารเคลือบกับวัสดุของรัตน钇 ความดันร้อน กําลังไฟฟ้า ความตันย์ออยแก๊สออกซิเจน [6] ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การศึกษาวิจัยผลของเงื่อนไขการเคลือบที่มีผลต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไกเกเนียมไดออกไซด์มีความมีความจำเป็นและสำคัญในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นั่นเอง บกความวิจัยนี้เป็นรายงานผลการเดินทางที่ฟิล์มบางไกเกเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีสปัตเตอร์ริงที่แมกนีตรอน สปัตเตอร์ริง เพื่อศึกษาผลของความตันร้อนขณะเคลือบที่มีผลต่อโครงสร้างผลึก ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มไกเกเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยต่อไป

วัสดุประสงค์ของการวิจัย

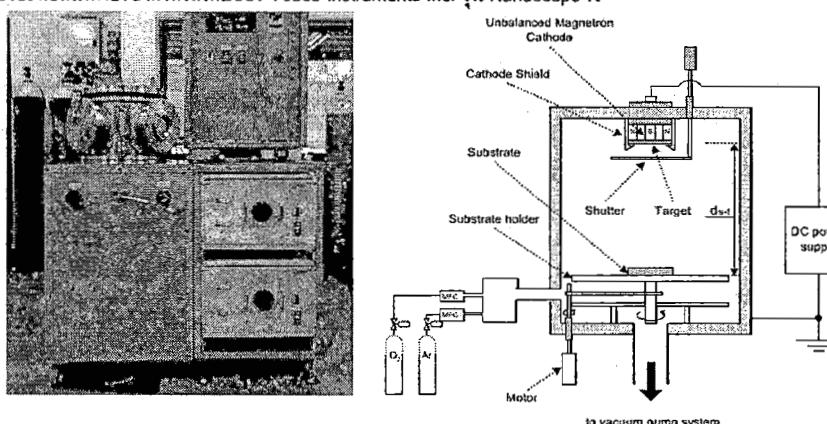
เพื่อศึกษาผลของความดันรวมขณะเคลือบ ต่อโครงสร้างผลึก ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางๆ ไกเกเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธีร็อกติฟที่ซึ่งมีแกนการอน spanning เทอร์เชน

วิธีดำเนินการวิจัย

ฟิล์มบางไกเกเนียมไดออกไซด์ในงานวิจัยนี้ เตรียมด้วยวิธีร็อกติฟที่ซึ่งมีแกนการอน spanning เทอร์เชน ด้วยเครื่องเคลือบในสูญญากาศ (ภาพที่ 1) มีห้องเคลือบทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 31.0 cm สูง 37.0 cm ติดป่าไกเกเนียม (99.97%) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.4 cm ที่ค่าโถงเรืองออกแบบให้เป็นแบบอันบาลานซ์แมกนีติวอน คาโทด (unbalanced magnetron cathode) โดยใช้แม่เหล็กความเข้มสูงที่ถูกตั้งกลวงและด้านข้างของคาโทดทำกับ 1800 G และ 1300 G ตามลำดับ ระบบเครื่องสูบน้ำสูญญากาศประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร์โวีนีเครื่องสูบกลไกด้วยปืนเครื่องสูบหัวย ความดันในห้องเคลือบวัดด้วยมาตรวัดความดันของ PFEIFFER ซึ่งประกอบด้วยชุดแสดงผล TPG262 Dual Gauge และหัววัด PKR251 Compact Full Range Gauge การจ่ายแก๊สที่ใช้ในกระบวนการเคลือบควบคุมด้วยชุดควบคุมการไหลมวล (mass flow controller) ของ MKS type 247D

การเคลือบเริ่มจากนำวัสดุรองรับเข้าห้องเคลือบลดความดันให้ต่ำกว่า 5.0x10⁻⁵ mbar ปล่อยแก๊สเข้าห้องเคลือบด้วยอัตราไหลแก๊สสารก่อนต่อแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 5 sccm : 15 sccm การเคลือบใช้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 220 W คงที่ตลอดการเคลือบ โดยฟิล์มแต่ละชุดให้เวลาเคลือบท่านกัน 90 นาที สำหรับด้าวย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือความดันรวมขณะเคลือบ (P_g) โดยใช้ความดันรวมขณะเคลือบ 4 ค่า ได้แก่ 3x10⁻³ mbar, 5x10⁻³ mbar, 7x10⁻³ mbar และ 9x10⁻³ mbar

ฟิล์มที่เคลือบได้นำไปตรวจสอบโครงสร้างผลึกถ่วงเครื่องเล็บเวนรังสีเอกซ์ ของ Bruker รุ่น D8 โดยใช้ Cu-K α ($\lambda = 1.54056 \text{ \AA}$) ตรวจด้วยมุมดูกระหบเงี้ยง (Grazing incident angle) เท่ากับ 2° สะแกนnum 20 จาก 20° ถึง 80° สี่เหลี่ยมน้ำทึบขนาดผึก (crystal size) ของฟิล์มคำนวณจากรูปแบบการเลี้ยวเบน รังสีเอกซ์ตามสมการของ Scherrer ส่วนลักษณะพื้นผิว ความหนาและความหมายพื้นผิวของฟิล์มที่ได้ศึกษาด้วยเครื่องละเอียดอ่อนมิกไพร์ซไมโครสโคปของ Veeco Instruments Inc. รุ่น Nanoscope IV

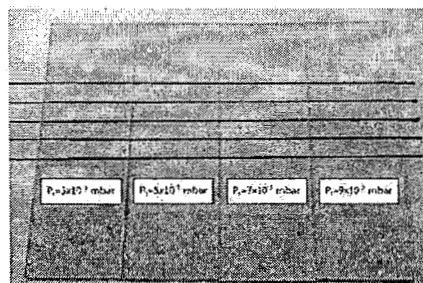


ภาพที่ 1 ลักษณะและไวดีอะแกรมของเครื่องเคลือบในสูญญากาศระบบ spanning เทอร์เชนที่ใช้ในงานวิจัย

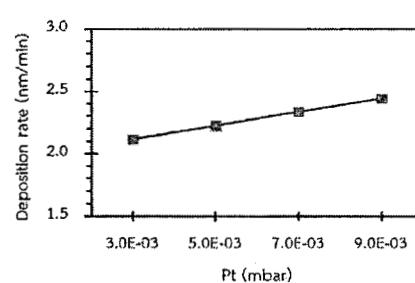
ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบาง

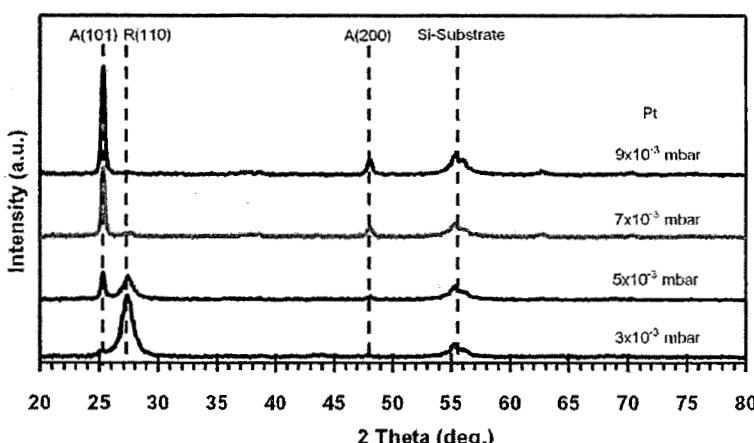
ฟิล์มบางไกเทเนียมได้ออกไซซ์ที่เคลือบได้มีลักษณะใส สัมผ่านแสงดี เมื่อสังเกตสีของพิล์มจาก การสะท้อนและสัมผ่านแสงด้วยสายตาพบว่าแสงสะท้อนที่ผิวน้ำของพิล์มน้ำจะเป็นสีขาว อ่อนข้นๆ ที่ แสงสัมผ่านพิล์มและกระดาษเป็นสีเขียวอมฟ้า (ภาพที่ 2) สำหรับอัตราเคลือบของพิล์มไกเทเนียมได้ออกไซซ์เมื่อใช้ ความดันรวมต่างๆ (อัตราเคลือบทหารากค่าความหนาพิล์มหาร้อยละเวลาที่ใช้เคลือบพิล์ม) พบว่าที่ความดันรวม เท่ากับ 3×10^{-3} mbar อัตราเคลือบมีค่าประมาณ 2.1 nm/min และเพิ่มเป็น 2.4 nm/min เมื่อความดันรวมเท่ากับ 9×10^{-3} mbar (ภาพที่ 3) เนื่องจากที่ความดันรวมขณะเคลือบสูง แก๊สสารกอนในห้องเคลือบมีปัจจัยมากทำให้ เป้าสารเคลือบ (ไกเทเนียม) มีโอกาสถูกปฏิกัดเดอร์ออกมาเป็นอุบัติของไกเทเนียมในอัตราสูง ส่งผลให้อัตรา ของไกเทเนียมปริมาณสูงที่ถูกปฏิกัดเดอร์ออกมาแน่น มีโอกาสในการทำปฏิกิริยาับแก๊สออกซิเจนแล้วฟอร์มคัตเป็น ชั้นเคลือบในลักษณะฟิล์มบางของไกเทเนียมได้ออกไซซ์บนผิวน้ำของวัสดุรองวัสดุรองวัสดุตามไปด้วย จึงเป็นเหตุผลให้ เมื่อความดันรวมขณะเคลือบเพิ่มขึ้นอัตราเคลือบเงี้ยงสูงขึ้นด้วย



ภาพที่ 2 ลักษณะพิล์มไกเทเนียมได้ออกไซซ์ที่เคลือบ บนกระดาษที่ตัวความดันรวมต่างๆ



ภาพที่ 3 อัตราเคลือบของพิล์มไกเทเนียมได้ออกไซซ์ ที่เคลือบด้วยความดันรวมต่างๆ



ภาพที่ 4 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มบางไกเทเนียมได้ออกไซซ์ที่เคลือบที่ความดันรวมต่างๆ

ผลของความดันรวมต่อโครงสร้างผลึก

ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไกเทเนียมได้ออกไซด์ที่เคลือบได้ พนวจ
เมื่อความดันรวมขณะเคลือบเพิ่มขึ้นในโครงสร้างผลึกของฟิล์มจะเปลี่ยนไป ที่ความดันรวมเท่ากับ 3.0×10^{-3} mbar
พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุน 27.28° ซึ่งตรงกับไกเทเนียมได้ออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบรูไกล์
ระหว่าง (110) ส่วนที่ความดันรวมเท่ากับ 5.0×10^{-3} mbar พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุน 25.34° และ
 27.28° ซึ่งตรงกับไกเทเนียมได้ออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบอนาเกะระหว่าง (101) และแบบรูไกล์ระหว่าง (110)
และเมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7.0×10^{-3} mbar และ 9.0×10^{-3} mbar พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่
มุน 25.34° ซึ่งตรงกับไกเทเนียมได้ออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบอนาเกะระหว่าง (101) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Yamagishi *et al.* [7] ซึ่งพนวจว่าโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไกเทเนียมได้ออกไซด์จะเปลี่ยนไปตามระดับ
ความดันรวมขณะเคลือบ โดยที่ความดันรวมค่าฟิล์มที่ได้จะมีโครงสร้างผลึกแบบรูไกล์ ขณะที่ความดันรวมสูงฟิล์มที่
ได้มีโครงสร้างผลึกแบบอนาเกะ เนื่องจากที่ความดันรวมขณะเคลือบต่ำ ระยะปลดและการชนมีค่าสูง ทำให้อuate ตอน
สารเคลือบไม่สูญเสียพลังงานเนื่องจากการชน ถังน้ำพลาสติกของอะตอนสารเคลือบซึ่งมีค่าสูงพอสำหรับใช้ใน
การฟอร์มตัวให้มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบรูไกล์ ขณะที่เมื่อความดันรวมสูงขึ้นทำให้ระยะปลดและการชนมีค่าต่ำ
อะตอนสารเคลือบมีโอกาสชนกันสูง ทำให้อuate ตอนสารเคลือบมีพลังงานค่าเพียงพอต่อการฟอร์มตัวเป็นฟิล์มบางที่มี
โครงสร้างผลึกแบบอนาเกะเท่านั้น โดยขนาดผลึกของฟิล์มที่ได้มีค่าอยู่ในช่วง 17 nm ถึง 58 nm (ตารางที่ 1)

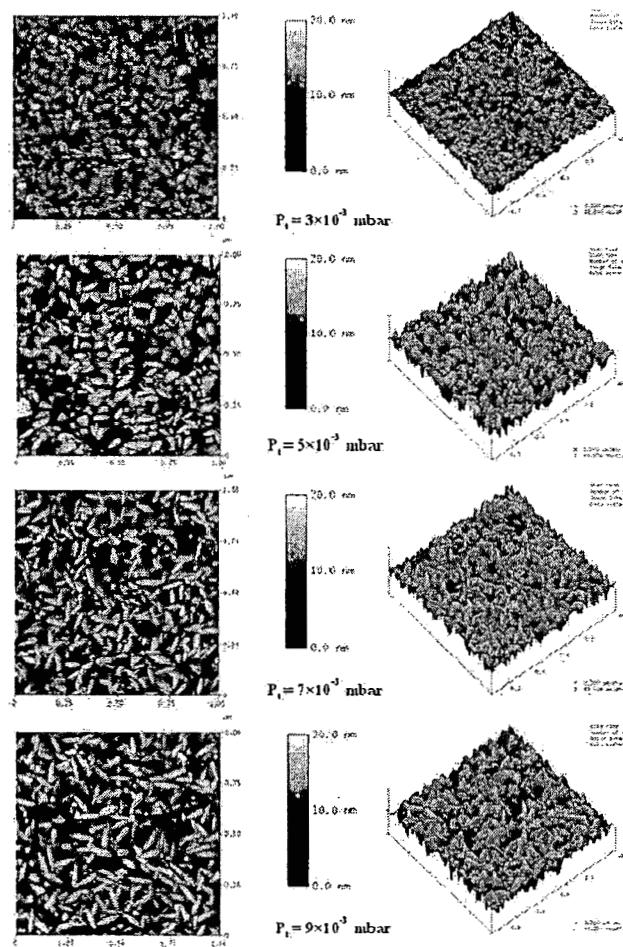
ผลของความดันรวมต่อความหนาและลักษณะพื้นผิว

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไกเทเนียมได้ออกไซด์จากเทคนิค AFM พนวจว่าลักษณะพื้นผิว
ของฟิล์มที่เคลือบได้มีอิทธิพลต่อความดันรวมต่างกัน 4 ค่า มีลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ผิวน้ำขางของฟิล์มมีลักษณะ
ขรุขระไม่ราบรื่น อะตอนสารเคลือบซึ่งตัวันเป็นกลุ่มก้อนผลึกๆ กระจายทั่วผิวน้ำฟิล์ม ทั้งนี้หากพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าเมื่อความดันรวมต่ำ ลักษณะเกรนของฟิล์มที่เคลือบได้เป็นแบบเล็กกลมมนกระเจาอยู่ทั่ว
แต่เมื่อความดันรวมสูงขึ้นลักษณะของเกรนบนผิวน้ำฟิล์มเริ่มเปลี่ยนไปมีขนาดเล็ก เรียวและแหลมขึ้นสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Yamagishi *et al.* [7] ส่วนความหนาของฟิล์มที่ได้เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้น ความหนาของฟิล์ม
ที่เคลือบได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 2.2 nm ถึง 5.9 nm (ตารางที่ 1) ยกเว้นที่ความดันรวมเท่ากับ 5.0×10^{-3} mbar
พบว่ามีความหนาของฟิล์มที่ได้มีโครงสร้างผลึกแบบสมของรูไกล์/อนาเกส ลักษณะ
เกรนของฟิล์มเป็นแบบแหลมสูงและกลุ่มผลึกขนาดต่างๆ ทำให้มีความขรุขระต่อน้ำมาก ส่วนที่ความดันรวม
เท่ากับ 3.0×10^{-3} mbar ฟิล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกเฉพาะแบบรูไกล์ และที่ความดันรวมขณะเคลือบท่ากับ
 7.0×10^{-3} mbar และ 9.0×10^{-3} mbar ฟิล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกเฉพาะแบบอนาเกส โดยโครงสร้างผลึกของ
ฟิล์มแต่ละแบบนั้นมีผลต่อค่าความหนาของฟิล์มที่ได้

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลของความดันรวมต่อความหนาฟิล์มที่ได้ พนวจว่าเมื่อความดันรวมขณะเคลือบเพิ่มขึ้น
ความหนาฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากที่ความดันรวมขณะเคลือบสูง แก๊สออกซิเจนในห้องเติ่อมมีปริมาณมาก
ทำให้มีไอออนของแก๊สออกซิเจนจำนวนมากทำให้บ้าสารเคลือบ (ไกเทเนียม) มีไอออนสูงสุดเดอร์ออกามาเป็น
อะตอนของไกเทเนียมในปริมาณสูง และมีโอกาสทำปฏิกิริยา กับแก๊สออกซิเจนแล้วฟอร์มตัวเป็นชั้นเคลือบ
ในลักษณะฟิล์มบางของไกเทเนียมได้ออกไซด์บนผิวน้ำของวัสดุรองรับสูง จึงเป็นเหตุผลให้เมื่อความดันรวม
เพิ่มขึ้น ความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าสูงขึ้น จากความหนาประมาณ 190 nm เป็น 220 nm เมื่อความดันรวม
เพิ่มจาก 3.0×10^{-3} mbar เป็น 9.0×10^{-3} mbar

ตารางที่ 1 ความหนา ความหยาบคิ่ว ขนาดผลึกและเพสของฟิล์มน้ำยาไกเกเนียมโดยออกไซด์
เคลือบที่ความดันรวมต่างๆ

ความดันรวม (mbar)	ความหนา (nm)	ความหยาบคิ่ว (nm)	ขนาดผลึก (nm)	เพส
3×10^{-3}	190	2.2	17	รูไทล์
5×10^{-3}	200	5.9	58	รูไทล์/อะเทส
7×10^{-3}	210	4.7	49	อะเทส
9×10^{-3}	220	5.3	51	อะเทส



ภาพที่ 5 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มน้ำยาไกเกเนียมโดยออกไซด์เคลือบที่ความดันรวมต่างๆ

สรุป

ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกเคลือบบนกระเจาส์แลดและแผ่นชิลกอนด้วยวิธีดีซีร์แอดค์ฟแมกนีตอรอน สป๊ดเดอเริง ผลการศึกษาพบว่า ความดันรวมที่ใช้ขณะเคลือบฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์มีผลลัพธ์โครงสร้างผิวฟิล์มที่เปลี่ยนไป โดยที่ความดันรวมที่ใช้ฟิล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างผิวฟิล์มแบบมนูโภร์ แต่เมื่อความดันรวมเพิ่มสูงขึ้นโครงสร้างผิวของฟิล์มเปลี่ยนเป็นแบบมนูโภร์/อนาคต และแบบอนาคตในที่สุด ส่วนลักษณะพื้นผิว ความหนาและความหนาแน่น พบร่วมกับความดันรวมต่ำกว่าของฟิล์มที่เคลือบได้มีลักษณะกลมมน และเปลี่ยนเป็นลักษณะที่เรียกว่า แหลมที่มีความดันรวมเพิ่มสูงขึ้น ส่วนความหนาและความหนาแน่นของฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง "การเตรียมฟิล์มบางนาโนของ TiO_xNy สำหรับประยุกต์ในกระบวนการทางเคมีและเคมีอินทรีย์" ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก "ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินรายได้" (เงินอุดหนุนจากวัสดุฯ) มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการอนุญาตไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการทำวิจัย

เอกสารอ้างอิง

- [1] Li, G.H., Yang, L., Jin, Y.X. and Zhang, L.D. (2000). Structural and optical properties of TiO₂ Thin film and TiO₂ + 2wt.% ZnFe₂O₄ composite film prepared by r.f. sputtering. *Thin Solid Films.* 368: 163-167.
- [2] Pulker, H.K. (1984). Coatings on Glass. *Elsevier Science Publishers B.V.* 311.
- [3] Takeda, S., Suzuki, S., Odaka, H. & Hosono, H. (2001). Photocatalytic TiO₂ thin film deposited onto glass by DC magnetron sputtering. *Thin Solid Film.* 392: 338-344.
- [4] Läbl, P., Huppertz, M. and Mergel, D. (1994). Nucleation and growth in TiO₂ films prepared by sputtering and evaporation. *Thin Solid Films.* 251: 72-79.
- [5] Wilit-Anan, N.; Kasemanankul, P., Chaiyakun, S., Pokaipisit, A., and Limsuwan, P. (2010). Comparison of Nanocrystalline TiO₂ Films Prepared on Unheated Substrates Using Single- and Dual-Cathode DC Unbalanced Magnetron Sputtering Systems. *Japanese Journal of Applied Physics.*
- [6] Zeman, P., & Takabayashi, S. (2002). Effect of Total and Oxygen Partial Pressures on Structure of Photocatalytic TiO₂ Films Sputtered on Unheated Substrate. *Surface and Coatings Technology.* 153: 93-99.
- [7] Yamagishi, M., Kuriki, S., Song, P.K. and Shigesato, Y. (2003). Thin film TiO₂ photocatalyst deposited by reactive magnetron sputtering. *Thin Solid Films.* 442: 227-231.

ผลงานตีพิมพ์ – 2

The image shows the front cover of the proceedings for the "The 1st National Conference of Applied Physics". The cover is black with white text and graphics. At the top left are two circular seals: one for King Mongkut's University of Technology North Bangkok and another for the Faculty of Applied Science. To the right of the seals is a cartoon illustration of a butterfly with large, detailed wings. Below the seals, the word "PROCEEDINGS" is printed in a large, bold, sans-serif font. Underneath "PROCEEDINGS" is the conference title in both Thai and English. At the bottom of the cover, there is a stylized graphic of a butterfly with its wings spread wide, resting on a series of parallel horizontal lines that resemble a grid or a series of steps.

การประชุมวิชาการพิสิกส์ประยุกต์แห่งชาติ ครั้งที่ 1
The 1st National Conference of Applied Physics

April 26, 2013, Faculty of Applied Science, King Mongkut's University of Technology North Bangkok

NCAP16 - โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไฟเทเนียมไดออกไซด์เจือในโลหะเจือที่เคลือบด้วยวิธีร้อคคีฟีซั่นบาลานซ์แมกนีตรอนสปีคเตอริง

การพิสูจน์ชี้แจงคดีรัมป์¹² นิรันดร์ วิทิตอ้นนันท์¹² อธิษฐาน บุราพาวงศ์¹² และ ถุราสิงห์ ไชยฤทธิ์¹²

‘น้องปฏิบัติการวิธีเด็กในโลหิตอุณหภูมิเดียวกัน ภาควิชาพิสิกส์ ก็จะวินิจฉัยเชอร์บานิจัยเดียวกัน ช่วยด้วย’

‘ห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสติกสำหรับวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม (THEP) ฯฯ. ฯลฯ. ฯลฯ.’

*Corresponding author. E-mail: one-wannisa@hotmai.com

บทต่อที่ ... ถ้าเริ่มงานไฟฟ้าในมีล้อด้อมีไซต์ต้องไม่โคนครอง (*N-doped TiO₂*) เก็บบันบนกระดาษเคลือบด้วยซิลิโคนแล้วหัวไว้ให้มีช่องอากาศให้อ่อนเย็นจากน้ำยาลงที่แมกนีเซียมพิโนรูปแบบเดิมที่ห่อ ก็จะคงผลลัพธ์ในการเก็บตัวในเครื่องอบไอน้ำคราวนี้ที่มีการเคลือบด้วยไฟฟ้าเพิ่มไม่ต้องออกไฟชาร์ตต่อ อีกนัยหนึ่งทางของวิธีนี้ ไม่ใช่เรื่องไปได้รับความช่วยเหลือช่วงเวลา กวนหมากเท่านั้น ทางภาค XRD และ AFM ถูกทำขึ้นต่อการส่องรังสี gamma ทดสอบสำหรับสเปกตริกาในห้องปฏิบัติการที่มีอุ่น ห้ามนำหัวกล้องถ่ายภาพ (ω) ต้มมอลติโค้กตัวลับๆ (η) และต่ำขอบหัวจรวด (εγ) ทดสอบก็คงสามารถว่าไฟฟ้านี้ที่ก่อขึ้นมาได้ใช้ดีไซน์อย่างใส่ใจที่สุดเท่าที่จะเป็นไป โครงสร้างรังสีมีเปลี่ยนแบบทุกหลักของ $A(10)$, $A(200)$ และ $R(110)$ ขนาดอุ่นที่มีกล้องอยู่ในช่วง 27-51 nm ความหนาแน่นของเม็ดสีในช่วง 225-236 nm ล้ำก้าวขั้นต่อสีที่มีก่อให้เกิดแซฟฟาร์ฟลูป์ ฐานที่สืบสานต่อไปในช่วง 2.53-2.61 nm $\pm 0.001-0.002$ ตามที่เห็น ส่วนตัว ทดสอบรังสีรวมกับว่าได้รับไฟฟ้าที่ดีและมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานที่ต้องการ 3.2 eV ของวัสดุที่มีอยู่ ในล้อด้อมีไซต์ที่ก่อขึ้นมา ± 0.5 eV ของรังสีที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานที่ต้องการ 3.2 eV ของวัสดุที่มีอยู่

គោលការណ៍នេះ នឹងមកបង្ហាញនូវការសម្រេចក្នុងការរំពោះទីតាំងនៃក្រសួង និងក្រសួង ការពាណិជ្ជកម្ម

ບກນໍາ

ด้วยวิธีที่ไม่ใช่ไปตามมือไม่ชอบใจต้องพยายามบังคับให้มันกล่าวไว้ด้วยการตุนหัวและตัดต่อไว้ไม่ชอบด้วยมือก็ไม่ชอบต้องเพิ่ม 5% ที่เป็นที่ต้องเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่

โดยออกไช้ กี๊ที่มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ไทยมีบทบาทในด้านไช้ที่น่าจะงานได้ เมื่อรับผิดชอบงานในช่วงเวลาของตน แทนภารกิจที่ต้องให้รับความสนใจให้ถูกการเรียก ในไม่ช้าจนเป็นผลด้วยตนเอง ทางของไก่ชนเป็นไกด์ที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้ ไก่ชนมีภูมิใจในไช้ที่ก่องานได้เมื่อรับผิดชอบงานในช่วงเวลาของตน

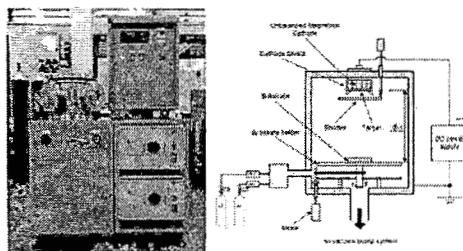
การเรียนรู้สืบในเกณฑ์ไม่คงที่ของไช่ที่ก้าวเดินหล่อไว้ แม้ล้วนเป็นผลของการที่ได้รับเรียนที่ศึกษาเรื่องนี้ ให้ได้รับเรียนที่สามารถอุบัติธรรมนี้และสอนมีดิจิทัลสื่อสันที่นี้ง่ายกว่าสื่อสันที่ได้มีอุปภากะและมีการอัพเดทต่อไป ทั้งสัมภาษณ์ประชุมคุณภาพสูงที่มีความลึกซึ้ง ทั้งงานเชิงคุณภาพในเชิงรุ่งอรุณที่ดึงความสามารถให้ได้รับข้อหัวข้ออย่างไรที่ได้กราฟรูปแบบและแผนผังของสื่อสันที่นักเรียนที่สนใจ ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

บทความวังจันที่เป็นงานนักการศึกษาเรียนรู้สืบสานภาษาไทยนี้ให้คงอยู่ในโลกนี้นั่นเอง ไม่ต้องใช้ตัวอักษรไทย ไม่ต้องเขียนภาษาไทย แต่ต้องรู้ว่าภาษาไทยมีความสำคัญและควรรักษาไว้ในภูมิปัญญาของเราต่อไป

ຮະບັບໄພວິທີວິທີ

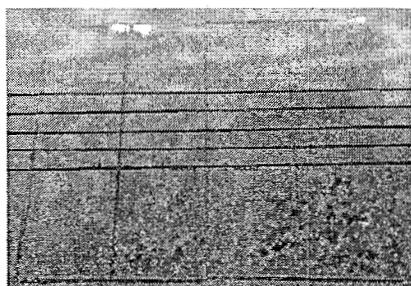
พื้นที่บนไก่พบบีน็อกดื่อออกไอก์ส์เจ๊ไนในครรภ์ในงานวิจัยนี้เรียบร้อยแล้ว
วิธีรักษาพิเศษน้ำยาทันซ์แมกนีติกสามารถป้องกันเชื้อรัง ขั้นตอนการเก็บอย่างเร็วของ
น้ำยากระชากไอก์ส์และชีดีกอนเข้าห้องห้องล่อง ลดความลับในห้องเก็บอย่างต่อเนื่อง
เดือนถัดมาเป็น 5×10^{-3} mbar กำแพงให้อัตราไนโตรเจนท์รักษาอยู่ต่ำกว่า 0.05% ต่อเดือน
ลงต่ำกว่าต้น 5:15 sccm และเปลี่ยนไวนิลออกไซด์ในครรภ์ในที่ใช้จริงในช่วง
0-3 sccm ฝีน้ำนมเพื่อช่วยให้เวลาห้องถูดีอยู่ที่ต่ำกว่า 90 นาที ที่ฝีน้ำนมที่เก็บโดยไม่ได้
นำไปทิ้งไว้ในห้องที่รักษาอย่างดีด้วยเทคโนโลยี XRD ศักยภาพจะดีกว่า ความหนา
ตัวอย่างเช่น AFM และศักยภาพน้ำนมมีผลิตามแพร่กระจายแบบปกติไปที่มิลลิเมตร



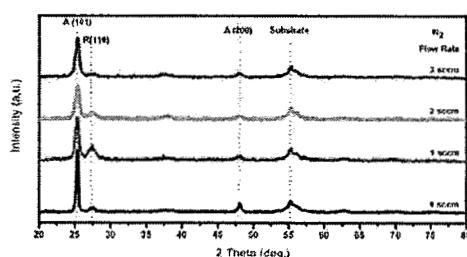


แก้ไข : ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนของผลวิเคราะห์ก่อนนำไปสู่กระบวนการที่ได้รับอนุญาต

ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ผล



ญี่ปุ่น ด้วยการนำเข้าของมีลักษณะเป็นรูปแบบของวัสดุที่มีคุณภาพดีและมีความทนทานสูง



ข้อที่ 3 ชุมชนท้องถิ่นจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมไม่กดดันให้คนในชุมชนต้องใช้สิ่งที่ไม่ดีในความคิด
ที่ดีแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีในความคิดของตน

N2 gas flow rate (scm)	Crystallite Size (nm)	Thickness (nm)	a	k	Eg
0	51	235	2.41	0.001	3.70*
1	51	228	2.55	0.001	5.15*, 2.6**
2	50	233	2.42	0.002	3.20*, 2.6**
3	27	236	2.31	0.001	1.10*, 2.4**

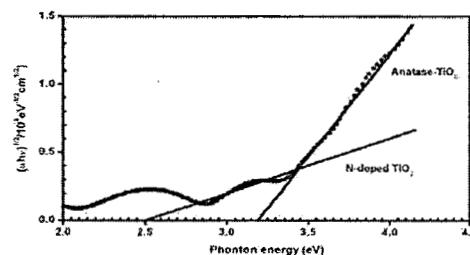
នាយកដ្ឋាន * ពីរជាអំពីការបង្កើតរឹងវាគម្ពស់នៃក្រសួង - និងរាជរដ្ឋ

** ឯកសារ និង របៀប សម្រេចឱ្យបានជូន តាមរយៈការបង្ហាញ



ส่วนความยาวคลื่นที่มากไปสักพื้นที่อยู่กับคลื่นประกอบ 225-236 nm หมายเห็นผล
ผลึกที่ร้าวคลอง จก 51 และเป็น 27 ตม (ตารางที่ 1) ส่วนตัวเด็กที่มีปัจจัยและ
สาเหตุประสาทิกที่ก่อสร้างสมญานิ่งเดินห่วง 2.53-2.61 และ 0.001-0.002 คนเดินห่วง

สำหรับรุ่นพิเศษดังรุ่น (รุ่นที่ ๑) พบว่าพื้นที่ห้องที่เกิดขึ้นได้มีเพิ่มขึ้นหลังจากติดตั้ง 3.2 CV ของไทยเมืองไอลอดอกไฮท์ที่สอนน้ำตก และ 2.5 CV ของไทยเมืองดิจิตอลไฮท์ในใจกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานวิธีนี้สามารถ เก็บเงินที่บ้านบางกอกเพียงไอลอดอกไฮท์เท่านั้นได้สำเร็จ



ພົບ 5 ພັນຍາຂອງປະເທດລາວ ຈາກພົບປິດຕະຫຼາດໃຫຍ້ມີຄວາມ



สรุปผลงานวิจัย

ผลลัพธ์งานในบทนี้ยังคงใช้คลื่นอิเล็กทรอนิกส์ในโครงข่ายถูกผลิตโดยบันทึกการซักไฟฟ้าและชีวภาพ ผลลัพธ์ที่ได้มีลักษณะที่สอดคล้องกับผลที่ได้จากการรังสีอัลตราไวโอเลต A(10) Å (200) และ R(110) โดยเจือน้ำยาการเติมด้วยคลัตช์ของเกลียวของที่ล้วนที่ได้ โลกเกลียวในโครงข่ายที่เจือมีผลทำให้ก้านหัวลงจานของที่ล้วนที่ได้เรียบไม่หลุดออก

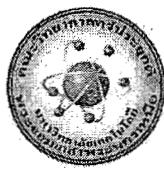
กิตติกรรมมีระกาศ

บทความวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจาก “ทุนอุดหนุนการวิจัยและประชุมเชิงรายได้” (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารอ้างอิง

- [1] Ritter, E. (1975). "Dielectric film materials for optical applications", *Physics of thin films*, New York: Academic Press, 1-49.
- [2] Li, G.H., Yang, L., Jin, Y.X., and Zhang, L.D. (2000). "Structural and optical properties of TiO₂ thin film and TiO₂ + 2 wt. %ZnFe₂O₄ composite film prepared by r.f. sputtering". *Thin Solid Films*, 368: 163-167.
- [3] Fujishima, A. & Honda, K. 1972. Electrocatalytic Photolysis of Water at a Semiconductor Electrode. *Nature*, 235, 37-38.
- [4] Fujishima, A., Rao, T.N. & Tryk, D.A. (2000). TiO₂ photoactivity and diamond electrode. *Electrochimica Acta*, 45, 4683-4690.





ขออนุญาติมีครบทั้งหมดนี้เพื่อแสดงว่า ผลงานวิจัยเรื่อง

**NCAP16 - โครงการและแผนที่ทางแสงของฟลัมมาจไทยเนียม
ไคลอฟิลล์เจลในโตรเจนที่เคลื่อนตัวยังไงเมื่อถูกตัดออก**

การผลิต ชัชรัตน์, พัชรา ภักดิษ์พันธ์, รุ่งศิริ ชูสุวรรณ, วรรธน์ สมศรีสุก, นรันดร์ วิจิลอนันท์, อติศ บุรพาเวช, ศุภลักษณ์ ใจบุญ

ได้รับคัดเลือกให้เป็น บทความดีเด่น

ในการประชุมทางวิชาการพลิกฟ์ประชุมก่อตั้ง ครั้งที่ ๑
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗

(ลงนาม)
นายชัชรัตน์ ชัชรัตน์ (นายชัชรัตน์)
อนุบัติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

(ลงนาม)
นายชัชรัตน์ ชัชรัตน์ (นายชัชรัตน์)
อนุบัติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

การบริการวิชาการ - 1

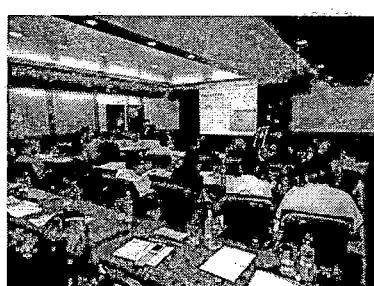
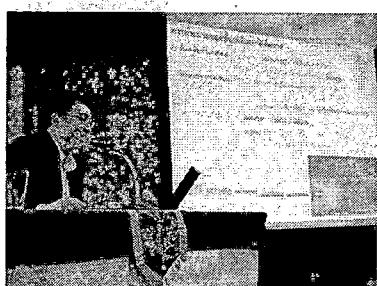
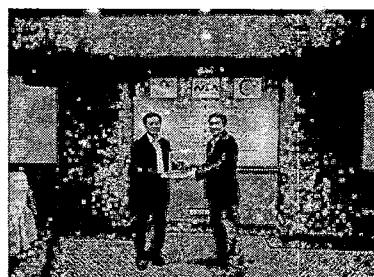
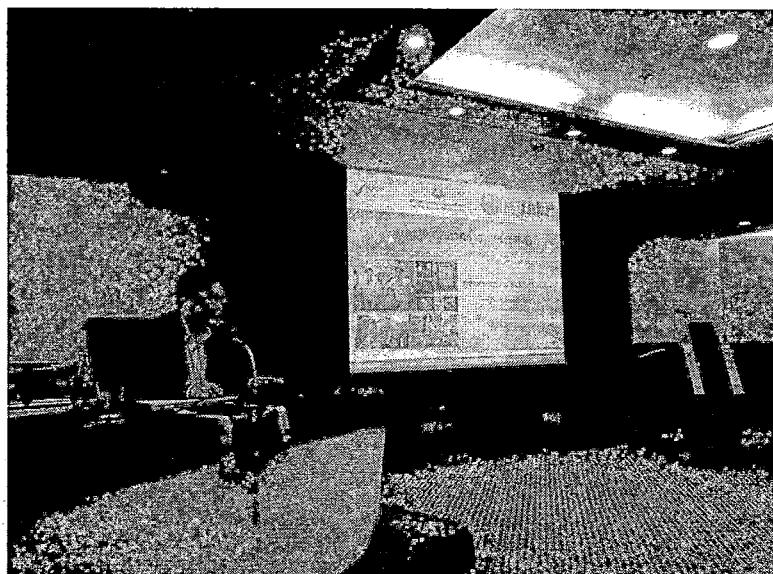
ว-ด-ป : 8 ธันวาคม 2554

หน่วยงาน : สถาบันสหกรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียด : บรรยายพิเศษ

เรื่อง การเคลือบในสูญญากาศด้วยเทคนิค PVD

หมายเหตุ : รูปแบบการใช้ประโยชน์ 9.1, 9.2 และ 9.3



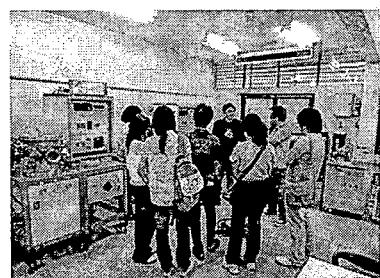
การบริการวิชาการ - 2

ว-ด-ป : 9 ธันวาคม 2554

หน่วยงาน : คณาจารย์และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รายละเอียด :
1. เยี่ยมชมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของโครงการฯ
 2. ขอข้อมูล องค์ความรู้ด้านการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ
 3. ขอคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 4. ขอคำแนะนำเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรและกระบวนการผลิต

หมายเหตุ : รูปแบบการใช้ประโยชน์ 9.1, 9.2 และ 9.3



การบริการวิชาการ - 3

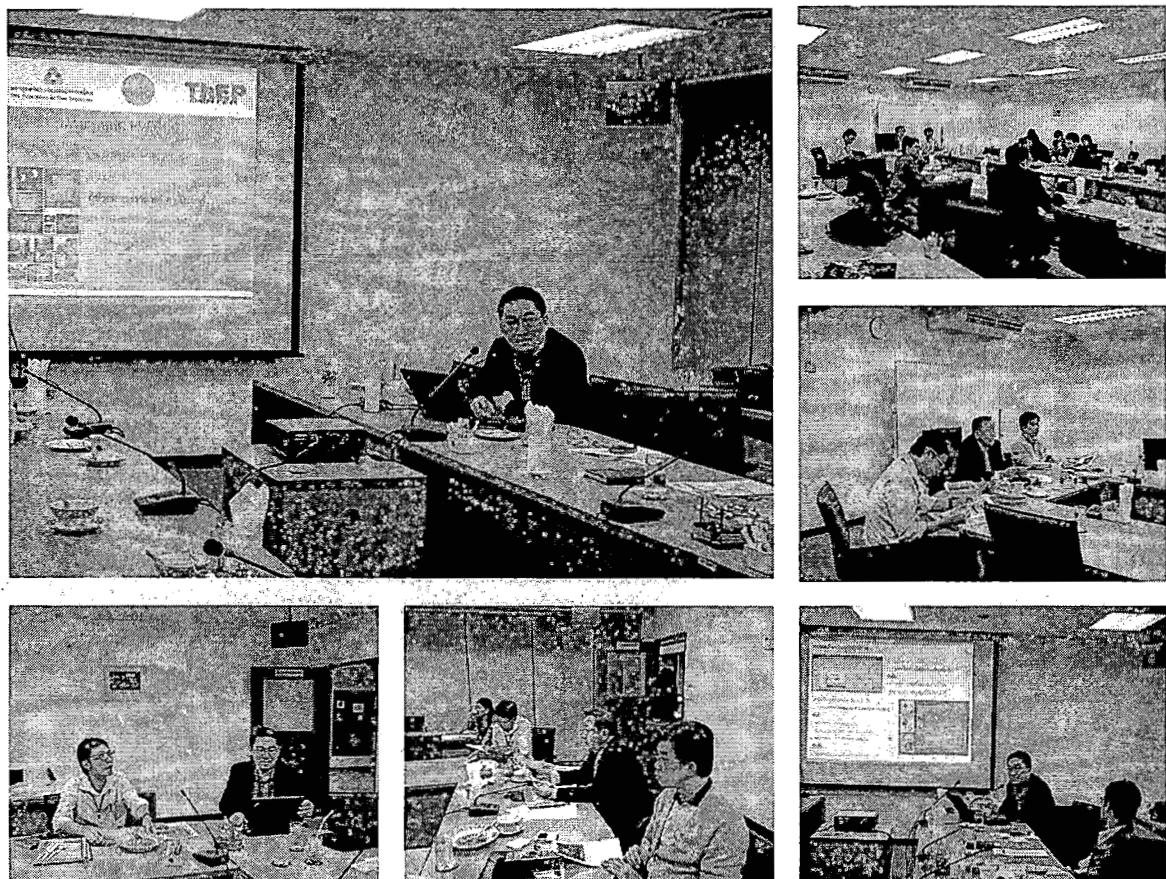
ว-ด-ป : 3 กุมภาพันธ์ 2555

หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียด : บรรยายพิเศษ

เรื่อง การเคลือบในสูญญากาศด้วยเทคนิค PVD สำหรับอุตสาหกรรมขั้นส่วนยานยนต์

หมายเหตุ : รูปแบบการใช้ประโยชน์ 9.1, 9.2 และ 9.3



การบริการวิชาการ - 4

ว-ด-ป : 18 พฤษภาคม 2555

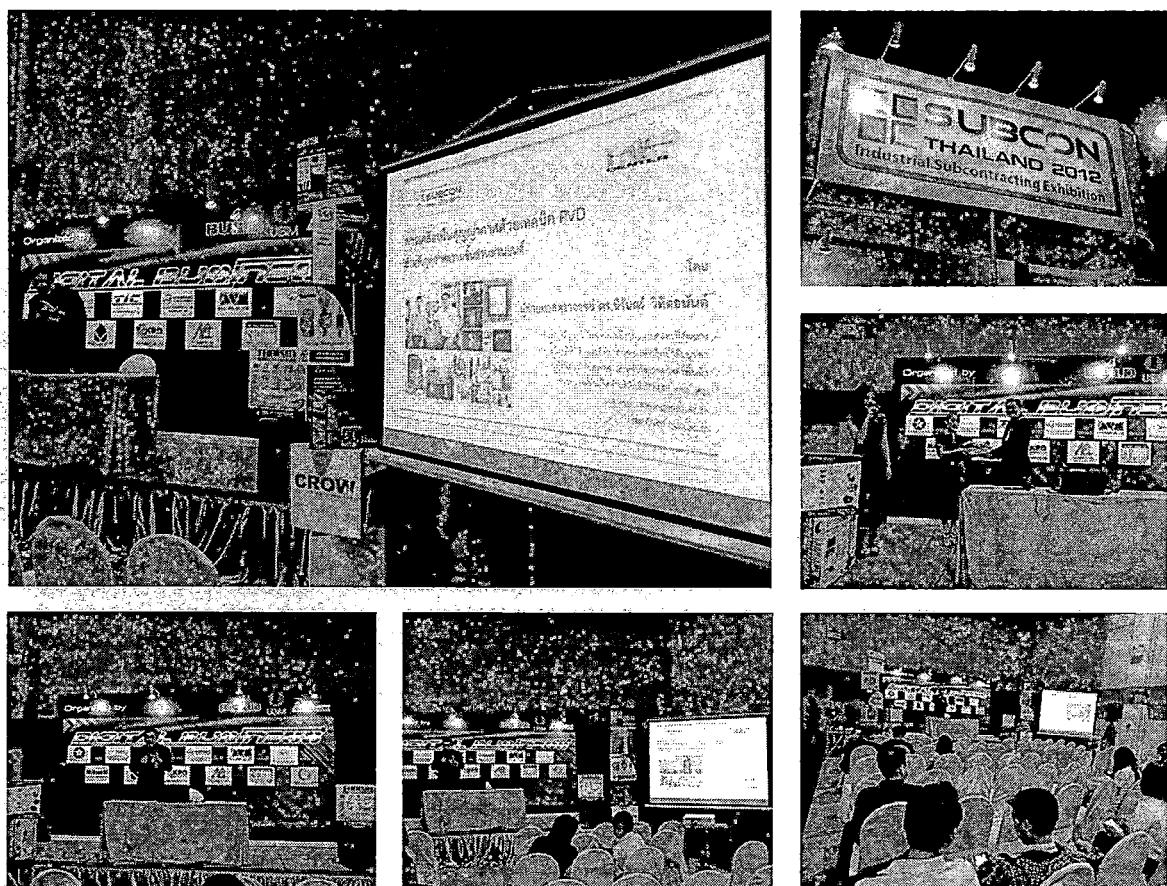
หน่วยงาน : ผู้จัดงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับซ่อมและการผลิตในประเทศไทย

SUBCON Thailand 2012 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนา กทม.

รายละเอียด : บรรยายพิเศษ

เรื่อง การเคลือบในสุญญากาศด้วยเทคนิค PVD สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

หมายเหตุ : รูปแบบการใช้ประโยชน์ 9.1, 9.2 และ 9.3



การบริการวิชาการ - 5

ว-ด-ป : 17-19 พฤษภาคม 2555

หน่วยงาน : ผู้จัดงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับซ่อมผลิตในประเทศไทย
SUBCON Thailand 2012 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการในเทคโนโลยานา กทม.

รายละเอียด : เข้าร่วมแสดงผลงานของห้องปฏิบัติการวิจัย ในงาน SUBCON Thailand 2012
ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการในเทคโนโลยานา กทม.

หมายเหตุ : รูปแบบการใช้ประโยชน์ 9.1, 9.2 และ 9.3



การบริการวิชาการ - 6

ว-ด-ป : 13 มิถุนายน 2555

หน่วยงาน : สถาบันสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด : บรรยายพิเศษ เรื่อง การเคลือบในสูญญากาศด้วยเทคนิค PVD

หมายเหตุ : รูปแบบการใช้ประโยชน์ 9.1, 9.2 และ 9.3



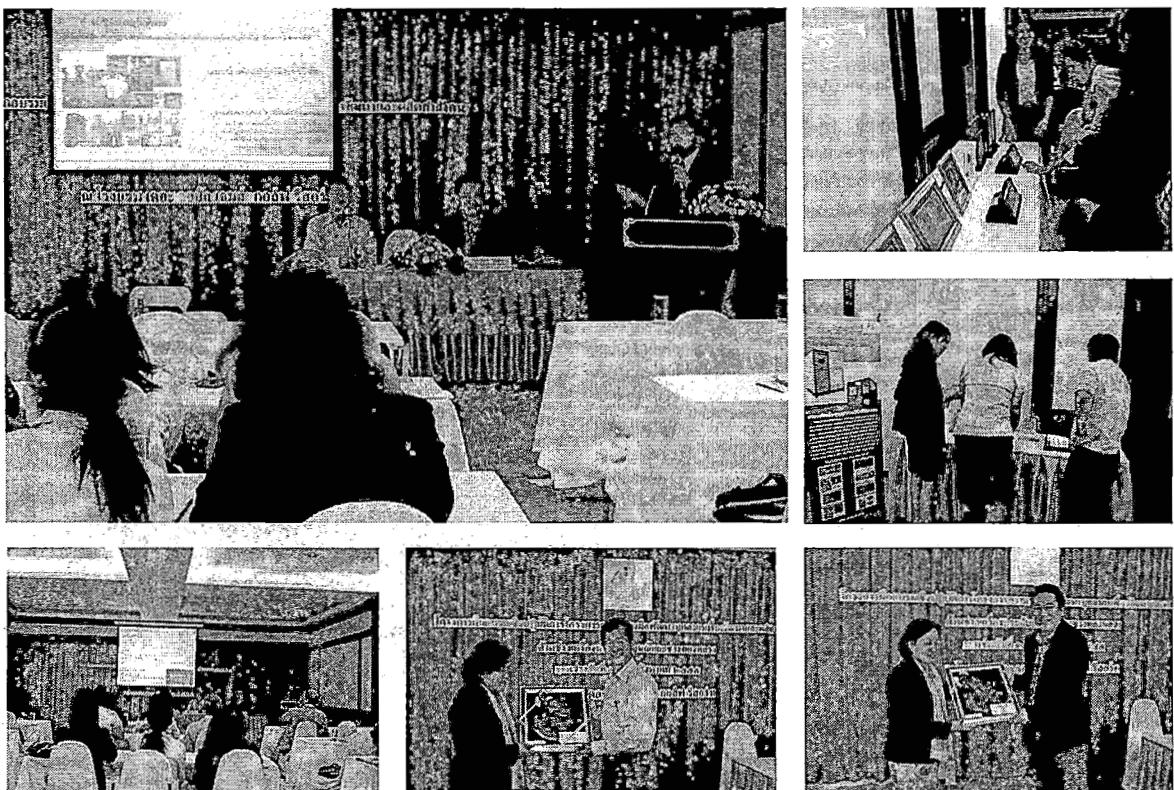
การบริการวิชาการ - 7

ว-ด-ป : 14 สิงหาคม 2555

หน่วยงาน : ภาควิชานภัคเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด : บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเคลือบผิวสุดด้วยเทคนิคแคโทดิกอร์ค”

หมายเหตุ : รูปแบบการใช้ประโยชน์ 9.1, 9.2 และ 9.3



ภาคผนวก ข

ประวัตินักวิจัย

ประวัตินักวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล	นายนิรันดร์ วิทิตอนันต์
ตำแหน่งทางวิชาการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทำงาน	ห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสม่าสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิว ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



ໂທຮສພທ໌/ໂທສາງ (038) 745-900 ໜ້າ 3084

ประวัติการศึกษา

ปริญญา	สถาบัน	ปี	สาขา
ปร.ด.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2553	พิสิกส์
วท.ม.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2543	พิสิกส์
วท.ม.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2535	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กศ.บ.(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	2532	วิทยาศาสตร์-พิสิกส์

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

เทคโนโลยีสัญญาการค้า, เทคโนโลยีฟิล์มบาง, สวนศ่าสตร์, พิสิกส์สิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

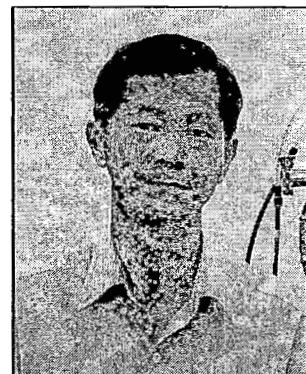
* * * * *

ประวัตินักวิจัย

นักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล นายสุรศิงห์ ไชยคุณ
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ที่ทำงาน ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสัญญาณและพิล์มบาง
ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



โทรศัพท์/โทรสาร 038-103-084
E-mail s-chaikhun@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญา	สถาบัน	ปี	สาขา
ปร.ด.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2552	พิสิกส์
วท.ม.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2528	พิสิกส์
กศ.บ.	มหาวิทยาลัยศรีนเครินทร์วิทยาลัย บางแสน	2525	พิสิกส์

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

เทคโนโลยีสุนทรียศาสตร์, เทคโนโลยีพิล์มบาง, อิเล็กทรอนิกส์, แหล่งกำเนิดไฟอ่อน

* * * * *